



TOKYO ELECTRON

INTEGRATED REPORT 2026

東京エレクトロン
統合報告書 2026





統合報告書 2026のポイント

POINT
1

CEOやCFOのメッセージに加え、コーポレートオフィサーやディビジョンオフィサーなど各責任者からのメッセージを掲載し、事業戦略や優位性などについて説明

POINT
2

取締役会議長や新任役員のメッセージ、社外役員による座談会の内容などを掲載することで、コーポレートガバナンスの取り組みをより分かりやすく伝達

POINT
3

価値創造ストーリーを体系的に整理し、Chapterごとに要点を明記

編集方針

統合報告書の発行にあたって

東京エレクトロンは、当社の中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上についてご報告することを目的として、統合報告書を発行しています。ステークホルダーの皆さまからのご要請を的確に把握し、タイムリーかつ透明性の高い情報開示に努め、内容のさらなる充実化を図っています。

対象範囲

報告の対象範囲および関連データについては、東京エレクトロングループ（連結26社）としていますが、一部は日本国内のグループ会社のみを対象としています。

主な参考ガイドライン

- IFRS財団: 統合報告フレームワーク
- SSBJ: サステナビリティ開示テーマ別基準 第1号、第2号
- Global Reporting Initiative (GRI): GRIスタンダード
- 経済産業省: 価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス
- 環境省: 環境報告ガイドライン2018年版

発行時期

2026年9月

対象期間

2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）、一部2027年3月期も対象

お問い合わせ先

東京エレクトロン株式会社 〒107-6325 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー

www.tel.co.jp/contactus/

当社に関する主な開示情報

有価証券報告書

www.tel.co.jp/ir/library/fs/

中期経営計画

www.tel.co.jp/ir/policy/mplan/

データブック

www.tel.co.jp/ir/library/db/

統合報告書

www.tel.co.jp/ir/library/ar/

サステナビリティウェブサイト

www.tel.co.jp/sustainability/index.html

コーポレートガバナンス・ガイドライン
および報告書

www.tel.co.jp/about/cg/index.html

会社案内

www.tel.co.jp/files/about/library/pv8va20000001ffv-att/corporate_guide_j.pdf

Contents

Chapter 1 東京エレクトロンについて

企業理念体系	4
CEOメッセージ	5
会社概要	9
半導体製造プロセスおよび当社の主要製品	10
継続的な企業価値の向上に関する重要指標ハイライト	11

Chapter 2 価値創造ストーリー

当社の強み	14
価値創造モデル	15
中期経営計画	17
中長期的な展望	23
マテリアリティ	25
ステークホルダーエンゲージメント	27

Chapter 3 バリューチェーンの取り組み

研究開発	29
調達・製造	33
販売	37
据付・保守サービス	41

Chapter 4 成長を支える基盤

サステナビリティの展開	46	デジタルトランスフォーメーション (DX)	63
知財・無形資産	47	情報セキュリティ	64
人材	48	リスクマネジメント	65
環境	52	コンプライアンス	67
人権	57	資本市場との対話	68
サプライチェーンマネジメント	59	コーポレートガバナンス	69
安全	61	社外役員座談会	77
品質	62		

データセクション

財務概況	81
11年間の主要財務データ	85
5年間の主要サステナビリティデータ	87
外部からの評価	89
国際的なイニシアティブへの参画	89
株式情報	90

Chapter 1

東京エレクトロンについて

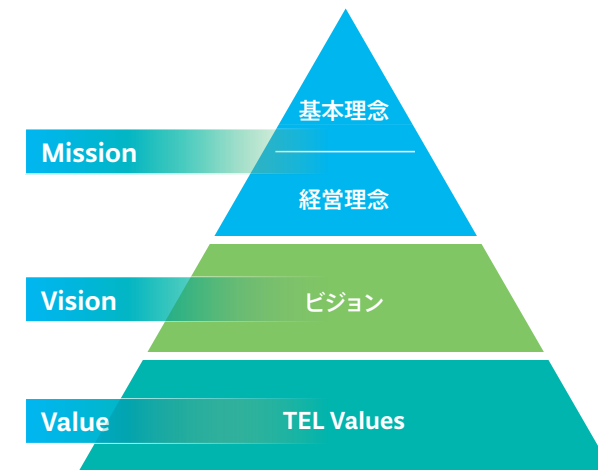
- 4 企業理念体系
- 5 CEOメッセージ
- 9 会社概要
- 10 半導体製造プロセスおよび当社の主要製品
- 11 継続的な企業価値の向上に関する重要指標ハイライト



当社は、半導体製造装置メーカーとして、半導体産業の発展に貢献し、成長を続けてきました。半導体製造の主要プロセスにおいて革新的な技術をもつBest Productsと付加価値の高いBest Technical Serviceを提供することにより、基本理念を实践し、真のグローバルエクセレントカンパニーを目指します。

企業理念体系

東京エレクトロンの企業理念体系は、1963年の創業当時より今日に至る成長の中で、常に基本としてきた経営の考え方をまとめたものです。中長期的な視点から、企業としての使命とその実現に向けて大切にする価値観や具体的な行動のあり方などを表し、Mission、Vision、Valueで構成されています。



Mission

基本理念 当社の存在意義 (Purpose) や社会的使命

最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します

経営理念 大切にすべき経営の規範

利益について

社会や産業の発展に貢献すべく、利益の追求を重視し企業価値の向上を目指します。

社員について

社員は価値創出の源泉であり、創造性と責任感と強いチームワークで情熱をもって業務に取り組みます。

事業分野について

エレクトロニクスを中心とする最先端技術分野において、高品質な製品を提供し市場をリードします。

組織について

個々の能力を最大限に発揮し、企業価値を最大化する最適な組織を築きます。

成長について

技術革新に常に挑戦し、事業拡大と市場創出により継続的な成長を図ります。

安全と健康と環境について

事業に関わるすべての人々の安全と健康、および地球環境への配慮を第一に考えて行動します。

品質とサービスについて

顧客の満足と信頼を得るために真のニーズを理解し、品質とサービスの向上に努めます。

企業の社会的責任について

企業としての社会的責任を自覚し、社会から高く評価され社員が誇りを持てる企業であるよう心がけます。

Vision

ビジョン 基本理念と経営理念に基づき中長期的に実現したい事業像

半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社

東京エレクトロンは、世の中の持続的な発展を支える半導体の技術革新を追求します。

当社の専門性を生かし、付加価値の高い最先端の装置と技術サービスを継続的に創出することで、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指していきます。

そして、企業の成長は人、社員は価値創出の源泉と位置づけ、ステークホルダーとのエンゲージメントを通じて、このビジョンの実現に向けて活動してまいります。

Value

TEL Values 社員一人ひとりが遵守すべき心構えや行動規範、価値観

誇り

私たちは、自らが誇りをもてる高い価値をもった製品・サービスを提供します。

オーナーシップ

私たちは、オーナーシップをもって、考え抜き、やり抜き、やり遂げます。

自覚

私たちは、社会の一員としての自覚をもち、責任のある行動をします。

チャレンジ

私たちは、世界No.1を目指し、新しいこと、人のやらないことにチャレンジします。

チームワーク

私たちは、お互いを認め合い、チームワークを大切にします。



TEL Valuesは、私たちが積み上げてきたものであり、これからも自分たちの手によって積み上げていくものです。

CEOメッセージ



代表取締役社長・CEO

河合 利樹

ステークホルダーの皆さまには、平素よりご支援とご愛顧を賜り、心から感謝申し上げます。

東京エレクトロンは1963年の創立以来、事業環境の変化に素早く対応しながら、時代をリードする独創的な技術で半導体産業の発展に貢献し、成長してまいりました。今日の東京エレクトロンがあるのも、ひとえに皆さまのご支援のおかげでございます。当社は、「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念の実践を通じ、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に取り組んでおります。

半導体の過去・現在・未来

1947年のトランジスタの誕生以来、半導体の技術革新が、ICT産業の成長を力強く牽引してきました。PCやスマートフォンなどのデジタル機器が普及し、誰もがインターネットやプラットフォームサービスを使用するようになりました。こうしたサービスを通じて蓄積された膨大なデータを駆使してAIが新たな価値をつくり出す時代になっています。さらに、近年の生成AIの登場を機に、AIの利活用は日増しに拡大しており、デジタル技術と、私たちの暮らしやあらゆる産業との関係は、これまでにないほど密接になっています。

AIの進化、それに伴う社会の変容は産業革命の文脈で語られることも多いですが、これまでの産業革命では「筋力」が機械化・自動化されてきたのに対し、AIは「知的労働」や「考える部分」を自動化していきます。AIの性能は数年前と比べてすでに隔世の感がありますが、これからはエージェント型AIやフィジカルAIの登場に伴い、さらなる進化が期待されます。また、従来のビット・コンピューティングに加えて、量子コンピューティングやニューロモルフィック・コンピューティングを融合した新たなコンピューティング時代の到来、それを支える6Gや7Gのような次世代通信規格などの技術革新が、私たちの暮らしをより良い方向へ変革する可能性を秘めています。

「デジタル×グリーン」と半導体の技術革新

しかし、そのような未来の実現に向けて、克服しなければならない課題もあります。消費電力の問題です。AIの普及に伴い、AIデータセンターの需要が急速に増加しています。従来のデータセンターは、大量のデータ保管や、ウェブサイトの安定稼働を目的としたものがメインでしたが、AIデータセンターは超・大規模なコンピューティング（計算処理）に特化しています。IEA（International Energy Agency）のレポートによると、AIデータセンターの普及に伴い、2030年には現在と比べてデータセンターの電力消費が約130%増加すると予測されています。また、CO₂排出量についても、80%増えるおそれがあります。

この試算では、データセンターの電力需要増加分の約半分を再生可能エネルギーで賄うことが見込まれていますが、それでもCO₂排出量は現在の2倍近くになるという予測です。データセンターは、今や社会を支える重要なインフラですが、環境負荷を軽視してよい訳ではありません。AIがより便利になるような、演算の超高速化やデータ転送の広帯域化などの性能向上の追求が重要であるとともに、地球温暖化への対策が一層求められています。こうした中、社会のデジタル化と地球環境保全に向けた脱炭素化、すなわち「デジタル×グリーン」が世界の潮流であり、共有価値となっています。

この「デジタル×グリーン」の実現に欠かせないのが半導体の技術革新です。半導体には、さらなる高速化、大容量化、高信頼化、低消費電力化の、4つの進化の方向性があります。そして、これを実現するための半導体製造には2つのアプローチがあります。1つは、半導体の進

CEOメッセージ

化の代名詞でもあるスケーリング（微細化）で、チップ上での半導体の集積度を高めていきます。もう一つはさまざまな機能を集積化する、アドバンストパッケージングです。AI半導体もこのスケーリングとアドバンストパッケージングを駆使してつくられているものであり、これを支える半導体製造装置の役割は年々重要性が増しているとともに、市場の拡大が期待できます。

東京エレクトロンのビジョンと強みを活かした経営

東京エレクトロンは、そうした半導体をつくるための装置を製造・販売する会社で、世界における半導体製造装置のリーディングサプライヤーの1つです。

当社のビジョンは、「半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社」です。このビジョンは、「TSV (TEL's Shared Value)^{※1}」の考え方に基づいています。半導体製造装置メーカーとしての専門性を生かし、付加価値の高い最先端の装置と技術サービスを継続的に創出することで、「デジタル×グリーン」を支える半導体の技術革新に貢献します。また、利益は製品とサービスの価値の大きさを示す尺度と考え、ワールドクラスの利益を追求します。その利益を次なる成長投資につなげることで、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指していきます。そして、「企業の成長は人。社員は価値創出の源泉」と位置づけ、すべてのステークホルダーとのエンゲージメントを通じて、このビジョンの実現に向けて活動してまいります。

当社の最大の特徴は、半導体製造における最先端領域を得意としていることです。微細なトランジスタを形成する前工程から、先端パッケージングにわたる幅広い工程に対応できる装置群を有しており、その多くが世界シェア上位を獲得しています。AI向けロジックデバイスをはじめとした最先端の半導体を製造するための工程数は2,000以上に上りますが、当社の強みである業界最大の装置出荷実績（累計100,000台以上）および業界最大の特許保有数（約27,000件）に基づく幅広い製品ラインアップを軸に、付加価値の高い「Next-generation products」のタイムリーかつ継続的な創出に取り組んでいます。

また、製造現場に変革をもたらす「Manufacturing DX^{※2} with AI & Robotics」構想のもと、装置とフィールドサービスの二軸に対する生産性向上をAIとロボットを駆使して実現するソリューション「Epsira™（イプシラ）」を昨年12月にリリースしました。すでに、一部のサービ

スについては、主要なお客さまの量産現場への提供も開始しており、今後も、お客さまの生産性向上に貢献する取り組みを加速させていきます。

そして、お客さまの課題を解決し、半導体の絶え間ない技術革新に貢献し続けるソリューション・プロバイダとして、世の中の半導体製造に不可欠な比類なき存在になることを目指してまいります。

※1 TSVは、CSV (Creating Shared Value) の考え方を当社グループの事業に即して捉えなおしたものの。

CSVは、企業の専門性を活用して社会課題を解決することで、社会的価値と経済的価値を創出し、企業価値の向上と持続的な成長を実現するという考え方

※2 DX: Digital Transformation



中期経営計画の進捗

ビジョンの実現に向けた中期経営計画として、当社は2027年3月期までに売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE 30%以上を目指す財務目標を設定しております。

当社の業績は、この10年で売上高は4倍、営業利益は7倍に成長してきました。加えて、足元ではAIサーバー向け半導体の旺盛な需要から、先端デバイス向け投資に関して強い引き合いをいただいております。売上高については3兆円以上の達成が見えてきております。ROEに関しましても、純利益の増加と資本効率の向上により、30%以上の達成が見込める状況です。一方、当社を取り巻く事業環境は、以前に増して大きく変化しています。米中対立に伴う規制や関税、中東紛争やロシア・ウクライナ戦争の長期化などの地政学的な影響、世界的なインフレや為替変動、お客さまの投資計画の変更など、さまざまな事業環境の変化が起きている。このため、営業利益率の目標達成に向けてはチャレンジ的な状況となっています。

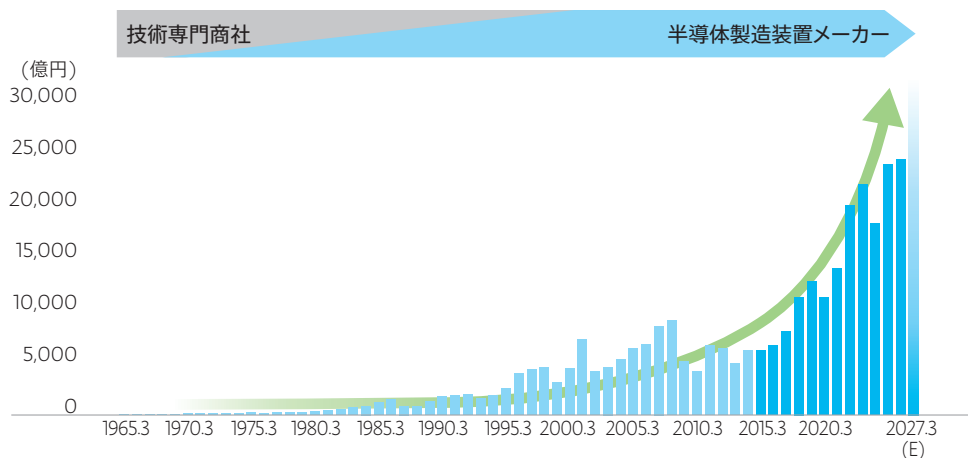
このような事業環境の中、稼ぐ力を究明・追求し、時代の変化に適切に対応していくことが重要です。これまでの着実な進捗により、1兆円の営業利益が視野に入ってきましたが、利

CEOメッセージ

益率のさらなる向上を図るため、以下の5つのポイント、すなわち、①付加価値の高い次世代装置（強い“Next-generation products”）の継続的な提供、②納入した装置のアップグレード、③AIやロボティクスを活用したアドバンスド・フィールドソリューションの展開、④装置の立ち上げ期間を半分にする「One-touchスタートアップ」による効率性の追求、⑤インフレに伴うコスト増に対する適切な価格改定、について重点的に取り組んでまいります。

当社は、強みをさらに磨き、将来の成長機会を最大限に取り込むべく、2025年3月期からの5年間で研究開発投資1.5兆円以上、設備投資7,000億円以上、人材採用はグローバルで10,000名とする成長投資計画を設定し、取り組みを進めております。成長事業への投資と既存事業の効率化を通じて、継続的にワールドクラスの利益率を目指すとともに、資本効率の観点ではROE 30%以上を意識しながら適切なキャピタルアロケーションを実施していきます。

連結売上高



人材に関する取り組み

当社では、「企業の成長は人。社員は価値創出の源泉」と考えます。社員がそれぞれの能力を最大限に発揮できるよう、社員の意欲とエンゲージメントを高めることがCEOとしての私の重要なミッションの1つであると捉え、次の5つのポイントからなる「やる気重視経営」に取り組んでいます。

やる気重視経営の5つのポイント

1. 自分の会社や仕事が産業や社会の発展に貢献しているという実感をもてること

- TEL's Shared Value:
デジタル化と地球環境保全に向けた脱炭素化を支える半導体の技術革新に貢献
- E-COMPASSの活動を通じ、2040年までにネットゼロの達成を目指す

2. 会社の将来に対する夢と期待がもてること

- 将来の成長が強く見込まれる半導体製造装置業界でビジネスを展開
- 高い財務目標（売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE 30%以上）、ワールドクラスの利益率の達成をグループ全体で追求

3. チャレンジできる機会があること

- 積極的な研究開発投資をはじめとした成長投資の実施
(2025年3月期からの5年間で研究開発投資1.5兆円以上、設備投資7,000億円以上、人材採用はグローバルで10,000名とする成長投資計画)

4. 成果に対する公正な評価とグローバルに競争力のある報酬

- 業績連動報酬制度の採用

5. 風通しの良い職場であること

- 社員集会や座談会をはじめとした社員と経営トップとのコミュニケーションの定期的な実施（3年間で国内外26拠点で実施）

また、人材多様性が重要であるという認識のもと、Global、Gender、Generationの3Gの観点を意識しながら、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンを推進しております。そして、さまざまなキャリアパスを示した上で教育プログラムの充実化も図り、社員の成長を支えております。

さらに当社は、業界のリーディングカンパニーとして、将来の半導体産業を担う学生や研究者などの育成もミッションと捉え、積極的に取り組んでおります。日米の大学によって構成される「半導体の人材育成と研究開発に関する未来に向けた日米大学間パートナーシップ (UPWARDS※3)」に参画するなど、さまざまな産学連携プログラムの支援を通じ、次世代の半導体人材の育成に寄与することで、半導体産業のサステナブルな発展に貢献してまいります。

※3 UPWARDS: U.S.-Japan University Partnership for Workforce Advancement and Research & Development in Semiconductors

CEOメッセージ

環境に関する取り組み

社会において地球環境保全の重要性がより一層高まる中、当社では、持続可能な社会の実現に貢献すべく、あらゆる事業活動を通じて環境負荷低減、とりわけ脱炭素化に取り組んでいます。2040年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする「ネットゼロ」目標を設定しており、お客さまが当社グループの製品を使用する際のCO₂排出量の削減、木材梱包の削減やモーダルシフトの推進による物流での環境負荷低減、各事業所における再生可能エネルギー使用の推進と資源使用量の削減などの取り組みを進めています。

また、当社内のみならず、お客さまやパートナー企業さまと連携しながら、製品のライフサイクル※4全体について環境負荷低減を進めております。その一環として、環境にフォーカスしたイニシアティブ「E-COMPASS※5」を推進しており、サプライチェーン全体で半導体の技術革新と環境負荷低減に取り組んでいます。

※4 製品のライフサイクル: 製品の企画・開発・設計から、調達、製造、物流、お客さまにおける使用時、メンテナンス・サービス、廃棄のバリューチェーン

※5 E-COMPASS: Environmental Co-Creation by Material, Process and Subcomponent Solutions

“攻め”と“攻め”のガバナンス

当社では、短期および中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指し、「“攻め”と“攻め”のガバナンス」を基本姿勢として経営をおこなっております。1つ目の“攻め”は、「“攻め”の事業活動」です。「利益は製品とサービスの価値の大きさを示す尺度」であると捉え、革新的な技術をもつBest Productsと付加価値の高いBest Technical Serviceの提供により、常にワールドクラスの営業利益率と30%以上のROEを追求していきます。

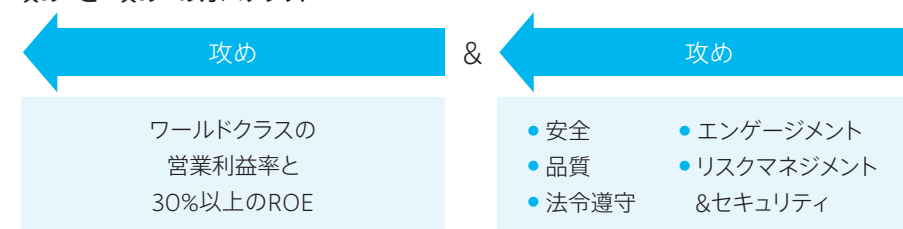
2つ目の“攻め”は、「“攻め”の経営基盤構築」です。すべての企業活動の基本である、安全・品質・法令遵守や社員をはじめとするステークホルダーとのエンゲージメント、セキュリティの強化・向上などについても、当社の強みとすべく追求していきます。特に、「Safety First」を重視しており、労働時間20万時間当たりの人身事故発生率を示す「TCIR※6」で職場環境の安全性をモニタリングしています。2026年3月期のTCIRは0.22と、半導体製造装置業界の中でトップクラスを実現しております。当社製品の仕様に关わる安全性はかなり高い

レベルで確保できているので、人的要因や行動要因による事故をもう一段減らしていくために、全社を挙げての安全キャンペーンをおこなうなど、取り組みを進めています。

また、「企業の成長は人。社員は価値創出の源泉」であり、社員が長く働きたいと思える会社づくりをしていきたいと考えています。当社の離職率は、日本では0.9%、グローバルで見ても2.2%と、半導体製造装置業界の中でも特筆すべき低さを誇っています。半導体人材の不足が叫ばれる中、人的資本経営の観点から、中長期的視点で人材の開発・活用にに取り組めることは大きな強みになると考えております。

※6 TCIR: Total Case Incident Rate

“攻め”と“攻め”のガバナンス



皆さまに愛され信頼される企業を目指して

半導体が実現する豊かな未来、進化し続ける半導体。それを支える製造装置市場は新たな成長フェーズに入りました。東京エレクトロンは世界No. 1を目指して、これからも挑戦と進化を続け、当社だからできる付加価値の高い世の中になく技術を創造し、社会に提供してまいります。そして、「デジタル×グリーン」の実現に貢献し、半導体産業になくなくてはならないソリューション・プロバイダかつ、地球に選ばれる真のグローバルエクセレントカンパニーへと進化を遂げるとともに、すべてのステークホルダーに愛され、高く信頼され、夢と活力のある会社であり続けられるよう努めてまいります。

引き続き、皆さまのご支援を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長・CEO

利樹

会社概要

当社は、半導体製造装置業界におけるリーディングカンパニーとしてグローバルに事業を展開しています。Best Products、Best Technical Serviceにより、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努めています。事業を通じてサステナブルな社会の構築と発展に貢献することで、基本理念を実践していきます。

拠点数

(2026年4月1日現在)

海外
20社
17の国と地域
72拠点

国内
6社
30拠点

合計(連結)
26社[※]
18の国と地域
102拠点

■ 本社 ■ 支社、事業所(サービス拠点を含む)、営業所

※ 現在清算整理中の会社は地図上に表記していません

沿革

1963

(株)東京放送の出資により
(株)東京エレクトロン研究所を設立



1964

米国サムコ社から拡散炉の輸入販売代理権を獲得し、販売を開始



1968

テル・サムコ(株)で拡散炉の国内生産を開始



1978

(株)東京エレクトロン研究所から東京エレクトロン(株)へ商号変更

1980

東京証券取引所市場第二部に上場



1984

東京証券取引所市場第一部に指定替え



1986

半導体製造装置の輸出を開始

1990s

サービスや製造を担う会社の設立など国内グループ体制を強化、事業のグローバル化を推進するため世界各国に現地法人を設立

1990

フラットパネルディスプレイ製造装置市場へ本格参入

1994

海外での直接販売・サポート体制を開始

1999

東京証券取引所市場第一部における業種変更「商業」から「電気機器」へ

2006

行動規範として「TEL Values」制定

2007

人材開発強化のため「TEL UNIVERSITY」設立



2015

東京エレクトロン コーポレートガバナンス・ガイドラインを制定

新生TELとして再出発(ビジョン、中期経営計画の策定、コーポレートロゴ刷新)

2021

統合報告書の発行を開始

2022

東京証券取引所プライム市場に指定替え



新たなビジョンと中期経営計画を策定
コーポレートメッセージとして Technology Enabling Lifeを制定

Technology Enabling Life

2023

創立60周年

売上高
2兆4,435億円

2026年3月期

(億円)
25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

1960s ~

技術専門商社として創業

1980s ~

本格的にメーカーへ移行

1990s ~

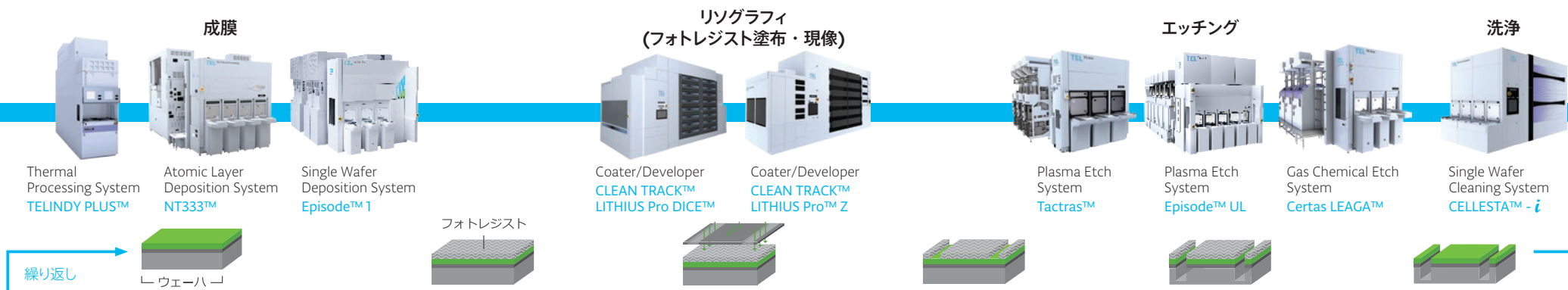
グローバル化を加速

2000s ~

イノベーションと成長を志向

半導体製造プロセスおよび当社の主要製品

■ ウェーハ処理プロセス (前工程) ■ 検査・組み立てプロセス (後工程)



膜形成

酸化、CVD※1、あるいはALD※2法などを用いて、清浄なウェーハ上に薄膜（シリコン酸化膜、シリコン窒化膜、金属など）を堆積、成膜します。

※1 CVD: Chemical Vapor Deposition (化学気相成長)
※2 ALD: Atomic Layer Deposition (原子層堆積)

フォトレジスト※3塗布

ウェーハを高速回転させながら、フォトレジストをウェーハ全面に薄く、均一に塗布します。

※3 フォトレジスト: UV光により性質変化が起こる感光材料

露光

ICパターンを描いたフォトマスクをウェーハに合わせ、露光装置でUV光を照射し、フォトレジストにパターンを転写します。

現像

露光されたフォトレジストを現像液で溶かします。これにより、使用したフォトマスクに応じたパターンがウェーハ上に残ります。

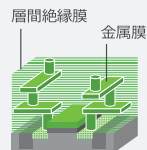
エッチング

プラズマエッチング装置やプラズマレスのガスケミカルエッチング装置で、リソグラフィで形成されたパターンに従って、シリコン酸化膜・シリコン窒化膜・シリコンなどを所望の形状に削ります。

レジスト除去・洗浄

エッチング後に不要になったフォトレジストを除去します。また、洗浄装置でウェーハを薬液に浸して、不純物を除去します。

貼り合わせ



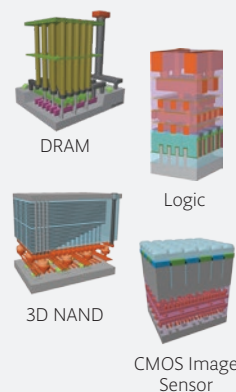
トランジスタと配線がつくりこまれた複数枚のウェーハを貼り合わせる場合もあります。この貼り合わせにより1つの集積回路に統合します。

トランジスタ
(素子)と
配線が完成

ウェーハ検査



形成された集積回路の1つひとつに対し、良・不良判定をおこないます。



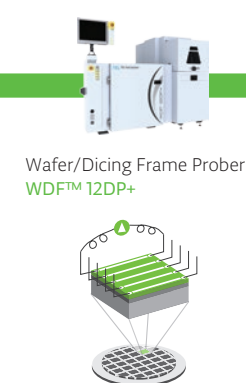
集積回路の完成

貼り合わせ・剥離

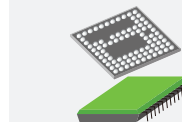


再配線層や接合パッド（バンパ）を形成後、ウェーハを支持基板に貼り合わせ、裏面を薄化する場合もあります。その後、支持基板をデボンディング装置により剥離します。

検査



ウェーハから切り出されたチップ1つひとつに対し、良・不良判定をおこないます。



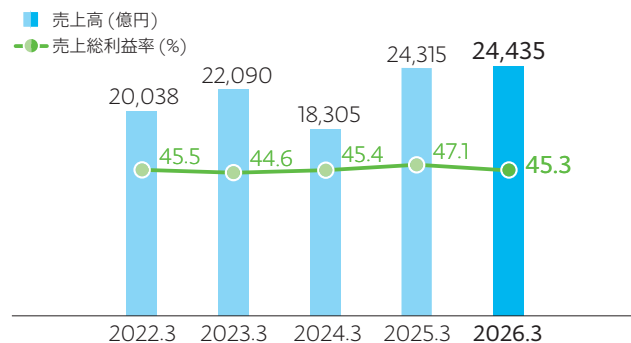
良品チップをパッケージ基板、リードフレームなどに実装し、さまざまな材料で封止します。

半導体
パッケージングの
完成

継続的な企業価値の向上に関する重要指標ハイライト

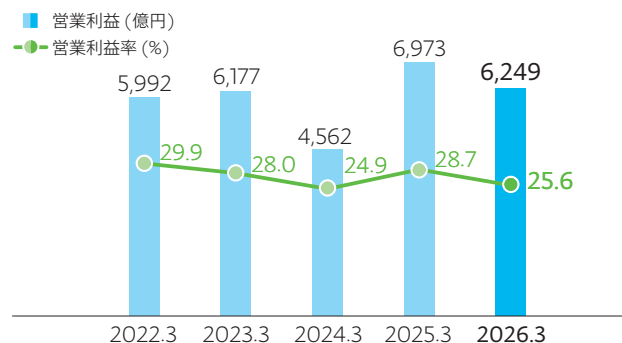
当社では、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上において重要である経営上の指標を明確にし、モニタリングや分析を実施することにより、事業活動における方針の決定やさまざまな判断をおこなっています。

売上高と売上総利益率



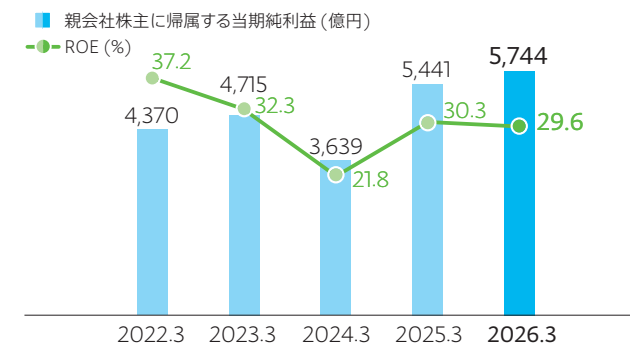
先端領域における活発な設備投資を背景とした好調な装置販売や、お客さまの工場稼働率上昇に伴う改造や保守用部品・サービスなどの売上増加により、売上高は2期連続で過去最高を更新

営業利益と営業利益率



営業利益率は前期と比べ減少したものの、翌期以降の大きな市場成長を見据え、半導体の技術革新を支える付加価値の高い製品を投入すべく、積極的な研究開発活動を推進

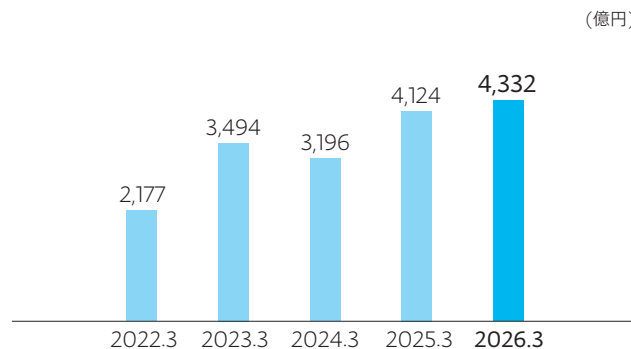
親会社株主に帰属する当期純利益とROE※1



過去最高となる当期純利益と適切なバランスシート・マネジメントにより、高水準のROEを維持

※1 ROE (自己資本利益率) = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期首・期末平均自己資本 × 100

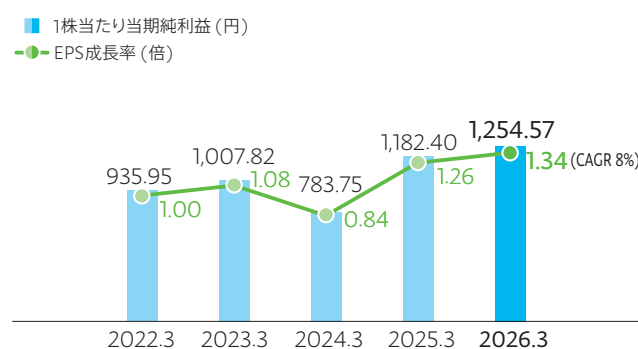
フリーキャッシュ・フロー※2



営業活動を通じて創出したキャッシュを原資として成長投資を継続。資本効率向上を図るため、政策保有株式も一部売却。フリーキャッシュ・フローは過去最高額

※2 フリーキャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー (定期預金および短期投資の増減を除く)

1株当たり当期純利益 (EPS)※3とEPS成長率※4

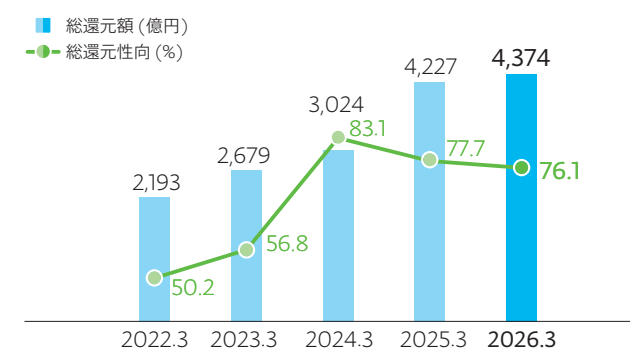


1株当たり当期純利益は増加傾向にあり、過去5年間の年平均成長率 (CAGR) は8%

※3 2023年4月1日に実施した株式分割反映後の数値

※4 各期のEPS成長率は、2022年3月期を基準としたときの倍率を表示

総還元額と総還元性向



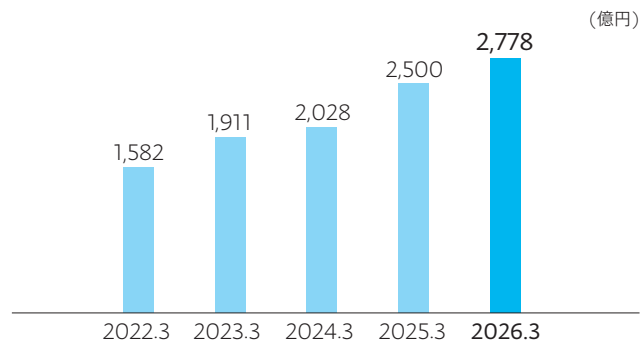
株主還元政策である配当性向50%※5に基づく配当金の支払いと自己株式の取得※6により総還元額は過去最高の4,374億円

※5 ただし、1株当たり年間配当金50円を下回らない。2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討

※6 機動的に実施を検討。なお、単元未満株式の買取りに要した金額を除いている

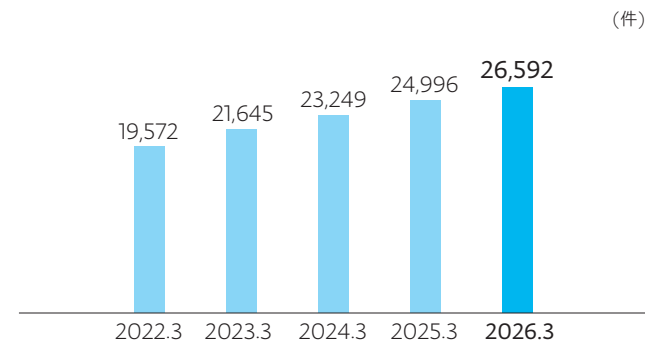
継続的な企業価値の向上に関する重要指標ハイライト

研究開発費



2026年3月期は2,778億円の研究開発投資を実施。中期経営計画の目標である1兆円以上に対して順調に進捗。さらなる成長投資として、2025年3月期からの5年間で1.5兆円以上の研究開発投資を推進

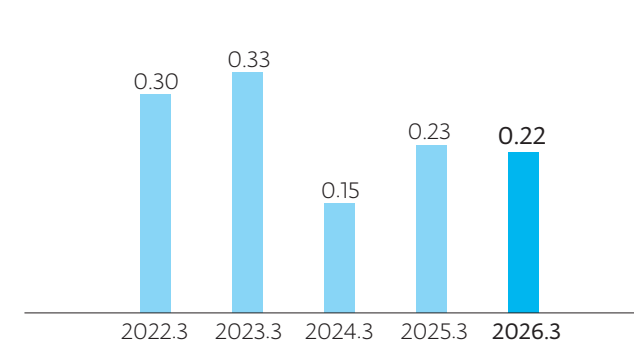
特許保有件数※1



2026年3月末時点の特許保有件数は26,592件であり、半導体製造装置業界でNo. 1。量と質の両面で競争力のある知的財産権ポートフォリオを構築し、知的財産領域における優位性をグローバルレベルで維持

※1 2022年3月期は社内データ、2023年3月期以降はLexisNexis® PatentSight+データに基づき作成

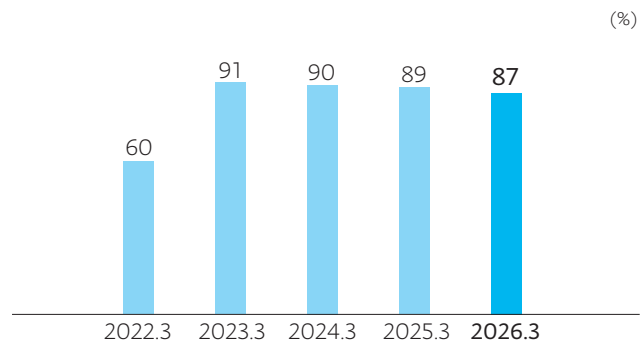
労働時間20万時間当たりの人身事故発生率 (TCIR※2)



2026年3月期は、安全キャンペーンの実施による安全意識の向上や装置安全設計に関する継続的な取り組みなどにより、0.22を達成。「Safety First」をスローガンに、中期経営計画の目標である0.10未満に向けたさまざまな活動を実施

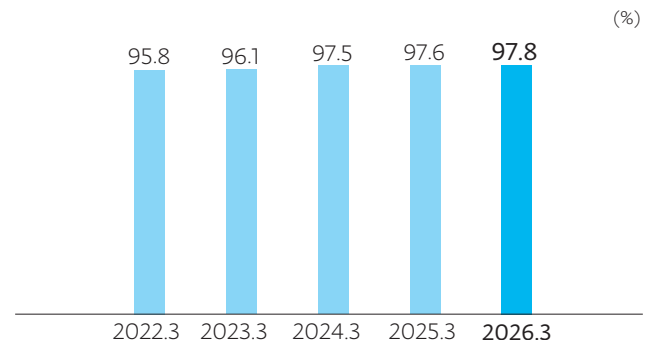
※2 TCIR: Total Case Incident Rate

事業所における再生可能エネルギー使用比率



2026年3月期は、再生可能エネルギーの使用比率が低いアジア地域における電力使用量の増加により、グローバルで87% (日本国内は100%)。2031年3月期までに使用比率100%の達成を目指し、再生可能エネルギーの導入を推進

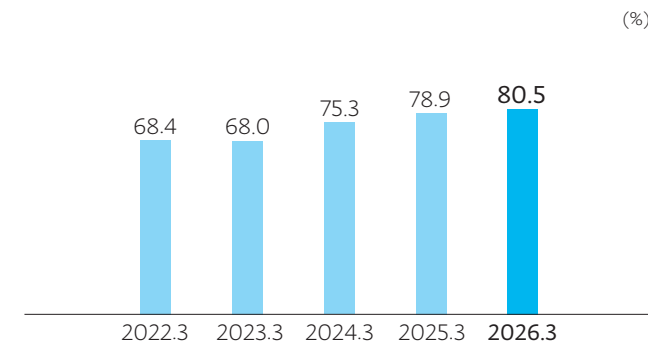
社員の定着率※3



2026年3月期はグローバルで97.8%の高い定着率を維持。社員が価値創出の源泉であるとの認識のもと、社員エンゲージメントのさらなる向上を目指して継続的かつ効果的に施策を展開

※3 離職率のデータを用いて算出

有給休暇取得率

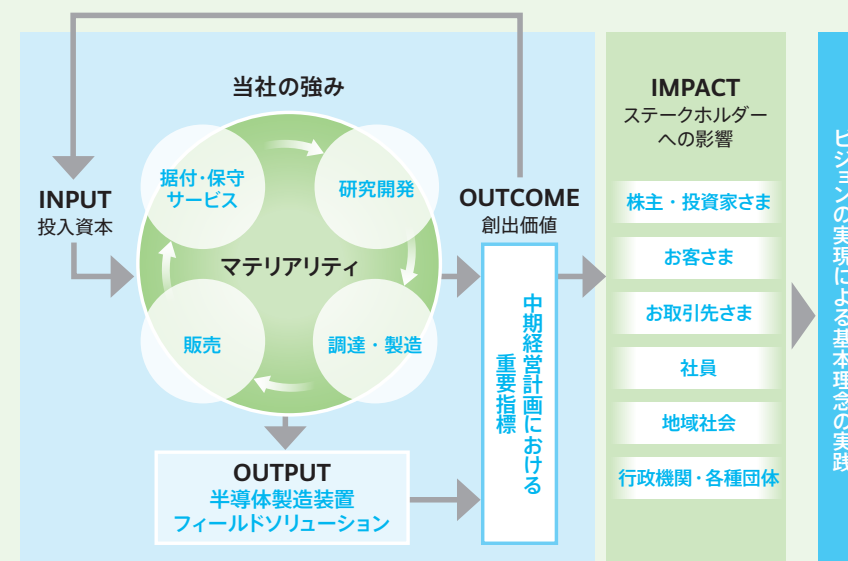


2026年3月期はグローバルで80.5%の取得率。管理職には都度取得率を案内した上で、業務配分の調整など個人として取得しやすい環境づくりを推進

Chapter 2

価値創造ストーリー

- 14 当社の強み
- 15 価値創造モデル
- 17 中期経営計画
- 23 中長期的な展望
- 25 マテリアリティ
- 27 ステークホルダーエンゲージメント



当社は独自の強みを生かし、マテリアリティを軸とした事業活動により、中期経営計画の達成とさらなる成長に向けた取り組みを展開しています。社会における役割と責任を確実に果たしていくことで、ステークホルダーとの確固たる信頼関係を構築し、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努めていきます。

当社の強み

当社がこれまで培ってきた強みをさらに磨き、挑戦と進化を続けながら、事業活動における優位性として最大限に生かすことでさらなる成長を目指しています。

半導体の微細加工に必要な成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄という

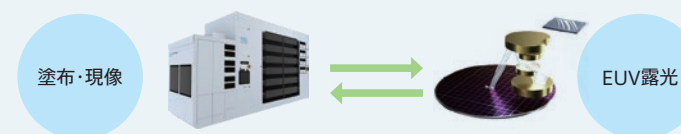
4つのキーププロセスの先端装置を提供するメーカー



半導体の進化に必要なEUV^{※1}露光用の塗布現像装置のシェア^{※2}が**100%**

※1 EUV: Extreme Ultraviolet. 半導体業界では特定の波長13.5nmを使用した露光技術の総称

※2 当社推定



当社の製品群は各セグメントで強いポジションにあり、

いずれも市場シェア^{※3}**上位**を獲得

※3 当社推定

※4 各セグメントにおける当社の製品群: 拡散炉は熱処理成膜、パッチ成膜はALD (Atomic Layer Deposition) と CVD (Chemical Vapor Deposition)、メタル成膜は枚葉成膜、洗浄は枚葉洗浄とパッチ洗浄をそれぞれ含む



お客さまとの絶対的な信頼関係のもと、**業界最大^{※5}**の出荷実績を生かして展開する

技術サービスとマーケティング

※5 当社推定

※6 2026年3月末時点



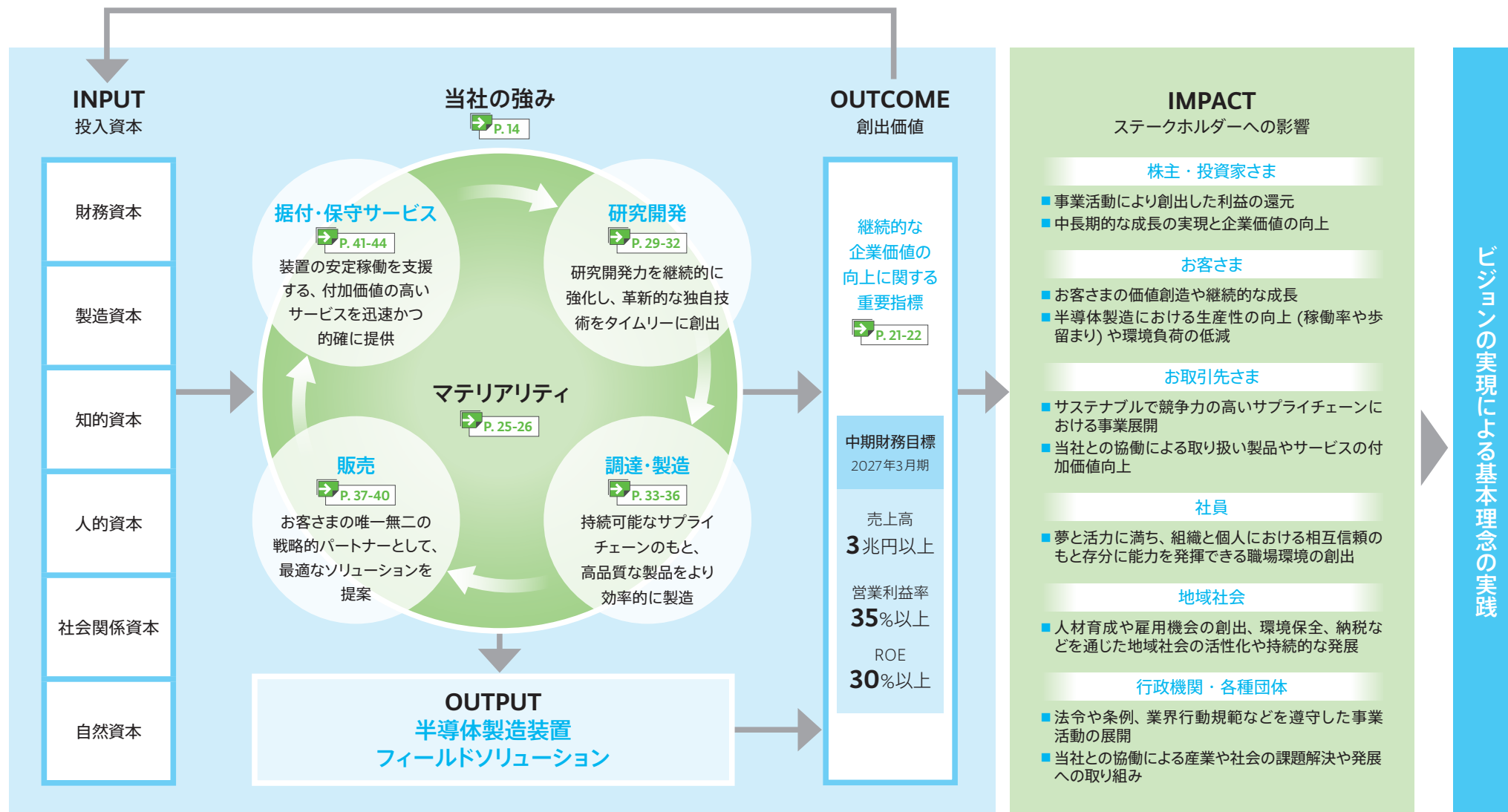
特許保有件数が半導体製造装置業界においてグローバル**No. 1**

※7 2026年3月末時点。LexisNexis® PatentSight+データに基づき作成



価値創造モデル

当社は保有する資本を最大限に活用し (INPUT)、強みを生かしながらマテリアリティを軸とした事業活動を展開しています。これにより創出される価値 (OUTCOME) をステークホルダーに提供します。そしてビジョンの実現による基本理念の実践を通じ、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指しています。



価値創造モデル

INPUT (投入資本) およびOUTCOME (創出価値) の2026年3月期実績は以下のとおりです。

資本	INPUT (投入資本) 2026年3月期		OUTCOME (創出価値) 2026年3月期	
財務資本	●純資産 2兆699億円 ●自己資本比率 71.5% ●総資産 2兆8,609億円		●売上高 2兆4,435億円 ●営業利益率 25.6% ●当期純利益 5,744億円 ●ROE 29.6% ●年間配当総額 2,874億円 (配当性向50.1%)	
製造資本	●製造拠点 合計 9 (国内6、海外3) ●新工場建屋や設備など製造に関する設備投資 ●部品の標準化・生産の平準化	●製造オペレーションにおける長年培ったノウハウや実績 ●製造基幹システム	●累計出荷台数 約100,000台 (年間出荷台数 約4,000台) ●最先端技術を備えた高品質、高信頼性の製品	●安全第一のオペレーション TCIR 0.22 ●生産リードタイムの短縮
知的資本	●研究開発拠点 合計 19 (国内8、海外11) ●研究開発投資 2,778億円 ●複数の領域における高い専門性とそれらを統合して製品化する能力	●半導体製造プロセスにおける幅広い知見と総合的な技術力 ●お客さまのご要望や技術動向 ●デジタル技術やナレッジマネジメントにより蓄積された装置関連データ	●革新的で付加価値の高い独自技術 ●市場シェア※1 上位の充実した製品群 ●半導体製造における最適なソリューション	●特許保有件数 26,592件 (保有特許増加件数 1,596件) ●高品質かつ高効率なサービス
人的資本	●従業員数 20,236名 ●エンジニア比率 68.9% ●さまざまな専門分野の知見を備えた人材	●グローバルに活躍できる人材 ●TEL UNIVERSITYによる人材開発	●定着率※2 97.8% ●価値創出の源泉である社員の成長意欲の向上とチャレンジ精神の発揮 ●エンゲージメントの高い社員によるステークホルダーとの信頼関係の構築	●女性管理職比率※3 6.8%
社会関係資本	●長年の実績に基づくお客さまとの信頼関係 ●お取引先さまとの強固なパートナーシップ	●地域社会における事業活動の基盤 ●業界団体における同業他社との連携	●顧客満足度調査「非常に満足」または「やや満足」回答割合※4 100% ●事業活動を展開する地域における雇用機会の創出と国・地方自治体への納税 ●TEL FOR GOOD※5 プログラム数 285件	
自然資本	●エネルギー使用量 620,995MWh ●水使用量 2,077千m³		●自社のCO₂排出量 64%削減 (2019年3月期比、再生可能エネルギー導入などによるCO₂排出量111千t削減) ●製品使用時のCO₂排出量 (ウェーハ1枚当たり) 11%削減 (2022年3月期比) ●廃棄物リサイクル率 98.5%	

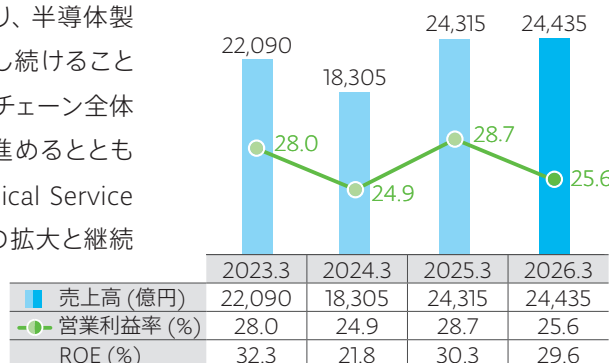
※4 ご回答いただいたすべてのお客さまのスコア平均値を設問ごとに算出
 ※5 当社の社会貢献活動を表すブランドネーム

中期経営計画

財務目標

当社は2023年3月期に中期経営計画を策定し、ワールドクラスの営業利益率とROE（自己資本利益率）のさらなる向上に向けて、2027年3月期までに売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE 30%以上を目指す財務目標を設定しています。

半導体の重要性が一段と高まり、半導体製造装置市場が今後も大きく成長し続けることが予想される中、当社はバリューチェーン全体におけるさまざまな取り組みを進めるとともに、Best Products、Best Technical Serviceを常に追求し、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指していきます。



主な取り組み

- AI関連需要の拡大に伴う、当社の得意とする先端アプリケーション向け装置の展開加速、フィールドソリューションの事業機会拡大への対応
- 将来、お客さまが必要とする高付加価値のnext-generation productsをいち早く市場に投入するとともに、最高水準の技術サービスを提供
- 積極的な成長投資（研究開発費、設備投資）を実施
- 出荷済み装置をもとにパーツ販売やアップグレード改造、稼働率向上に取り組み、お客さまが生産するデバイスの歩留まり向上などの課題解決に努めるとともに、これらの高度なフィールドソリューションの提供を通じてアフターマーケットでの収益拡大を図る
- 環境イニシアティブ「E-COMPASS」を展開し、サプライチェーン全体で半導体の技術革新と環境負荷低減の実現を目指した活動を実施
- 業務効率化と新たな価値の創造に向けたデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進と体制の強化

CFOメッセージ



川本 弘

常務執行役員 CFO
ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー

当社はビジョンの実現と財務目標の達成に向けて、以下の戦略や政策を実践するとともに、資本市場との対話を通じて企業価値・株主価値の向上に寄与してまいります。

1 成長戦略

- 売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE 30%以上を2027年3月期までに達成する中期財務目標を設定
- 資産効率をさらに高め、キャッシュ・フローの拡大に努めることで、ROE向上など高い資本効率を追求
- 創出したキャッシュを社会の持続的な発展を支える半導体の技術革新を生み出すための成長投資、人材投資に活用

2026年3月期は、データセンター向けAI需要の拡大などによる半導体市場の成長を背景に、過去最高の2兆4,435億円の売上高、5,744億円の当期純利益を達成し、ROEも29.6%となりました。また成長投資として、半導体製造装置のさらなる需要拡大に対応した生産能力の向上、そして将来の半導体製造プロセスに向けた技術開発力の向上を目指した設備投資をおこない、東京エレクトロン宮城と東京エレクトロン九州に新開発棟、東京エレクトロン テクノロジーソリューションズに東北生産・物流センターをそれぞれ竣工しました。

今後も、データ社会への移行、生産性向上や新たな価値創出に向けたAI向け半導体市場の拡大により、半導体製造装置市場は中長期的な成長が見込まれております。当社は開発力強化に向けた成長投資を継続してまいります。



東京エレクトロン宮城
第3開発棟



東京エレクトロン九州
プロセス開発棟



東京エレクトロン テクノロジー
ソリューションズ 東北生産・物流センター

中期経営計画 | CFOメッセージ

2

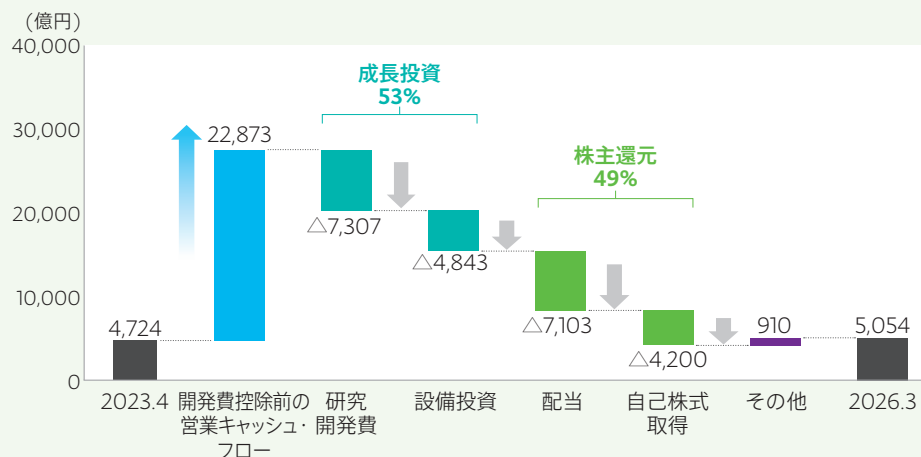
財務戦略

- 事業拡大を見据えた運転資金の確保による経営の安定化
- 強固な財務体質の維持
- 適切なキャッシュアロケーション、バランスシート・マネジメントの追求

当社はこれまで半導体製造装置業界におけるリーディングカンパニーとして大きな成長を遂げてきました。引き続き次の成長投資に向けてキャッシュを有効活用し、中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。

過去3期累計における当社のキャッシュアロケーションでは、開発費控除前の営業キャッシュ・フローとして2兆2,873億円を創出し、およそ53%を成長投資（研究開発費、設備投資）に、49%を株主さまへの還元（配当、自己株式取得）に配分しました。今後も獲得したキャッシュをバランス良くアロケーションし、持続的な企業成長と株主価値の向上を両立してまいります。

■ キャッシュアロケーション（過去3期累計）



3

資本政策

- 自社の企業価値の的確な把握と株価や時価総額の評価
- 資本コストや資本収益性を意識した最適な資本構成の実現
- キャッシュ・フロー拡大に基づく継続的かつ積極的な株主還元の実行

近年の高い利益成長の実績と将来に向けたさらなる成長への期待を背景に、当社の時価総額は高水準となっており、2026年3月末時点の時価総額は17兆5,588億円となりました。また2026年3月末時点のPBR（株価純資産倍率）は8倍以上の水準となっております。当社の企業価値が資本市場で高く評価された結果、純資産と比較して時価総額が大きく増加しました。

過去4期のROEは、目標である30%前後を継続しております。また当社の資本コストは12%程度と見積もっており、ROEから資本コストを差し引いたエクイティ・スプレッドは大幅な超過となっております。

■ 時価総額の推移



4

株主還元策

- 株主さまへの配当については業績連動型を基本とし、親会社株主に帰属する当期純利益に対する連結配当性向50%を目処とする※
- 自己株式の取得については現状のキャッシュポジションや中長期的な成長投資資金、株価水準、総還元額の状況などに鑑み、機動的に実施

※ ただし1株当たりの年間配当金は50円を下回らないこととし、2期連続で当期純利益を生みなかった場合は、配当金の見直しを検討

2026年3月期の株主さまへの総還元額（配当および自己株式取得額）は過去最高の4,374億円、また総還元比率は76.1%となり、高水準の還元をおこないました。

引き続き、高水準の配当と機動的な自己株式の取得による株主還元を通して、株主価値を高めてまいります。

中期経営計画 | 製品事業担当メッセージ



製品事業担当メッセージ

秋山 啓一

コーポレートオフィサー 製品事業担当
専務執行役員

半導体市場は、従来の予測より大幅に前倒して1兆米ドル規模への成長が進むと見込まれています。その成長を牽引するAI向け半導体においては、先端デバイスの進化に加え、先端パッケージングやテストなどの手法も多様化しており、さらなる高性能化や微細化が求められています。このような状況において、当社では半導体の高性能化や微細化を実現するカギとなる多くの主要な前工程製造プロセスを担うポジションを強化すべく積極的に技術開発を進めています。エッチングや成膜などの分野においてWFE※1の成長率を上回る伸びが期待されており、それらを含む前工程事業では多くの開発POR※2を獲得しています。後工程においては、複数のチップを2次元、3次元方向に集積させる先端パッケージングの重要性が一段と高まっています。特にAIが必要とする大量のデータを超高速かつ省電力で移送するための高密度ボンディング技術は、半導体製造における重要な技術転換点として考えられており、高い信頼性と生産性を備えた革新的技術として期待されています。当社は各地域の開発評価センターを活用し、お客さまのニーズに応じた迅速な開発・サポートを提供することで、一層のエンゲージメント強化を図っております。

今後も積極的な技術開発への投資を通じて、半導体市場の成長に強く貢献してまいります。

※1 WFE: Wafer Fab Equipment. 半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程がある。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用する製造装置のこと。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含む

※2 POR: Process of Record

前工程事業

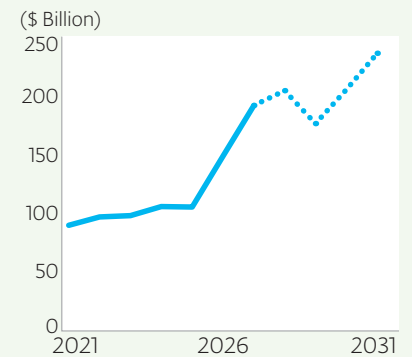
■ 事業機会

AIの進展に伴い、成長が期待される先端ロジックとDRAMにおいてはエッチングのTAM※1の成長率が一段と高まり、成膜においても先端ロジック向けでは高い成長が見込ま

れます。AI向けデバイスの用途の広がり牽引され市場が拡大する中、各デバイスのさらなる高性能化や微細化による高付加価値化が今後も継続していくことが予想されます。2025年に宮城と熊本に新開発棟を、岩手に東北生産・物流センターをそれぞれ竣工するとともに、2027年夏には宮城に生産革新センターの竣工を予定しています。これにより開発能力の強化と生産能力の向上を図り、半導体製造装置市場の成長に備えた体制を整えています。

※1 TAM: Total Available Market

■ 半導体製造装置市場



出典: Technisights (June 2026)

■ 事業戦略

先端ロジックにおいては、成膜・エッチングの精密制御、高選択比のガスケミカルエッチング、エアギャップなどの新構造への対応をおこなうとともに、露光での性能とコストの両立に向けて、EUVのHigh NA (高開口数) 化、マルチパターニングとの併用、レジストへのMOR※2採用、さらにEUV適用回数の最適化を目的とした異方性エッチングの評価を進めていきます。DRAMにおいては、2次元の微細化を成立させるキャパシタ容量の確保のため、高アスペクト比エッチングと、高難度なキャパシタ成膜へのニーズに対応するとともに、新構造の4F²縦型チャネルトランジスタや、3次元構造への変化における成膜、エッチング、ガスケミカルエッチングの技術開発も強化していきます。NANDにおいては、積層数の増加を実現するため、当社の深い穴スリット向けの極低温エッチング開発を強化することに加え、次世代遷移金属材料のワードラインへの適用や、チャネルシリコンの低抵抗化に対応します。高性能化と微細化において極めて重要な役割を果たす多くの技術開発を通じて、半導体の進化に大きく貢献するとともに、新製品の提供により当社事業の参入領域を拡大し、WFEの水準を上回る成長を目指します。さらに、AIとロボティクスを活用した包括的なDXソリューション「Epsira™」を展開し、お客さまと当社の双方で効率的な開発・生産・保守運用ができるよう、さまざまな取り組みを推進していきます。デジタル化に加え、地球環境保全に向けた脱炭素化の両立を図る「デジタル×グリーン」への対応も強化していきます。

※2 MOR: Metal Oxide Resist

中期経営計画 | 製品事業担当メッセージ

前工程事業における当社の優位性

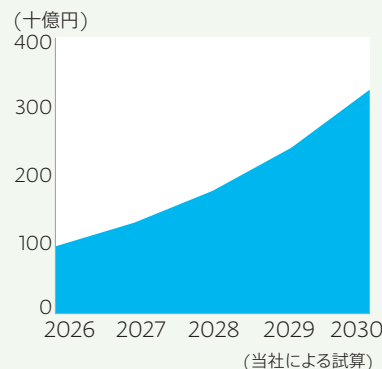
- 高性能化や微細化のカギとなるエッチング、成膜を強い開発体制で実現
- EUVを塗布現像装置と最適化技術で支える
- パターニングにおける4つのキープロセスの先端装置を駆使し全体最適の解を提供

後工程事業

■ 事業機会

近年、すべての先端デバイスの前工程や、後工程における先端パッケージングにおいて、ボンディング技術の採用が進んでいます。先端ロジック半導体においてはBackside PDN^{※1}と呼ばれる裏面配線構造や次世代トランジスタCFET^{※2}、メモリ半導体においてはNAND、DRAMそれぞれにおいて開発が加速しています。また、先端パッケージングにおいては、ウェーハだけでなくダイレベルでのボンディングの重要性も高まっています。例えば、次世代HBM^{※3}やフラッシュ積層メモリ、ロジック半導体や光デバイスの積層において開発、採用が進んでおり、AIデバイスの高性能化に伴いボンディング市場の機会が広がっています。これに伴い、当社が参入しているボンディング工程の製造装置市場は2026年から2030年までの年平均成長率（CAGR）が30%を超える見込みであり、2030年には3,000億円を超える市場規模に達すると予測しています^{※4}。

■ ボンディング工程に関する製造装置市場規模



※1 Backside PDN: Backside Power Delivery Network

※3 HBM: High Bandwidth Memory

※2 CFET: Complementary Field Effect Transistor

※4 当社による試算

■ 事業戦略

当社が提供するボンディング装置は、プラズマ制御や洗浄技術からなるプロセス技術と、メカニカルなアライメント技術が融合されたプロセス装置であり、前工程事業で保有している成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄において培った先端技術や、パーティクル制御など

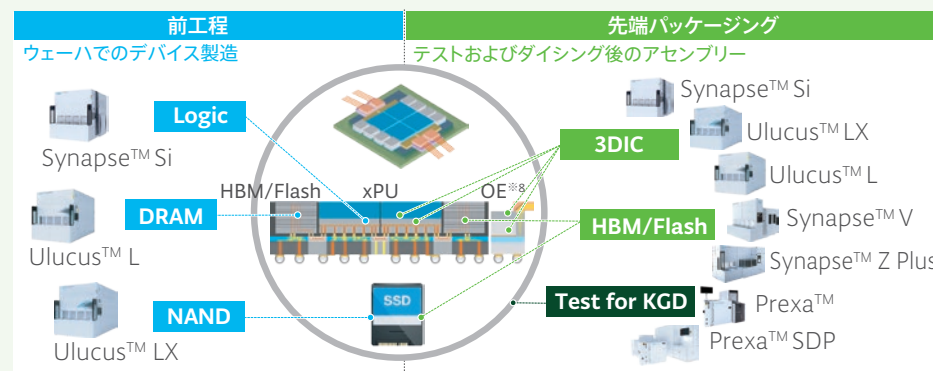
の各種ノウハウを取り入れながら、製品開発を進めています。また、ボンディング市場での事業成長を最大化すべく、ウェーハ永久接合装置「Synapse™ Si」に加えて、プロセス品質やCoO^{※5}の改善に大きな貢献が期待されるレーザエッジトリミング装置「Ulucus™ L」と先端レーザ剥離装置「Ulucus™ LX」をリリースし、お客さまの評価も順調に進んでいます。

さらに、先端パッケージング向けには、ダイレベルでのボンディング装置の開発を加速しており、高精度かつ高信頼性のダイスタックの実現に向け、前処理からボンディングまで一括処理対応可能なクラスター装置を投入予定です。

先端パッケージングにおいては最終歩留まり向上が不可欠であり、そのためには実装前のデバイスを個片化した状態でテストするKGD^{※6}が求められます。先端デバイスにおけるテスト中の吸熱と正確な温度制御の課題に対して、当社は高い吸熱性能を有するデバイスプローバ「Prexa™ SDP^{※7}」の販売を開始しました。ウェーハレベルのソリューションに加えて、ダイおよびデバイスレベルでのソリューションをタイムリーに提供し、相互の融合を通じて、AI向け先端パッケージングにおける最終歩留まり向上を実現していきます。

※5 CoO: Cost of Ownership

※6 KGD: Known Good Die/Device. 良品と判定されたベア・ダイもしくはデバイス ※7 SDP: Singulated Device Prober



※8 OE: Optical Engine for Si Photonics

後工程事業における当社の優位性

- 大きな成長が見込まれるボンディング市場に対し、革新的な製品群を幅広く投入
- 前工程事業で培った技術やノウハウを活用することで、迅速で効果的な開発が可能
- ボンディングとテスト技術を融合することによる、歩留まり向上へのアプローチ

中期経営計画

継続的な企業価値の向上に関する重要指標

中期経営計画において、財務およびサステナビリティに関する指標を「継続的な企業価値の向上に関する重要指標」として明確にし、これらの重要指標と関連する主なマテリアリティを確認しています。CEOが参加する四半期レビュー会議にて定期的に進捗状況やアクションプランの確認をおこない、各指標における責任者のもとさまざまな活動を展開しています。

 当社ウェブサイト「サステナビリティ年度目標と重要指標」 www.tel.co.jp/sustainability/goals-and-results/index.html

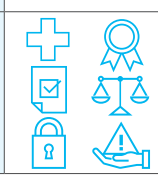
○: 順調に進行中 △: 目標達成に向けて加速が必要

対象分野		指標	達成時期	2026年3月期実績	進捗評価	関連する主なマテリアリティ※1
財務		● 売上高: 3兆円以上	2027年3月期	● 2兆4,435億円	○	
		● 営業利益率: 35%以上	2027年3月期	● 25.6%	△	
		● ROE: 30%以上	2027年3月期	● 29.6%	○	
研究開発		● 5年間で1兆円以上の研究開発費の投入による付加価値の高い next-generation productsの継続的な創出	2027年3月期	● 研究開発費2,778億円	○	
安全		● TCIR※2 0.10未満 (業界グローバル1位)	2027年3月期	● 0.22	△	
環境	事業所	● CO ₂ 総排出量: 85%削減 (2019年3月期比)	2031年3月期	● 64%削減	○	
		● 再生可能エネルギー使用比率: 100%	2031年3月期	● 87%	○	
		● 各事業所におけるエネルギー使用量 (原単位): 前期比1%削減	每期	● 11事業所中、2事業所において達成	△	
		● 各事業所における水使用量 (原単位): 各基準期水準を維持	每期	● 13目標中、6目標において達成	△	
	物流	● モーダルシフトおよび共同配送のさらなる推進による物流全体 (自社配送分) のCO ₂ 排出量: 30%削減	2027年3月期	● 26%削減	○	
		● 製品の木材梱包の使用比率を40%以下に削減 (半導体製造装置の梱包)	2027年3月期	● 52%	○	
	製品	● ウェーハ1枚当たりのCO ₂ 排出量: 55%削減※3 (2022年3月期比)	2031年3月期	● 11%削減	△	
サプライチェーンマネジメント		● サプライチェーンサステナビリティアセスメントの実施率 資材系: 調達額の85%以上 物流系: 通関関連業者100% 人材系: 派遣会社および請負会社 (構内請負) 100% ● アセスメント結果に応じた改善活動の実施	每期	● 資材系: 調達額の85%以上を達成 物流系: 通関関連業者100%を達成 人材系: 派遣会社および請負会社 (構内請負) 100%を達成 ● 調査を実施したすべてのお取引先さまに対してフィードバックレターを配信。 優先度の高いお取引先さまに対しては個別に是正活動を実施	○	
		● サプライチェーンBCPアセスメントの実施率 資材系: 調達額の85%以上 ● アセスメント結果に応じた改善活動の実施	每期	● 調達額の85%以上を達成 ● 調査を実施したすべてのお取引先さまに対してフィードバックレターを配信	○	

※1  マテリアリティ P.25-26 ※2 TCIR: Total Case Incident Rate. 労働時間20万時間当たりの人身事故発生率 ※3 お客さまの再生可能エネルギー導入による削減を含む

中期経営計画

○: 順調に進行中 △: 目標達成に向けて加速が必要

対象分野		指標	達成時期	2026年3月期実績	進捗評価	関連する主なマテリアリティ※1
社員	エンゲージメント	● エンゲージメント・サーベイのスコア: 継続的な改善 (前回比スコア上昇)、もしくは各地域における他社平均値を超えるスコアを達成	毎回	● 全社共通のパルスサーベイの導入 ● エンゲージメント・サーベイ結果の有効活用と「対話文化※2」の促進 ● 全社共通施策として管理職向け「コーチング」トレーニングを開始	○	
		● 社員の定着率※3 日本: 99% 海外: 業界平均以上	毎期	● 日本: 99.1% ● 海外: 96.2% (業界平均以上)	○	
	キャリア	● 一人ひとりが上長や周囲のサポートを実感し、自分の将来 (キャリアパス) をイメージしながらやりたいことにチャレンジし成長することで、会社の成長や社会のために価値創出できる環境を構築 ● オンライン学習年間利用率率 グローバル: 60%	2027年3月期	● キャリアと学習に関する当社独自のウェブアプリ「Seeker」を開発し、一部の本部やグループ会社を導入を開始。キャリア機会を可視化し、その実現に必要なスキル習得をサポートする学習コンテンツやメンターをAIが提案する仕組みを構築し、社員のチャレンジや行動変容を促進。このような取り組みが評価され、「第14回日本HRチャレンジ大賞」において「大賞」を受賞 ● オンライン学習年間利用率率 グローバル: 45.3%	△	
	ワーク・ライフ・バランス	● 有給休暇取得率 日本: ①80% ②90% 海外: 前期実績と同等以上	日本: ①2027年3月期 ②2031年3月期 海外: 毎期	● 日本: 78.0% ● 海外: 83.2% (前期実績 78.9%)	○	
		● 男性育児休業取得率 日本: 85%	2030年3月期	● 日本: 83.5%	○	
	DE&I	● 女性管理職比率 日本: 5% グローバル: 8%※4	2027年3月期	● 日本: 3.8% ● グローバル: 6.8%	△	
コーポレートガバナンス		● 常に最適で実効性の高い取締役会と攻めの経営執行体制を構築し、取締役会の実効性評価や機関投資家などからの意見を踏まえた課題に継続的に取り組むことで、中長期的な企業価値向上と持続的成長に向けた強固なガバナンスを実現	毎期	● 実効性の高い取締役会を目指して ● 監査役会設置会社を継続、社外取締役比率過半数 (8名中5名) を実現、指名委員会で社外取締役候補者とコンタクト継続 ● オフサイトミーティング2回 (8月、3月) ● 取締役会で原則毎回、CEOによる業務執行に関する重要事項を説明 ● CEOミッション: 取締役会メンバーと共有 ● 代表取締役評価に関するクローズド・セッション: 2回 ● 業務執行を支えるオペレーティングリズム ● コーポレートオフィサーズ・ミーティング: 23回 ● CSSミーティング: 3回 ● 四半期レビュー会議: 4回	○	
リスクマネジメント		● 強固な経営基盤を支える実効性の高いリスクマネジメント体制の構築とさらなる改善 ● 「Safety, Quality and Compliance. Our top priority. It's our pride.」の標語を掲げ、リスクマネジメントおよびコンプライアンス遵守を強化	毎期	● 16項目の主要なリスクについて、リスクオーナーや各工場・現地法人の社長と年次でリスク評価を実施 ● 各領域における重要なリスクに対してリスクオーナーと所管部署を中心に対応強化	○	

※1 マテリアリティ P.25-26

※2 対話文化: サーベイを実施して終わりではなく、結果を共有し、受け止め、改善行動に落とし込むプロセスを組織的に循環させる文化 ※3 定年などによる退職は除く ※4 本目標は当社グループの米国地域には適用されません

中長期的な展望

テクノロジーの進化と半導体の未来

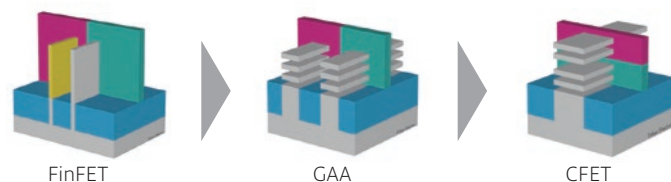
半導体は社会と産業を支える重要な技術です。これまでのIoTやクラウド/エッジコンピューティングによるデジタル化を牽引した「1st Wave」から、現在は、生成AIやAR/VR、自動運転など高度な演算を必要とするアプリケーションがテクノロジードライバーとなる「2nd Wave」に移行しています。これにより、膨大なデータを処理するための半導体需要は一段と高まっており、半導体市場が2030年に1兆米ドル規模に達するという予測は大幅に前倒しされとの見方が広がっています。

一方、半導体市場の成長に伴い電力消費や環境負荷の増大が深刻化しており、大量のデータを処理する半導体の低消費電力化が最優先課題となっています。これらの課題に対応するため、前工程においては微細化を推進することで性能向上を図ります。例えばEUV※1露光の活用や、FinFETからGAA※2やCFET※3などの次世代トランジスタ構造への移行により、素子レベルでの電力効率と高性能の両立を実現します。このためには新材料やプロセスの高度化、設計ルールの最適化、AIを活用したデバイス設計・プロセス制御といった多面的な技術革新が不可欠です。

※1 EUV: Extreme Ultraviolet. 半導体業界では特定の波長13.5nmを使用した露光技術の総称

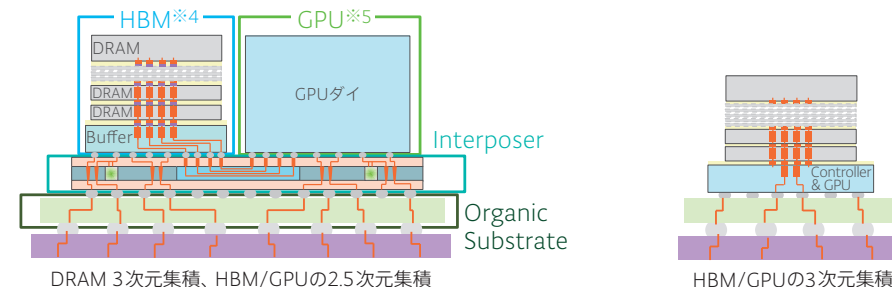
※2 GAA: Gate-All-Around ※3 CFET: Complementary Field Effect Transistor

トランジスタ構造の変化



後工程においてはChipletやヘテロジニアスインテグレーションを含む先端パッケージング技術によって製品の性能・電力・実装密度の最適化を図ります。異なる機能をもつチップの効果的な組み合わせや高密度実装により、システム全体の電力効率と性能を高めることが可能です。また、パネルレベルパッケージは大判基板を用いた高スループットな実装手法で、薄型化やコスト効率の改善に適しています。これらの技術は自動車や通信、AIサーバーなど幅広い領域で歩留まり改善や電力効率向上に貢献します。

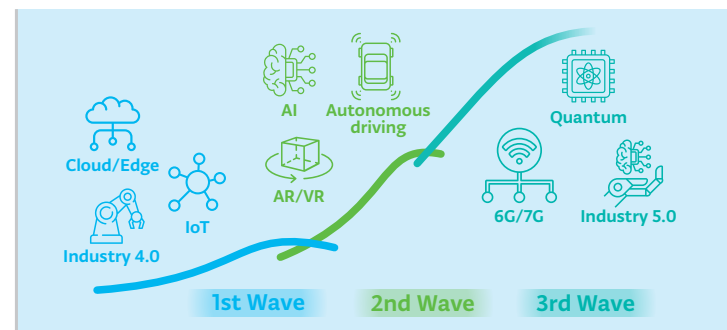
先端パッケージング技術



※4 HBM: High Bandwidth Memory ※5 GPU: Graphics Processing Unit

さらに設計・生産段階でのAI活用により歩留まりとサプライチェーン全体の最適化を推進し、前工程と後工程の取り組みが相互に補完し合うことで、量子コンピューティングや自己学習型AIロボットなどの技術による「3rd Wave」に向けた成長基盤を築きます。

半導体市場の展望



また半導体市場では、高密度化だけでなく、用途に応じた多様かつ最適化されたデバイスが求められています。大規模なデータ処理を担うデータセンターやHPC※6向けの高性能デバイスと、スマートフォンなどのエッジ機器向けの低消費電力デバイスの需要がそれぞれ存在するため、設計・製造・パッケージの各工程における最適化が必要です。加えて、気候変動リスクや原材料・エネルギーの供給リスクに対応するため、デジタル技術を活用したエネルギーの最適化が重要となります。

※6 HPC: High Performance Computing

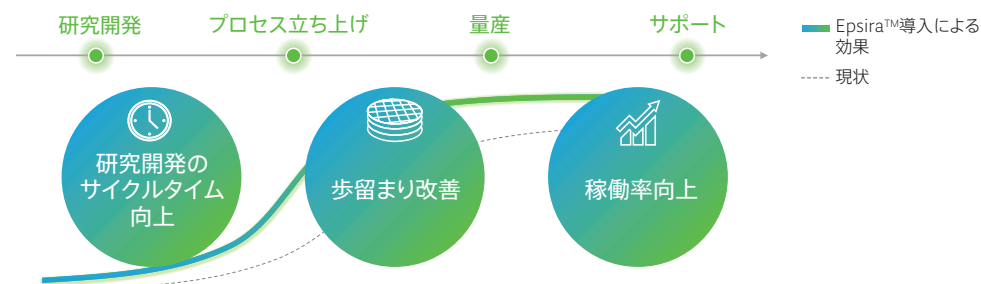
中長期的な展望

半導体製造装置の発展

半導体の進化は、デバイスの高度化と、それを支える製造装置・製造技術の発展が相互に作用することで実現してきました。今後もデバイスの微細化や3次元化が進む中で、製造装置においては、より高い精密制御、高精度なアライメント、ボンディング技術など、ハード面の進化が続いていきます。

一方で、開発期間やコストの削減、さらに世界各地の拠点における装置の早期立ち上げと安定稼働を実現するためには、データやAI、ロボティクスなどを活用したソフト面の革新が不可欠です。研究開発の段階では、データ解析やシミュレーション、AIによる条件予測・最適化を活用することで、実機検証に先立って設計やプロセス条件を絞り込み、試作や実験の回数を減らしながら開発効率を高めています。これにより、開発スピードの向上とコストの削減を同時に実現します。また、装置の稼働データや保守データを活用した分析、予兆検知などにより、装置稼働率の向上や歩留まり改善を図ることも重要です。当社は「Epsira™」の展開を通じて、AIを活用した装置パフォーマンスの最適化や、ロボティクスによる保守作業の自動化などを組み合わせ、製造現場全体のデジタルトランスフォーメーションに取り組んでいます。これまでに培った半導体製造装置の高い専門性とデジタル技術を融合し、お客さまの生産性向上に貢献します。

Epsira™ ビジョン



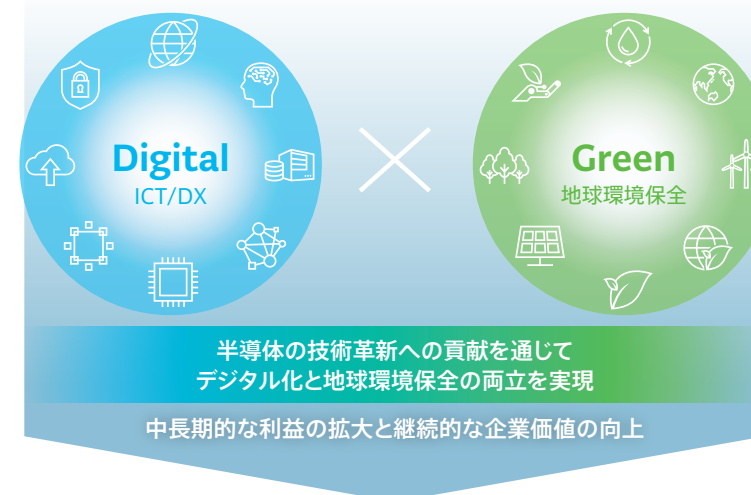
新しい半導体デバイスの構造は装置やプロセス、設計の境界を越えて互いに影響をおよぼします。そのため、トランジスタの構造から配線技術、パッケージの設計までを一貫して検討する「Co-design」の必要性が高まっており、半導体製造装置メーカーにとっては前工程と後工程を含む最適なソリューションの提供がさらに重要になると考えられます。

夢と活力のある会社を目指して

半導体市場は、1st Waveで築かれたデジタル基盤、2nd Waveで加速するAI主導の変革、そして3rd Waveにおける新たなイノベーションにより、今後も大きな成長が見込まれています。

当社は、デジタル化と地球環境保全を両立する「デジタル×グリーン」の実現により、夢のある社会の発展に貢献します。半導体製造装置メーカーとしての高い専門性と価値創出の源泉である社員をはじめとするあらゆる経営資源を戦略的に活用し、革新的な技術をもつ Best Productsと付加価値の高い Best Technical Serviceを継続的に提供します。積極的な開発投資や協業を推進するとともにグローバルなサポート体制を強化し、また産学連携や国際的な仕組みづくりへの貢献などによる業界全体の発展にも寄与していきます。

これからも挑戦と進化を続けることで、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努め、ビジョンの実現による基本理念の実践を通じて、当社を取り巻くすべてのステークホルダーのご期待に応えていきます。



ビジョンを実現し基本理念を実践することで、
会社を取り巻くすべてのステークホルダーのご期待に応える

マテリアリティ

当社はビジョンの実現による基本理念の実践を通じ、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指す上で、優先して取り組むべき重要事項をマテリアリティとして位置づけ、毎年妥当性の確認をおこなっています。また、マテリアリティを軸とした事業活動によるバリューチェーンの展開を通じて、新たな価値の継続的な創出に努めています。

優先して取り組むべき
重要事項
(マテリアリティ)

ビジョンの実現による
基本理念の実践

中長期的な利益の拡大と
継続的な企業価値の向上

マテリアリティの特定プロセス

環境分析・課題の抽出

以下の点を考慮して環境分析をおこない、マテリアリティ候補となる課題を抽出

- 社会における課題
気候変動、人権問題、国家間紛争や地政学上の対立、サプライチェーンマネジメント、技術と倫理、サイバーセキュリティ、物価高騰など
- 事業を取り巻く環境
AIの発展に伴う半導体および半導体製造装置市場のさらなる拡大、地球環境保全への対応、人権尊重の取り組み、コーポレートガバナンスのさらなる強化など
- SDGsの取り組み状況
- ステークホルダーとのエンゲージメント
→ P. 27
- 事業活動における重要リスク
→ P. 65-66

重要性の評価

抽出した課題について、ステークホルダーへの影響や関心を踏まえた「企業が社会や環境に与える影響度」と、継続的な企業価値の向上を見据えた「当社の業績や企業価値への影響度」の二軸で重要性の評価を実施



マテリアリティの特定

- コーポレートオフィス・ミーティングにおける討議と決議
- 取締役会での報告と承認
- 重要事項と評価した課題をマテリアリティとして特定

マテリアリティの検討プロセスについては、第三者である専門家の助言を受けています。

マテリアリティ

特定したマテリアリティ

当社および社会におけるインパクトを確認するとともに、継続的な企業価値の向上に関する重要指標※1やバリューチェーンとの関連性、取り組むSDGs※2を整理し、さまざまな取り組みを推進しています。

マテリアリティ	当社におけるインパクト	社会におけるインパクト	主な取り組み	マテリアリティ	当社におけるインパクト	社会におけるインパクト	主な取り組み
 Climate Change and Net Zero 気候変動とネットゼロ	ネットゼロの達成に向けた事業活動や製品・サービスにおける環境負荷の低減	気候変動リスクの低減と技術・人材・産業などにおける新たな機会の創出	環境 → P. 52-56	 Employee Engagement 従業員のエンゲージメント	価値創出の源泉である社員のパフォーマンスの最大化	リスクの低減やイノベーションの創出などによる経済成長の促進	人材 → P. 48-51
 Product Energy Efficiency 製品の環境性能	製品の環境性能強化およびプロセス性能との両立による製品競争力の向上	環境に配慮した製品の提供による地球環境の保全	研究開発 → P. 29-32 環境 → P. 52-56	 Safety First Operation 安全第一のオペレーション	安全を最優先とすることによる持続的なオペレーションの実現	社会基盤としての安全の構築	据付・保守サービス → P. 41-44 安全 → P. 61
 Best Products with Innovative Technology 革新的な技術をもつ Best Products	革新的な技術をもつ付加価値の高い製品の創出による優位性の確立	半導体の進化による技術革新の促進と社会の発展	研究開発 → P. 29-32 調達・製造 → P. 33-36	 Quality Management 品質マネジメント	高度な品質マネジメントの実践による経営効率の向上	生産性の向上や環境負荷の低減などによる持続可能な社会の構築	調達・製造 → P. 33-36 品質 → P. 62
 Best Technical Service with High Added Value 付加価値の高い Best Technical Service	お客さまの課題を解決する高度なフィールドソリューションの提供による事業機会の拡大	半導体製造における歩留まりや生産性の向上と装置稼働率の最大化	据付・保守サービス → P. 41-44	 Compliance コンプライアンス	法令・規制の遵守による安定的な事業運営と信頼性の向上	社会的責任の実践による社会の健全性向上	コンプライアンス → P. 67-68
 Customer Satisfaction and Trust 顧客満足と信頼	お客さまの唯一無二の戦略的パートナーとして相互利益を拡大	お客さまの価値創造や継続的な成長、産業のさらなる活性化	販売 → P. 37-40	 Ethical Behavior 高い倫理観に基づく行動	社会から高く評価され、従業員が誇りをもてる企業として発展	公正で秩序のある社会の形成	人権 → P. 57-58 コンプライアンス → P. 67-68
 Supplier Relationship サプライヤーリレーションシップ	お取引先さまとの協業による付加価値の創出とサプライチェーンの安定化	サプライチェーン全体における健全性の維持や優位性の強化	調達・製造 → P. 33-36 環境 → P. 52-56 サプライチェーンマネジメント → P. 59-60	 Information Security 情報セキュリティ	安全・安心にデータを活用できる環境を整備し継続的かつ確実に事業を展開	情報の利便性と安全性の確保による社会インフラの安定化	情報セキュリティ → P. 64
 Respect for Human Rights 人権の尊重	事業活動における人権リスクの低減・排除と、いきいきと活動できる企業文化の醸成	差別や不平等、労働や安全などの人権に関わる社会課題の解決	人権 → P. 57-58	 Enterprise Risk Management エンタープライズリスクマネジメント	事業上のリスクの適切な管理と対応によるレジリエンスの強化	リスクの排除や低減による経済や社会の継続的な発展	リスクマネジメント → P. 65-66

※1  継続的な企業価値の向上に関する重要指標 P. 21-22

※2  当社ウェブサイト「マテリアリティ」 www.tel.co.jp/sustainability/materiality/index.html

ステークホルダーエンゲージメント

当社では、ステークホルダーとの対話の機会を積極的に設け相互コミュニケーションを図ることにより、ステークホルダーからの要請や期待を的確に把握し事業活動を展開しています。社会における役割と責任を確実に果たしていくことで、当社を取り巻くすべてのステークホルダーとの確固たる信頼関係の構築に努めています。

ステークホルダー	ステークホルダーとの関係性	ステークホルダーへの提供価値	主なエンゲージメント機会
株主・投資家さま	- 株主・投資家さまは、当社に資本を提供するとともに、建設的な対話や株主総会での議決権の行使を通して、株主・投資家さま視点でのご意見やご要望、当社への期待を明示 - 当社は、経営ビジョンや成長シナリオを共有するとともに、株主・投資家さまからいただいたご意見やご要望を経営に生かし、企業価値の向上を図る	- 事業活動により創出した利益の還元 - 中長期的な成長の実現による企業価値の向上	- 決算説明会/中期経営計画説明会/IR Day - IRカンファレンス/IRロードショー※1/個別IR取材 - 株主総会 - 国内外の主要な半導体やテクノロジー関連の展示会で併催される投資家向けイベント（CEO登壇） ※1 IRロードショー：株主・投資家さまを直接訪問するIR活動
お客さま	- お客さまは、当社が提供する半導体製造装置を購入するとともに、装置のメンテナンスなどに必要なサービスを利用 - 当社は、製品やサービスおよびソリューションの提供のみならず、お客さまと複数世代にわたる技術ロードマップを共創し、共同で技術開発を実施	- 革新的な技術をもつBest Products - 付加価値の高いBest Technical Service - 安全と品質を重視し、環境に配慮した製品やサービス - 多様なアプリケーションに対応するソリューション	- 技術交流会 - 共同開発 - 顧客満足度調査
お取引先さま	- お取引先さまは、当社の事業運営において必要な資材や人材、また通関やロジスティクスなどの役務を提供 - 当社は、お取引先さまが提供する資材や役務などを購入するとともに、それらの開発や改善および品質向上に協働して取り組む。また労働、環境、安全衛生、倫理などに配慮したサステナブルなサプライチェーンを構築	- 当社との協働による製品やサービスの付加価値の向上と社会課題への取り組みの推進 - 半導体製造装置市場における事業機会 - サプライチェーン全体における健全性の維持や競争力の強化	- 生産動向説明会 - TEL/パートナーズデイ/TEL E-COMPASS Day - サステナビリティアセスメント - STQA※2監査 ※2 STQA: Supplier Total Quality Assessment
社員	- 社員は、個々の能力を生かし、また教育機会の活用などにより成長を図ることで、企業価値の向上に寄与 - 当社は、社員のやる気を重視した経営のもと、エンゲージメントの向上を推進	- 夢と活力に満ち、組織と個人における相互信頼のもと存分に能力を発揮できる職場環境 - キャリア形成やスキルアップの機会 - 公正な人事評価と成果に見合った報酬	- 社員集会 - グローバル・エンゲージメント・サーベイ - 研修やワークショップ
地域社会	- 地域社会は、地場産業の発展や人材の育成などを図り、地域社会としての価値向上に努める - 当社は、事業を展開する地域において雇用機会の創出や環境保全の取り組み、納税などにより、地域社会の発展に貢献	- 人材育成と雇用機会 - 地域における環境保全の推進 - 納税による財務的な貢献	- TEL FOR GOOD (社会貢献活動) - 事業所見学会 - 環境報告会
行政機関・各種団体	- 行政機関・各種団体は、法令や条例、業界行動規範などの遵守を企業に求めるとともに、企業と連携し産業全体および国や地域レベルでの発展を目指す - 当社は、事業を展開する国や地域において、法令や条例、業界行動規範などを遵守した事業活動をおこなうとともに、社会の要請を的確に捉え、課題解決や発展に貢献	- 産業や社会の課題解決や発展に貢献するソリューション - 法令や条例、業界行動規範などを遵守した事業活動	- 政府・行政機関との連携 - 国際的なイニシアティブやNGOなどとの協働 - 業界団体における活動

Chapter 3

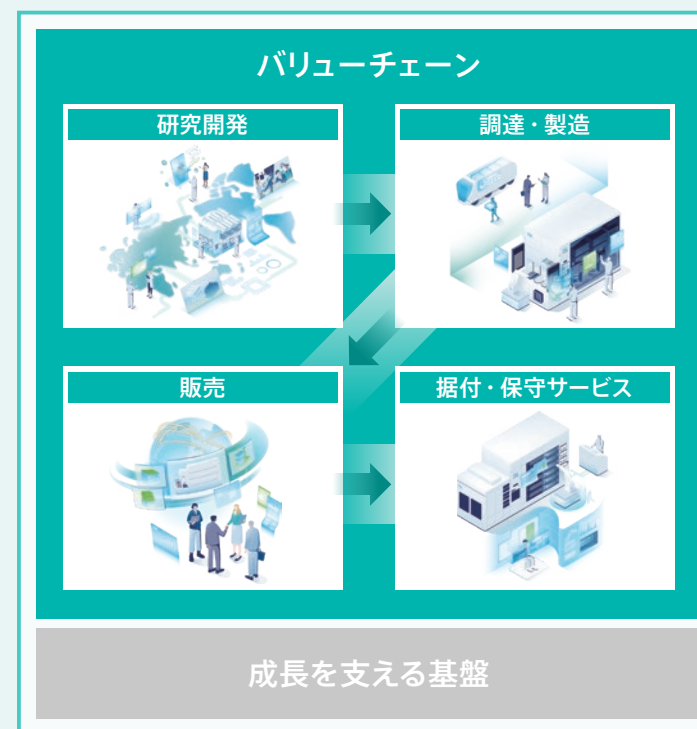
バリューチェーンの取り組み

29 研究開発

33 調達・製造

37 販売

41 据付・保守サービス



当社は、特性を生かした優位性の高いビジネスモデルを構築し、各責任者のもと、研究開発、調達・製造、販売、据付・保守サービスにおけるバリューチェーンを展開しています。中長期的な価値創造における重要テーマの取り組みをグループ全体で推進し、継続的な企業価値の向上に努めています。

研究開発

Message

技術革新のスピードが速い半導体業界においては、付加価値の高い技術や製品を先んじて開発し、市場に投入することが求められます。当社は、今後10年から20年先の世界や技術をバックキャストし、技術変化点に向けた付加価値の高い研究開発をおこなっています。中長期の開発ロードマップに基づいたリソースの投入により、より競争力の高い技術やサービスの創出に努めています。加えて、昨今のAIによる高度化や効率化に積極的に取り組むことで、開発をさらに加速していきます。

「デジタル×グリーン」のもと、環境への配慮と製造技術の進化の両立は、半導体産業の今後の発展においても、また当社の成長においても必要不可欠であり、その実現に向けて優秀な人材の確保と育成が重要です。当社は、これまで産業を支えてきた経験豊かな人材と多様な専門性を備えた人材との融合により、さらなる研究開発の強化を図り、企業価値の向上を目指していきます。



瀬川 澄江

執行役員
コーポレートイノベーション本部
ディビジョンオフィサー



研究開発

中長期的な
価値創造における
重要テーマ

Shift Leftの推進による
付加価値の高い
技術・製品の
タイムリーな開発

開発効率のさらなる
追求と人材育成の強化

投入する経営資源

知的資本

研究開発投資 2025年3月期から5年間で

1.5 兆円以上



知的資本

研究開発拠点

19 (国内8、海外11)



人的資本

半導体製造装置に関する

さまざまな専門分野の
知見を備えた人材



差別化ポイント

戦略的な研究開発

開発効率

協業体制

知的財産

→ 知財・無形資産 P. 47

創出価値

最先端の半導体製造に寄与する
革新的で付加価値の高い
独自技術

高スループット、高稼働率、
省スペースなどにおいて
優位性の高い装置

ネットゼロの達成に貢献する
環境性能

関連する主なリスク項目

→ リスクマネジメント P. 65-66

リスク **2**

研究開発

リスク **9**

知的財産

リスク **11**

人材

リスク **14**

M&A

研究開発

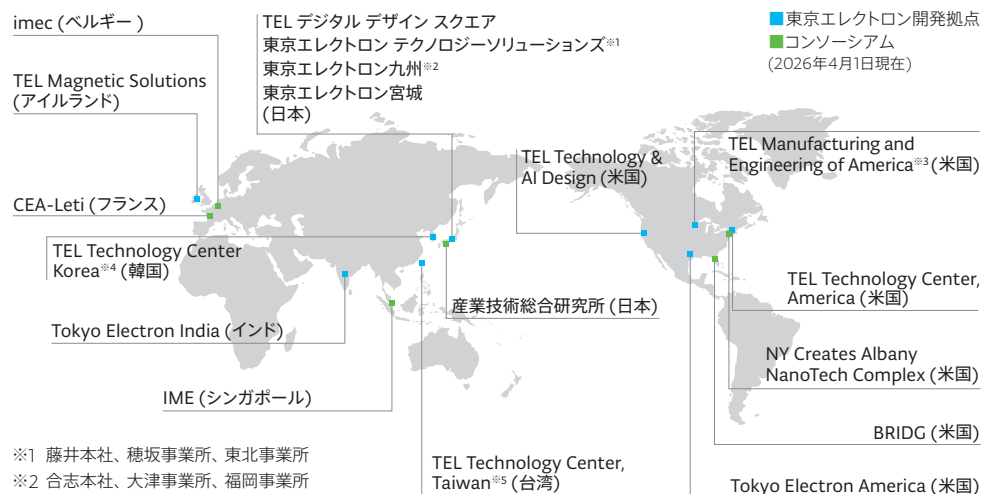
重要
テーマ

Shift Leftの推進による付加価値の高い技術・製品のタイムリーな開発 / 開発効率のさらなる追求と人材育成の強化

戦略的な研究開発の展開

付加価値の高いnext-generation productsをタイムリーに市場に投入すべく、当社ではコーポレートイノベーション本部が中心となり、国内外の開発拠点やコンソーシアムと連携し、戦略的な研究開発を展開しています。

研究開発拠点



※1 藤井本社、穂坂事業所、東北事業所

※2 合志本社、大津事業所、福岡事業所

※3 Chaska Head Office, Chelmsford Office

※4 TEL Technology Center Korea-Wを含む

※5 TEL Technology Center, Taiwan-Tを含む

EUV技術の実用化に向けたHigh NA対応の研究開発

当社は、EUVを用いた最先端プロセスの実装を支えるため、露光装置単体の性能向上への貢献のみならず塗布・現像、マスク、計測・補正など周辺工程を含む統合的なプロセス設計を研究開発の中核に位置づけています。具体的には、フォトレジスト (感光材) の性能評価

や、塗布現像装置とプロセス条件の最適化、ならびに露光後の微細パターンの計測精度向上にも取り組んでいます。塗布プロセスにおいては、塗布現像装置の制御と工程パラメータの最適化により膜厚の均一化を図り、材料面では高感度で安定したフォトレジストの組み合わせ評価を進めています。これらの検証は、試作回数を抑え効率的におこなうため、計画的な実験設計とデジタルツインや解析ツールの活用により進めています。

High NA (高開口数) EUVへの対応では、より高い解像度に向けた取り組みとして、レチクルやフォトレジスト、露光条件の相互作用に関する評価を推進しています。具体的には、ウェーハ上のパターンが微細パターンに与える影響を実機や実証データに基づいて解析し、マスク検査法[※]の改善に向けた知見の蓄積を進めています。また、光学特性とプロセス反応を組み合わせた評価により、解像度向上とスループット維持の両立に向けたプロセス条件や装置制御手法の検証に取り組んでいます。

近年、世界の主要な研究拠点や先進的な半導体メーカーでHigh NA EUVの導入が加速し、微細化の取り組みが一層進んでいます。このような状況において、当社はHigh NA領域における塗布・現像、各プロセス処理・計測の最適化に注力しています。実機やパイロットラインで得られるデータを活用し、プロセスの安定化やスループットの確保に貢献する評価手法と装置制御を検証するとともに、共同研究を通じて実装における課題を早期に解決する体制を強化しています。

これにより、2nm世代以降の最先端ロジックや高密度メモリ向けの材料・装置・プロセスの包括的な対応力を高め、微細化によるさらなる性能向上を実現していきます。

さらに、EUV露光の前後工程の最適化を進めています。成膜やエッチング、洗浄などの前後工程が露光後の仕上がりに与える影響を考慮し、歩留まりに関する改善手法を提供しています。半導体メーカーや材料メーカー、研究機関と連携した共同実験でこれらの手法を確認し、量産導入時に生じる可能性のある課題の解決に前倒しで取り組んでいます。

※ マスク検査法: 半導体の回路パターンを焼き付けるために使用されるフォトマスクの欠陥や寸法精度、位置のずれを調べる技術

研究開発

重要
テーマ

Shift Leftの推進による付加価値の高い技術・製品のタイムリーな開発 / 開発効率のさらなる追求と人材育成の強化

■ 先端パッケージングとパネルレベルパッケージ対応のための装置・プロセス技術

半導体製造においては、微細化だけでなく、複数チップの組み合わせで機能を拡張する先端パッケージングの重要性が高まっています。当社は前工程で培った成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄などの先端技術、またアライメント技術を後工程装置に取り入れ、ボンディング品質やアライメント精度、ウェーハ薄化工程の信頼性を高める研究開発に注力しています。ボンディングにおいては、接合面の事前処理によって接合強度や電気的なつながりを確保する技術開発や、接合後に生じる歪み低減の条件設計、安定した接合品質を実現する装置設計に取り組んでいます。位置合わせ精度の向上には、赤外線カメラや高精度センサー、画像処理アルゴリズムといった計測・解析技術を活用するとともに、安定した高精度実装の実現に向けた研究開発を進めています。ウェーハ薄化工程では、バックグラインディング（裏面研削）、CMP※（化学機械研磨）、エッジトリミングなどの各プロセス条件の最適化に取り組み、歩留まり向上を図っています。

近年注目されているパネルレベルパッケージにおいては、大判パネルで多数のパッケージを一括生産する方式により生産性が向上すると考えられる一方、パネル反りやチップ配置のずれ、膜厚や配線の均一性などの課題があります。当社はパネル搬送や反り補正技術の適用により、均一塗布を実現し、材料メーカーやコンソーシアムと協働しながら量産適用性の確認をおこなっています。また歩留まり改善に向けて、良品選別、熱管理の強化、検査精度の向上により生産効率と製品信頼性の向上に取り組んでいます。

※ CMP: Chemical Mechanical Polishing

■ パネルレベルパッケージによる生産性の向上

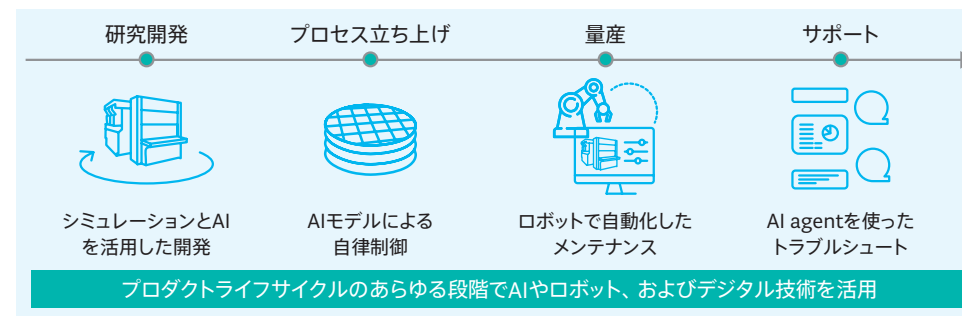


Epsira™を中心とするDXとイノベーションの加速

半導体工場の増加に伴う需要の拡大に対応するため、当社は研究開発から、お客さまへの装置納入後の立ち上げ、量産に至るまで、多岐にわたりDXソリューション「Epsira™」を展開しています。

研究開発においては、開発効率向上のためシミュレーションとAIを積極的に活用しています。半導体製造装置のチャンバー設計では、試作に先立ちデジタルによる仮想空間で安定したプロセスを実現するための最適な寸法や形状を検討します。このようにシミュレーションとAIにより設計の最適化をおこなうことで、試作回数や開発期間の削減を図っています。またプロセス開発では、デバイス構造の複雑化・微細化に伴い、目標とするプロセス結果を得るための評価工数や期間が大幅に増加しています。これに対し、プロセスインフォマティクスを導入することで、実験回数を抑え効率的に目標を達成する取り組みを進めています。加えて、大量の材料候補から新材料を探索するマテリアルズインフォマティクスにも取り組んでいます。これらの取り組みにより成功確度の高い開発を実現するとともに、試作回数や実験回数の削減を通じて環境負荷の低減にも貢献できると考えています。当社グループ独自のDX基盤の整備をおこない、研究開発のサイクルタイム短縮を目指すとともに、全社における利用促進と普及を進めています。

Epsira™の展開



調達・製造

Message

当社では、持続可能で強靱なものづくりの実現に注力しています。コーポレート生産本部は製造会社間の共同運営によりサプライチェーンの可視化や最適化を推進し、安定調達や法令遵守、リスク部品管理の強化に努めています。営業部門と製造部門の受注予測に関する情報を共有することにより欠品削減と生産平準化を図るとともに、お取引先さまとの連携による技術革新とネットゼロの達成に向けた環境負荷低減に取り組んでいます。さらに、Smart ProductionやOne-touch立ち上げ、技術標準化、生成AIの導入などにより製品品質と生産性を飛躍的に向上させ、ワールドクラスの製造オペレーションの実現を目指しています。



林 伸一

取締役
コーポレートオフィサー 開発生産担当
専務執行役員
第三開発生産本部 ディビジョンオフィサー
コーポレート生産本部 ディビジョンオフィサー



調達・製造

中長期的な
価値創造における
重要テーマ

お取引先さまとの
確かな信頼関係に基づく
価値の共創

Smart Production
構想の実現による
ワールドクラスの
製造オペレーションの確立

投入する経営資源

製造資本・人的資本

半導体製造装置の事業において
長年培ったノウハウ
(人・モノ)



製造資本

最新のデジタル技術を駆使した
製造基幹システム



社会関係資本

お取引先さまとの
強固な協業関係



差別化ポイント

品質と信頼性

持続可能な調達活動

高生産性の追求

ネットゼロに向けた
取り組み

創出価値

最先端技術を備えた
高品質、高信頼性の製品

安定的かつ効率的な
製造オペレーションによる
生産リードタイムの短縮

地球環境保全への貢献

関連する主なリスク項目

→ リスクマネジメント P.65-66

リスク 4

調達・生産・供給

リスク 5

安全

リスク 6

品質

リスク 7

環境対応

調達・製造

重要
テーマ

お取引先さまとの確かな信頼関係に基づく価値の共創

持続可能なものづくり戦略

コーポレート生産本部では、高品質な製品をより効率的に製造するため、国内外の主要な4つの製造会社による共同運営体制を構築し、「安全品質」「調達」「生産」「One-touch立ち上げ」の各テーマにおいてスピーディな連携と持続可能なものづくりを実現しています。

また、各製造会社の拠点の周辺にはサプライチェーンクラスター（供給網）が形成されています。生産・調達・出荷における共同配送により輸送距離の短縮などをおこなうことで環境負荷を低減するとともに、設計・開発も含め一貫した付加価値の高いものづくりをお取引先さまとともに推進しています。



お取引先さまとのコミュニケーション

当社では、持続可能なサプライチェーンの構築には、お取引先さまとの強固なパートナーシップが不可欠と考え、さまざまなコミュニケーションの機会を創出しています。

名称	開催頻度	主催	対象企業	主な内容
TELパートナーズデイ	年1回	コーポレート生産本部	パートナー企業さま	経営方針、技術動向、調達方針など
生産動向説明会	年2回	各製造拠点	主要なお取引先さま	生産計画、サステナビリティの取り組み
TELサプライヤーサミット	不定期	コーポレート生産本部	コア技術に関わる重要なお取引先さま	技術状況の協議、環境への取り組み

当社は、内閣府や経済産業省、中小企業庁などが推進する「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」の趣旨に賛同し、「パートナーシップ構築宣言」を公表しています。受託中小企業振興法に基づく振興基準の改正に伴い、2026年4月10日付で当社の宣言文を改定しました。今後もお取引先さまとの連携・共存共栄を進めることで、持続可能なサプライチェーンの構築とサプライチェーンにおける付加価値の向上に努めていきます。

2026年3月期に開催したTELパートナーズデイにおいては、生産活動にご貢献をいただいたお取引先さま6社を「エクセレントパートナー」、環境活動・E-COMPASS活動にご協力をいただいたお取引先さま2社を「環境パートナー」として表彰しました。



TELパートナーズデイの様子



エクセレントパートナー表彰盾



環境パートナー表彰盾

調達・製造

重要
テーマ

Smart Production構想の実現によるワールドクラスの製造オペレーションの確立

ワールドクラスの製造オペレーション

当社は、社内外の環境変化に柔軟に対応し、お客さまのご期待に応えるべく、コーポレート生産本部を中心に以下のテーマにおいて取り組みを推進し、「ワールドクラスの製造オペレーション」の実現を目指しています。



安全品質

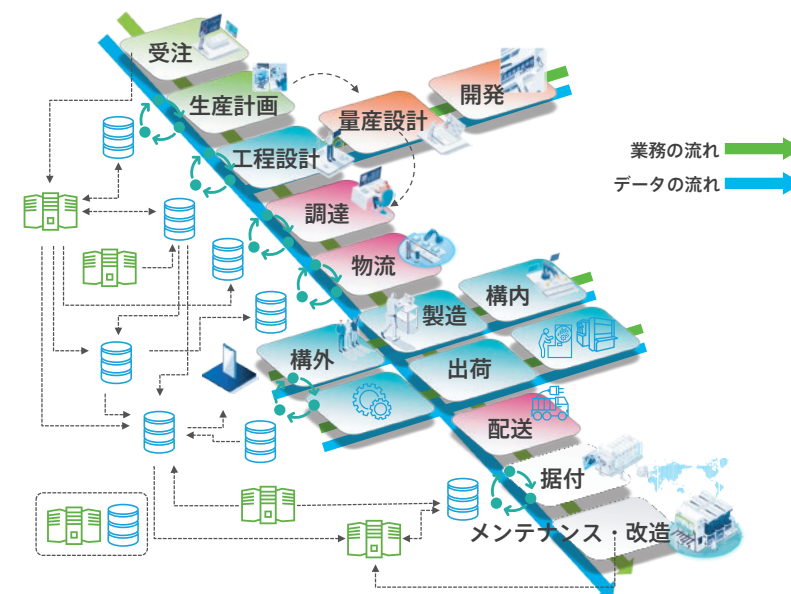
当社は、Shift Left (フロントローディング) の推進により、プロジェクトごとにおこなっていたリスク抽出を、全社的にリスクを一元化し共有する設計プロセスへ移行することで、リスクの抽出漏れの防止に取り組んでいます。また、装置不具合やフィールド不具合に関するKPIを新たに設定し拠点間での横展開を進めるとともに、グループ全体におけるKPIのトレンド分析をおこない改善を図ることで、さらなる品質向上に努めています。



生産

当社はSmart Production構想の実現に向け、受注から製造、ならびにお客さまの拠点での装置据付やメンテナンスに至るまで、バリューチェーン全体を対象とした生産革新に取り組んでいます。生産データの連携・活用や情報の可視化を通じて、製品品質や業務品質の向上を図るとともに、自動化・標準化の推進により、生産性の大幅な向上を追求しています。

Smart Production ビジョン



調達

半導体製造装置事業においては、サプライチェーンマネジメントの重要性がより一層高まっています。安定的な調達や法規制の遵守、リスク部品の把握に向けたサプライチェーンの可視化、また各製造会社間の連携による調達プロセスや部品コスト、部品在庫の最適化などに取り組んでいます。加えて、社会的責任と環境に配慮しながら、サプライチェーン全体で持続可能な調達活動を展開しています。

One-touch
立ち上げ

当社は「One-touch立ち上げ」の実現に向け、設置・接続の簡素化や、計測・制御技術の開発による立ち上げ期間の短縮と作業品質の向上、また人為的な事故のリスクや作業ミスの低減を図っています。装置の立ち上げ後のプロセスチューニングの自動化や自律化により高品質な装置を短納期で引き渡すとともに、メンテナンス時間の短縮により稼働率を向上させることで、お客さまにおけるさらなる生産性の向上に貢献します。

販売

Message



大庭 誠

執行役員
Account Sales本部
ディビジョンオフィサー

AI時代の到来にあたり、当社が保有する最先端製品ポートフォリオを生かし、半導体高性能化の課題に対して、Best Products、Best Technical Serviceを単一工程のみならず統合的に提供することで、お客さまとの相互利益の拡大を目指します。その実現に向け、常にお客さまの声に耳を傾け、寄り添うことで、長期的な成長とともに実現し、より良い未来の共創に取り組んでいきます。

Message



神永 文彦

常務執行役員
Global Sales本部
ディビジョンオフィサー

当社は、最先端のプロセスからパワー半導体まで幅広い技術領域をカバーしています。数百社におよぶ大規模な顧客基盤を生かし、データセンター、車載、エネルギー分野をはじめ、AR/VR、シリコンフォトニクスなどの多様化するアプリケーションに向けて、タイムリーかつ最適な提案をおこなっています。お客さまと中長期的なロードマップをともに作成し、最適なソリューションの提供を通じて持続的な価値創造に貢献してまいります。



販売

中長期的な
価値創造における
重要テーマ

Best Products、Best
Technical Serviceの
提供による相互利益の拡大

顧客対応力と
顧客満足度の向上

投入する経営資源

知的資本

Account Sales本部、Global Sales本部、および
ビジネスユニット、海外現地法人などが連携した
**グローバルセールス・
サービス体制**



知的資本

多種多様な製品ラインアップから生まれる
**幅広い知見と
総合的な技術力**



社会関係資本

長年の実績に基づく
お客さまとの信頼



差別化ポイント

お客さまとの共創

グローバルオペレーション

最適なソリューション

当社独自の
顧客満足度調査

創出価値

4世代およびその先を見据えた技術の
同時並行評価による革新的な技術を備えた
付加価値の高い製品

多様なアプリケーションに対応する
製品群 および複数工程を統合した
最適なソリューション

グループ全体での緊密な連携による
唯一無二の戦略的パートナー

関連する主なリスク項目

→ リスクマネジメント P.65-66

リスク 1

市場変動

リスク 3

地政学

リスク 10

情報セキュリティ

リスク 16

拠点展開

販売

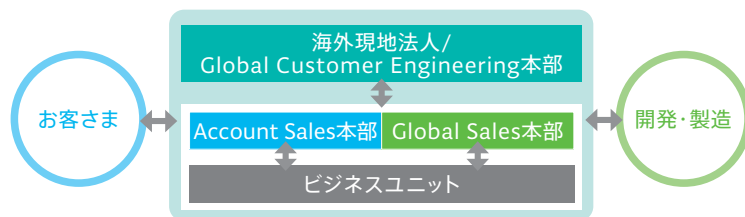
重要
テーマ

Best Products、Best Technical Serviceの提供による相互利益の拡大

グローバルオペレーションの展開

当社は、お客さまにとって唯一無二の戦略的パートナーとなるため、Account Sales本部とGlobal Sales本部を設置し、お客さまの求める技術やサービス、ソリューションなどの迅速な提供に努めています。Account Sales本部では、昨今のAIデバイス市場の活況を牽引するメモリ、ロジック、ファウンドリ事業などの大手半導体メーカーのお客さまより次世代最先端技術に関するニーズをご共有いただき、先端技術開発につなげています。また、Global Sales本部では、急成長する中国市場や産業用IoT市場向けの製品を取り扱う国内外のお客さまのご要望に対応しています。

これらの本部と、ビジネスユニットや開発・製造部門、サービス部門や海外現地法人などが緊密に連携することで、包括的な販売活動をおこなっています。お客さまの経営層から現場のエンジニアまで広くコミュニケーションを図りながら対応力のさらなる強化に取り組み、ONE TELとしてグローバルオペレーションを展開しています。



幅広い製品ラインアップを生かした提案活動

当社は、前工程における成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄といった4つのキープロセスの装置や、後工程における検査やボンディング/デボンディングプロセスの装置など、幅広い製品ラインアップを展開しています。これらを生かした提案活動をおこなうことでお客さまの課題を解決し、競争優位性の高い半導体製造の実現に貢献します。

前工程においては、①バッチ、セミバッチ、枚葉の特性を生かしながら新材料や新構造に

対応し、最適な膜厚および膜質制御を可能とする成膜装置、②最先端のHigh NAを含むEUV露光に対応する塗布現像装置、③微細な構造への精密加工や高選択比の深い穴や溝の加工を実現するエッチング装置、④微細なパターンを倒壊させることなく歩留まり低下の要因となる異物や残渣を除去する洗浄装置を中心に、革新的かつ究極のプロセス性能をもった装置開発を進めています。

後工程においては、ウェーハ検査工程で使用するウェーハプローバや3次元実装を実現するボンディング/デボンディング装置なども取り揃えています。今後は生成AIサービスの性能向上と応用範囲の拡大に向けて先端ノードを用いた微細化技術とともに半導体のさらなる高性能化が求められます。その高性能化を実現するために、個片化した半導体を組み合わせた先端パッケージング技術 (Chiplet) の導入が加速しています。当社ではChipletに不可欠なKGD※向けテスト装置も取り揃え、個片化デバイスのボンディング工程へのソリューションの提供も積極的に進めていきます。

Chipletを含む今後のデバイスの微細化に向けて、当社は前工程・後工程の幅広い製品ラインアップおよび工程間を統合したプロセスインテグレーションによりお客さまの課題に対するソリューションを提供していきます。

※ KGD: Known Good Die/Device。良品と判定されたベア・ダイもしくはデバイス

前工程

成膜

EVAROS™



Episode™ 1

LEXIA™-EX

塗布・現像

CLEAN TRACK™
LITHIUS Pro DICE™CLEAN TRACK™
LITHIUS Pro™ Z

エッチング

Certas LEAGA™



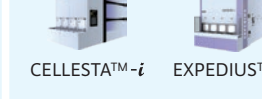
Tactras™

Episode™ UL

洗浄

CELLESTA™-i

EXPEDIUST™-i



後工程

ウェーハボンディング
Synapse™ V/Z Plus

Synapse™ Si

レーザ加工

ウェーハプローバ

Prexa™

Ulus™ L/LX

デバイスプローバ

Prexa™ SDP

Prexa™ SDP

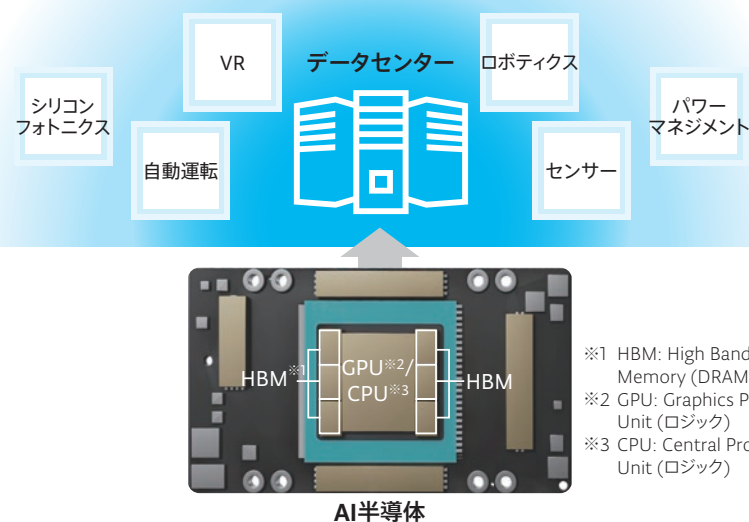
販売

重要
テーマ

顧客対応力と顧客満足の上

多様化する半導体市場への展開

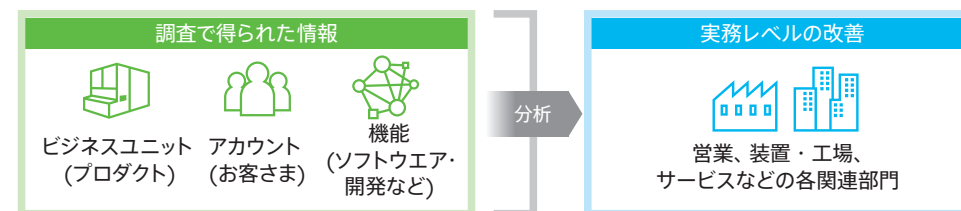
近年、AIデータセンター向けの先端ロジック、メモリ、先端パッケージングを中心に、その周辺機器であるシリコンフォトニクスやパワーマネジメント、また自動運転やVR、各種センサー、さらに将来のロボティクス向けなど、半導体市場は急速に拡張・進化しています。用途ごとの専門化と連携が進み、エコシステム全体の変化とともに付加価値も拡大しています。このような状況において、当社は先端機能を実現するための独自の技術をもつ装置を提供するとともに、新たなアプリケーションや機能の拡がりに対しても、豊富な出荷実績や経験、最新技術の導入などにより、最適な製品群を提供します。また、納入済装置の生産性向上やライフサイクル延長など、多様なソリューションの提案もおこなっています。



顧客満足向上の取り組み

当社は、創業以来の重要なテーマである顧客満足向上の取り組みによりお客さまとの確固たる信頼関係の構築に努めています。お客さまである半導体メーカーと将来の技術ロードマップを共創し、4世代およびその先を見据えた技術の同時並行評価を推進することでShift Leftの技術開発を加速させるとともに、コストの最適化にも努めています。これによりお客さまの価値創造に資する最適なソリューションの提供、および半導体デバイスの歩留まり向上や装置稼働率の最大化などお客さまの生産性向上に貢献する優位性の高い製品の提供を実現しています。また、世界各地のお客さまの拠点に当社のカスタマーエンジニアを配置し、納入装置が早期に最大限の性能で稼働するためのサポートを提供するとともに、特定した技術課題に対する効果的なソリューションの提案や次世代装置開発へのフィードバックをおこなうなど、お客さまに寄り添った取り組みを継続的に実施しています。

これらの活動を展開するとともに、当社独自の顧客満足度調査※を毎年実施しています。2026年3月期の調査では約1,800名(回答率84.2%)のお客さまからご回答いただき、得られた情報を分析して実務レベルの改善を実行するPDCAサイクルを展開しています。



このような活動が高く評価され2026年3月期も多くのお客さまから引き続きベストアワードを受賞しました。今後も革新的な技術をもつBest Productsと付加価値の高いBest Technical Serviceを提供し、顧客満足のさらなる向上を追求していきます。

※ 当社ウェブサイト「顧客満足」 www.tel.co.jp/sustainability/customer/satisfaction/index.html

据付・保守サービス

Message

当社は、今後も拡大が見込まれる市場において、最先端技術を搭載した新規装置や業界最大規模の出荷済装置に対して、安全で高品質かつ付加価値の高いBest Technical Serviceを提供していきます。安全については、各種の安全活動を継続的にグローバルで展開しています。また、人的リソースを有効活用するため、ビジネス状況に応じた人材配置や、DXソリューション「Epsira™」による業務効率の改善を実施しています。さらに、Epsira™をデータ解析やナレッジマネジメントにも活用し、お客さまのニーズを的確に捉え、迅速にソリューションを提供することで、絶対的な信頼の獲得を目指します。このような取り組みを推進することで、最先端装置のみならず、多種多様なアプリケーションに対応するさまざまな世代の装置の安定稼働と生産性向上に貢献するBest Technical Serviceを提供し、顧客満足および企業価値のさらなる向上に努めていきます。



郡 宗一郎

執行役員
Global Customer Engineering本部
ディビジョンオフィサー



据付・保守サービス

中長期的な
価値創造における
重要テーマ

人材の育成強化と
東京エレクトロンらしさの
継承と進化

付加価値の高い
Best Technical Serviceの
提供による顧客満足の向上

投入する経営資源

知的資本

18の国と地域・**102**拠点
におけるサービスサポートの
基盤



知的資本

デジタル技術やナレッジマネジメントなど
を活用した
サービスデータベースと
リモートサポート体制



人的資本

Global Customer Engineering本部
総勢約**6,300**名
によるオペレーション



差別化ポイント

フィールドエンジニア

納入実績

DXによる効率化

装置のライフサイクル

創出価値

グローバル展開による
装置納入からメンテナンスまでの
一貫したサービス

さまざまな世代にわたる
装置の長期安定稼働への貢献

お客さまの生産性向上に寄与する
高い技術力を生かしたサービス

関連する主なリスク項目

リスクマネジメント P.65-66

リスク 5

安全

リスク 6

品質

リスク 11

人材

リスク 16

拠点展開

据付・保守サービス

重要
テーマ

人材の育成強化と東京エレクトロンらしさの継承と進化

フィールドエンジニアの顧客対応力の強化

さらなる事業規模の拡大に対応するため、フィールドエンジニアを増員し戦力としていち早く活躍できる人材の育成や、既存のフィールドエンジニアのスキル向上を効果的に図ることが極めて重要です。また、グローバルな視点でリソース配分を最適化し、需要の高いエリアに重点的に人員を配置することや、高い専門性をもつ人材を必要とするエリアへ適切に配置転換することが不可欠です。

地政学的要因や国策による投資支援を背景に、事業展開をグローバルに進めるお客さまや、新たに半導体産業に参入するお客さまが増加しており、サポート拠点のさらなる拡充の重要性が高まっています。それぞれのニーズや特性を理解した上で、現地法人やビジネスユニットの枠を超えて、必要な能力をもつ人材や適切なリソースをアサインし、お客さまの生産能力の向上に貢献する体制を構築しています。



当社ではSEMI (国際半導体製造装置材料協会) の基準を満たしたグループ共通のスキル管理体制を構築し、毎年細かく設定された目標に基づいて継続的なスキル向上に取り組んでいます。また、当社のフィールドエンジニアに求められるスキルと経験を入社後3年間で獲得する「一人前育成プログラム」によって、採用した人材を効果的に育成します。さらに、海外現地法人向けエキスパートエンジニア教育として、国内製造拠点でトレーニングを受けたエンジニアを帰国後に現場に再配置するプログラムを展開しています。このプログラムでは、エンジニアが装置技術に関する知識を深めるとともに、開発・製造部門とのコミュニケーション強化も図ります。プログラム期間中も、所属する海外現地法人のエンジニアを日本から支援することで、お客さまの状況をタイムリーに把握し、帰国後すぐに現場リーダーとして活躍することができます。

これらの取り組みにより、当社のサービスは、迅速性や効率性、また献身的な姿勢などの点においてお客さまから高い評価をいただいています。今後もお客さまからのフィードバックを顧客対応力の強化に生かしていきます。

知識や経験の共有による新たな価値の創造

当社では、若手・中堅社員が自らキャリアパスや将来像を描ききっかけとなるよう、業務経験の豊富な社員がこれまでのキャリアを通じて習得した学びや気づきを社内イントラネットに公開しています。この取り組みを海外現地法人へ展開し、顧客第一主義や風通しの良さ、チームワークといった当社のDNAを、グローバルの若手・中堅社員に継承し、時代の変化に対応しながら新たな価値の創造を目指しています。



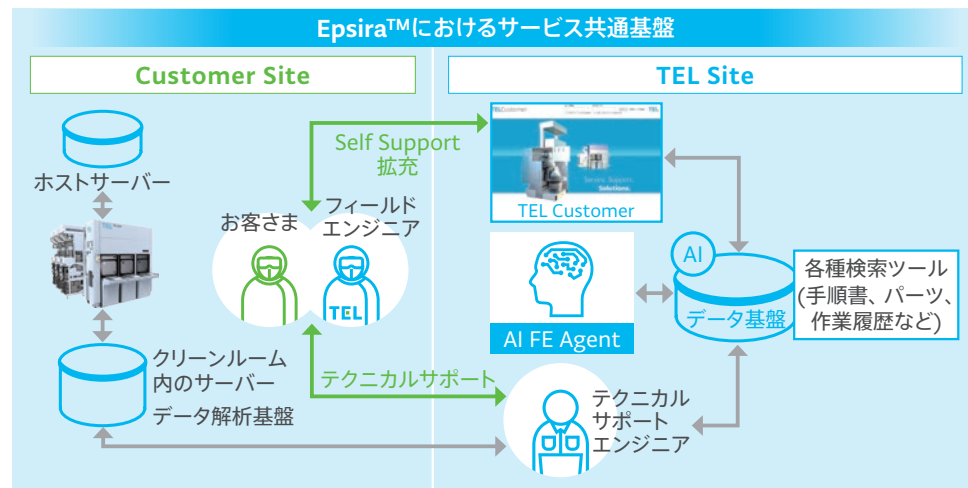
据付・保守サービス

重要
テーマ

付加価値の高いBest Technical Serviceの提供による顧客満足の上

付加価値の高いBest Technical Serviceの提供

近年では、半導体デバイスの微細化・高積層化を実現する製造プロセスに対する高度なサポート技術の提供や、さらなる生産性の向上、環境負荷の低減などに関するお客さまからのご要望が増えています。これらのご要望にお応えする付加価値の高いBest Technical Serviceを提供するため、フィールドエンジニアの育成に加え、DXソリューション「Epsira™」を展開し、デジタル技術や情報通信技術を活用したサービスの提供、および業務効率の改善を図っていきます。



日々のサービスサポートにおける作業履歴や装置に関する各種情報は、グローバルに一元化して管理しています。一元化されたデータを有効活用するために、データ基盤の開発を進めるとともに、その基盤を活用するための各種DXツールの導入やクリーンルームからのアクセスの整備も進めています。

フィールドエンジニアは、各種ツールを用いてデータ基盤から過去のトラブル対応事例や

作業手順書、作業・改造履歴にアクセスし、トラブルシューティングの精度向上やトラブル解決時間の短縮を図ることで、迅速かつ高品質なサービスの提供に役立てています。また、お客さまのクリーンルーム内にいるエンジニアを遠隔支援するリモートサポートツールを展開し、装置データを効率的に解析することで、効果的なサポートを能動的に提案していきます。このようなEpsira™の展開を推進し、お客さまの生産性向上に取り組んでいきます。

当社では、お客さまの製造拠点にフィールドエンジニアが常駐して装置の保守をおこなうサービス、従量課金や定額課金による保守作業、また保守部品・消耗部品の提供、部品のリペアを総合的におこなう包括契約型サービス (TEL SERVICE ADVANTAGE™) など、装置の安定稼働に向けたさまざまな契約型サービスを提供しています。さらに、装置から出力されるデータを集約して分析し、主要部品の故障時期の予測や事前の交換提案をおこなうことで、トラブル発生の未然防止やプロセス性能の安定化を図り、お客さまの装置稼働率向上への貢献に努めています。

さらなる現場の安全性向上に向けた取り組み※1

当社は、労働時間20万時間当たりの人身事故発生率を示すTCIR※2が0.22と半導体製造装置業界トップクラスの安全環境を実現しています。フィールドエンジニアから報告されるヒヤリ・ハット事例 (事故に直結する可能性があった危険な事象) とヒューマンエラーによる事故を詳細に分析し、事故の未然防止に役立つ情報を各現地法人の安全推進部門と共有することで、現場の安全活動の向上に取り組んでいます。また、世界各地に新設される半導体工場へ日本から安全担当者を適宜派遣し、現地担当者とともに、チェックリストを使ったクリーンルーム内外のアセスメントをおこない、安全な環境を整えることに努めています。さらに、組織全体の安全意識を醸成するため、VR技術や動画オンデマンド配信システムなど、デジタル技術を活用した教育をすべてのエンジニアに定期的に実施しています。

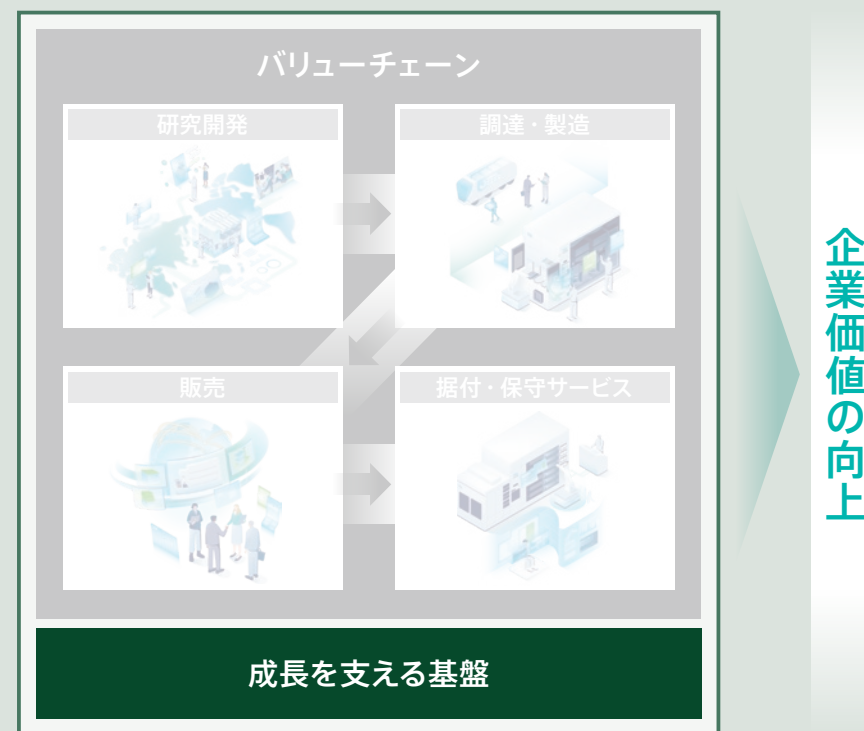
※1 安全 P.61

※2 TCIR: Total Case Incident Rate

Chapter 4

成長を支える基盤

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 46 サステナビリティの展開 | 63 デジタルトランスフォーメーション (DX) |
| 47 知財・無形資産 | 64 情報セキュリティ |
| 48 人材 | 65 リスクマネジメント |
| 52 環境 | 67 コンプライアンス |
| 57 人権 | 68 資本市場との対話 |
| 59 サプライチェーンマネジメント | 69 コーポレートガバナンス |
| 61 安全 | 77 社外役員座談会 |
| 62 品質 | |



当社では、短期および中長期的な成長を支える基盤としてサステナビリティの活動を展開しています。事業戦略と連動したさまざまな取り組みを実施し、ビジョンの実現と基本理念の実践に向けて、攻めの経営基盤を構築します。

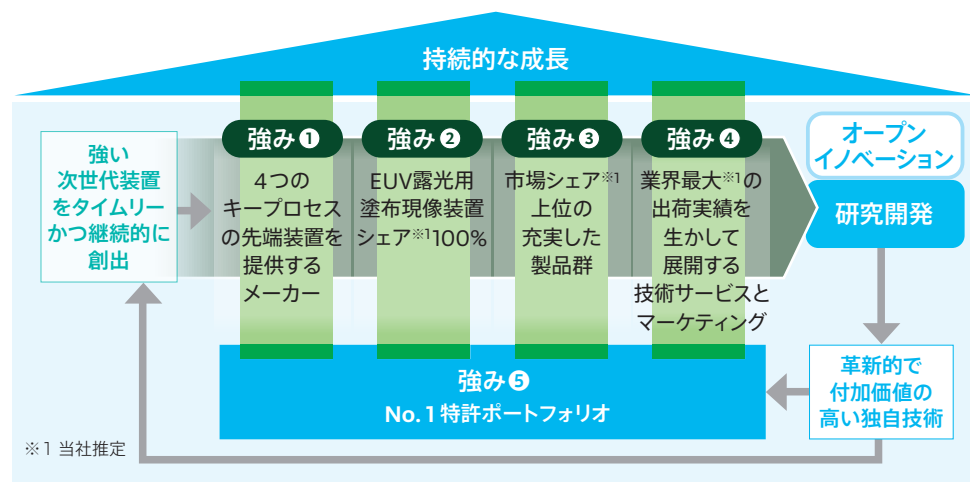
サステナビリティの展開

当社におけるサステナビリティの取り組みはビジョンの実現による基本理念の実践です。サステナビリティの取り組みについて以下のガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標からなる4つの枠組みで整理し、活動を展開しています。

4つの枠組みにおける主な活動内容	ガバナンス 	● サステナビリティ統括部を本社のコーポレート企画本部に設置し、グループ全体でサステナビリティの取り組みを展開 ● サステナビリティグローバル会議を年2回開催。国内グループ会社や海外現地法人において、サステナビリティ全般の取りまとめをおこなうサステナビリティマネージャーが参加し、全社方針に沿った取り組みの共有やグローバルプロジェクトの推進などについて討議 ● サステナビリティ担当執行役員を委員長とするサステナビリティ委員会を年2回開催。ディビジョンオフィサーおよび国内グループ会社・海外現地法人社長などが参加し、サステナビリティに関するリスク・機会の検討や短・中長期目標の管理、サステナビリティ関連方針の策定や個別テーマに関して承認。重要案件については執行側の最高意思決定機関であるコーポレートオフィサーズ・ミーティングで決議 ● グループ全体のサステナビリティの取り組みについて適宜取締役会にて報告をおこない、取締役会はそれを監督
	戦略 	● 企業の独自の資源と専門性を生かして社会課題を解決するCSV=TSV (TEL's Shared Value) の考えに基づき、事業活動において社会的価値と経済的価値を融合することにより中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を実現 ● 優先して取り組む重要事項をマテリアリティとして特定※し、当社の強みを最大限に生かしながら、マテリアリティを軸とした事業活動によるバリューチェーンを展開 ● さまざまなサステナビリティの取り組みを推進するとともに、革新的な技術をもつBest Productsや付加価値の高いBest Technical Serviceの提供により、産業や社会の課題解決や発展に貢献 ※  マテリアリティ P. 25-26
	リスク管理※ 	● 半導体を取り巻く地政学や市場変化などのさまざまなリスクに適切かつ迅速に対応するとともに、持続的な成長を実現すべくリスクマネジメント体制を構築 ● より実効的な活動を推進するためコーポレートリスクマネジメント推進室 (CPRO) をコーポレート企画本部に設置し、エンタープライズ・リスクマネジメントを展開 ● 事業を遂行する上で直面しうるリスクについて、将来を見据えた十分な検討をおこなうことでその影響を最小化するのみならず、それらを事業機会として捉え、適切に対応 ● 事業活動におけるさまざまなリスクを当社グループへの影響度と発生可能性から網羅的に洗い出し、主要な16のリスク項目として特定するとともに、各リスクオーナーを設置。またCEOや各ディビジョンオフィサーが参加する会議体において特に課題がある項目について取り組み状況の確認と改善策を討議 ※  リスクマネジメント P. 65-66
	指標と目標 	● 中期経営計画における継続的な企業価値の向上に関する重要指標※1およびサステナビリティ年度目標※2を設定 ● 重要指標および年度目標の達成状況や今後の取り組みについてCEOが参加するレビュー会議にて定期的に確認 ● 各指標や目標の責任者のもと、達成に向けた活動を継続的に展開 ※1  継続的な企業価値の向上に関する重要指標 P. 21-22 ※2  当社ウェブサイト「サステナビリティ年度目標と重要指標」 www.tel.co.jp/sustainability/goals-and-results/index.html

知財・無形資産

知財・無形資産の位置づけと取り組み



当社では、技術革新が成長を牽引する半導体業界において持続的な成長を実現するためには、研究開発力およびその成果物を含む知財・無形資産の強化が不可欠と考えています。当社は4つの強み(図①~④)を生かして研究開発を進めており、さらに、国内外のお客さま、コンソーシアムやアカデミアとの積極的な協業(オープンイノベーション)を推進し、多様な知見や技術を当社の研究開発に取り込むことで、革新的で付加価値の高い独自技術を生み出しています。これにより、当社の生命線である次世代装置をタイムリーかつ継続的に創出することができ、5つ目の強みである特許ポートフォリオ(図⑤)の戦略的構築を可能としています。

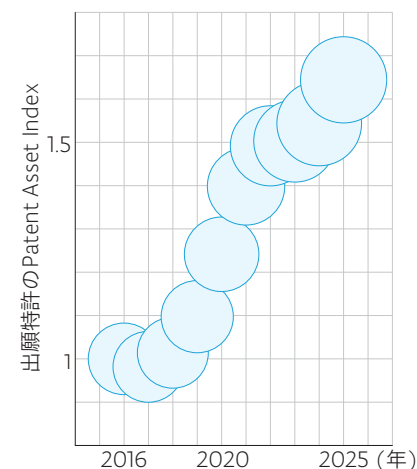
当社では2025年に日本で1,415件、海外で345件の発明が創出され、年々増加傾向にあります。また、直近5年で300件弱の発明が協業により生まれています。グローバル特許出願率は7年連続で約75%を維持するとともに、昨今のグローバルサウス市場の拡大に対応し、これらの地域への出願も強化しています。許可率※2は、日本で84%、米国で83%に達しており、2026年3月末時点の特許保有件数は26,592件と、半導体製造装置業界でNo.1を維持しています。

当社の特許ポートフォリオは、他社への影響力や技術的価値の上昇度においても高く評価されており、Clarivate「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」(5年連続)およびLexisNexis「Innovation Momentum 2026: The Global Top 100」(4年連続)に選出され

ています。こうした競争力のある特許ポートフォリオは、5つ目の強みとして4つの強みを支えることで、中長期的な企業価値向上の基盤として重要な役割を果たしており、当社の持続的な成長を後押ししています。

※2 2025年算出値

TELのPatent Asset Index (PAI※3) 推移



※3 特許ポートフォリオ競争力の指標として、LexisNexis社が提供するPatent Asset Index (PAI) を利用。2016年のPAIを1.0とし、円の大きさは特許ポートフォリオサイズを示す

知的財産ガバナンス体制

当社は、国内外の主要開発拠点と本社に配置された知的財産部門が連携し、研究開発部門や事業部門と密接に協働することで、技術革新と市場ニーズを的確に捉え、知的財産ポートフォリオの戦略的構築を進めています。さらに発明者の知的財産創出活動を促進するため、独自の表彰制度※を設けています。初めて特許出願に至った発明者から、特に優れた模範となる発明者まで、さまざまなステージに合わせて表彰をおこなうことで、積極的な知的財産創出活動や発明精神の継承を推進しています。

また、取締役会やコーポレートオフィサーズ・ミーティングにおいて、知的財産活動や知的財産リスクに関する報告を定期的実施し、経営層との連携を通じた知的財産ガバナンス体制の一層の強化に努めています。

※ 当社ウェブサイト「発明者表彰制度」 www.tel.co.jp/rd/intellectualproperty/index.html

人材

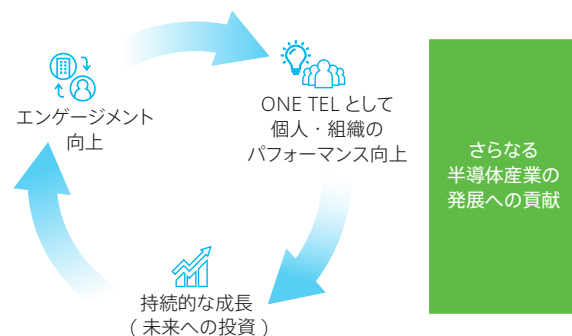
持続的成長を支える人材戦略

当社は「企業の成長は人。社員は価値創出の源泉」という考えのもと、経営戦略と人材戦略を連動させています。創業以来、事業環境の変化に迅速に対応しながら、時代をリードする独創的な技術で半導体産業の発展に貢献し、成長してきました。この成長を支えた確かな原動力は、社員一人ひとりのやる気と、未知の領域に挑戦する姿勢です。

持続的な成長と企業価値の向上には、半導体の技術革新を牽引する高い技術力が不可欠です。この実現に向け、当社は2025年3月期からの5年間で1.5兆円以上の研究開発投資をおこない、人材採用ではグローバルで10,000名とする成長投資計画を設定し、取り組みを進めています。

人材戦略の中核は「やる気重視経営」であり、ワールドクラスの利益に基づく業績連動報酬などを通じて、成果を出す意欲と行動を後押ししています。また、社員の自律的な学びを支援するTEL UNIVERSITYを通じて専門性を継続的に高めることで、革新的な技術をもつBest Productsの提供や、付加価値の高いBest Technical Serviceの実現につなげています。このような個人の成長と企業の成長の循環が、当社の持続的な価値創造を支える基盤となっています。AIなどの高度な技術が実現する利便性と地球環境保全の両立を目指し、多様な個性が融合する「ONE TEL」として夢のある社会の発展に貢献していきます。

やる気重視経営による好循環の創出



社員エンゲージメント

当社はやる気重視経営のもと、社員のパフォーマンスの最大化や企業の持続的な成長の実現に向け、社員エンゲージメントの向上に注力しています。エンゲージメントに関する施策の効果を知るため、エンゲージメント・サーベイを隔年で実施しており、得られた結果をもとに「重点課題の特定」「施策実行」「効果検証・改善」のサイクルを循環させることで、社員一人ひとりが能力を最大限に発揮し、いきいきと働くことができる環境づくりに取り組んでいます。2025年3月期に実施したエンゲージメント・サーベイのスコアは、2016年3月期から19ポイント向上しており、結果をもとに「キャリア機会の充実」「人材の獲得と適切な配置」に関する取り組みを重点的に進めています。またエンゲージメント・サーベイの中間期において施策の実行と改善状況を把握するため、2026年3月期からパルスサーベイを導入しました。これにより実施状況を可視化し、さらなる改善が必要な組織や部署に対する支援を強化していきます。



採用

当社は、半導体需要の高まりと、それを支える製造装置の性能向上や安定生産への対応を見据え、2025年3月期からの5年間で10,000名の採用を目指す大規模な増員計画を進めています。この計画の実現には、世界中の企業や研究機関が求める優れた半導体人材の確保が不可欠です。そのため単なる採用競争にとどまらず、産学官連携を通じた次世代人材育成を促進する仕組みの構築が求められています。当社はこうした未来に向けた取り組みの一環として、日米大学間パートナーシップ「UPWARDS^{※1}」に参画し、半導体技術分野における人材育成と研究開発を推進しています。さらに、大学や高等専門学校などのアカデミアに加え、人工知能学会、SEAJ^{※2}、福岡半導体リスクリリングセンターなどさまざまな半導体関連機関でセミナーを開催し、幅広い学びの機会を提供しています。これらの取り組みにより、将来の半導体技術革新を支える人材や研究者の育成に貢献するとともに、多様な視点をもつ人材が業界をリードしていくための基盤づくりを目指しています。

※1 UPWARDS P.51

※2 SEAJ: Semiconductor Equipment Association of Japan. 日本半導体製造装置協会

人材

人材育成・キャリア

当社は、急速に変化する事業環境を踏まえ、グローバルに活躍できる人材の育成に注力しています。社員一人ひとりの能力を最大限に発揮させるため、組織的な人材開発の仕組みを構築し、多様な背景をもつ社員の潜在能力を引き出すことで、企業全体のイノベーション力を高めています。また、社員の自発的なキャリア形成と自己実現を後押しする制度を整備し、社員が主体的に目標を設定し成長できる環境を提供することで、やる気の維持を図っています。

■ TEL UNIVERSITY

TEL UNIVERSITYは、全社的な人材育成の基盤として2007年に設立された内部教育機関です。社員一人ひとりが自らの成長やキャリアを考え、学び続けることを支援するとともに、技術力と人材力の両面から当社の価値創造を支える人材の育成に取り組んでいます。



■ TEL UNIVERSITY体系図

	新人・若手	中堅	管理職・高度専門職・幹部	経営
階層別教育	導入教育 (新卒・中途)			
	OJTプログラム (新卒・中途)			
	若手育成	中堅社員教育	マネージャー教育	
			リーダー教育	
目的別教育	技術教育 (セミナー・ワークショップ)			
	ビジネススキル			
	グローバルコミュニケーション			
	キャリアサポート			
	全社必須 ウェブ教育			

■ オンボーディングの強化

新卒/若手育成プログラム

当社では、大規模な人材採用を見据え、新卒および若手社員一人ひとりが早期に活躍できるよう、TEL UNIVERSITYを中心とした育成プログラムを展開しています。企業理念や価値観の理解に加え、社会人として必要な基礎知識・スキルを段階的に習得できる研修を、入社1年目から3年目にかけて体系的に実施しています。

これらの取り組みを通じて、当社グループの一員としての意識醸成を図るとともに、自ら学び成長し続けようとする姿勢を育み、社員エンゲージメントの向上につなげています。

キャリア入社向けプログラム

当社は、グローバルな事業成長と人材基盤の強化を両立させるため、キャリア入社社員の受け入れを積極的に進め、早期戦力化を支援するオンボーディング施策を拡充しています。国内ではTEL UNIVERSITYにおいて「Welcome to TEL Meeting!」を実施し、当社の歴史や企業文化、理念に加え、自社製品や技術への理解を深める機会を提供しています。また、グループワークやディスカッションを通じて、部門や拠点を越えた人的ネットワークの形成を促進し、新たな環境においても安心して能力を発揮できる土台を築いています。こうした取り組みにより、多様なバックグラウンドをもつ社員がやる気を発揮し、成長できる環境を整えています。

■ DX人材育成

業務プロセスにおけるデジタル活用の重要性が高まる中、DXが企業の競争優位性につながるとの認識のもと、当社ではDXに関する基礎的な知識や考え方の習得を目的に、2022年からグローバル全社員を対象とした必須教育「DX基礎教育」を展開しています。また、生成AIをはじめとするデジタル技術の進展に伴い、社員がAIを適切に理解し活用することが重要となっています。2027年3月期から新入社員研修にAIリテラシー研修を導入しており、AIについて適切に理解・活用できる基盤づくりを全社的に進めています。

人材

■ 新しいキャリアデザイン

2024年から、当社独自のキャリアと学習のポータルアプリとして「Seeker」の導入※を開始し、グローバル展開を進めています。SeekerではAI機能を活用し、個々の学習履歴や目標に応じた学習コンテンツを推奨することで社員のチャレンジ意欲を喚起します。このようなツールを通じて、社員が将来の「ありたい姿」を明確にし、その実現に向けたキャリアプランを設計して必要なスキルを効率的に習得できるよう支援しています。このような取り組みが評価され、「第14回日本HRチャレンジ大賞」において「大賞」を受賞しました。

※ 一部の本部やグループ会社で導入



キャリア設計

社員はSeeker内の多様な先輩社員や同僚のキャリア事例を参考にしながら、自身のキャリアの方向性を定めます。各グループにまとめられた職種情報を参照して、「ありたい姿」を実現するために経験すべき職場やステップを確認できる他、生成AIやメンターにキャリアに関する質問をおこなうことで、自身のキャリア実現に必要なことをより明確にすることができます。



スキル獲得

社員は上長と相談の上、自身の「ありたい姿」の実現に向けて、強化したいスキルを設定します。上長は社員の希望を踏まえながら、経営戦略に基づいた業務を割り当てます。設定したスキルに応じて最適な学習コンテンツやメンターが推薦され、得られた知見を実務に生かすことで、社員は効率的にスキルを習得することができます。



■ キャリア形成の支援

次世代経営者の育成

当社は中長期的な企業価値向上を支える次世代経営者の早期発掘と計画的な育成に注力しています。候補者には社外研修や異業種交流を含む学習機会を提供し、視野の拡大や外部ネットワークの構築を支援しています。これらの取り組みにより、グローバルに事業を展開する企業として、多様な価値観や環境変化に対応できる人材の育成につなげています。併せて、経営層が計画的にアサインメントの検討やレビューをおこない、本人の意欲や段階に応じた経験を得られる機会を提供することで、成長を後押しする仕組みづくりを進めています。

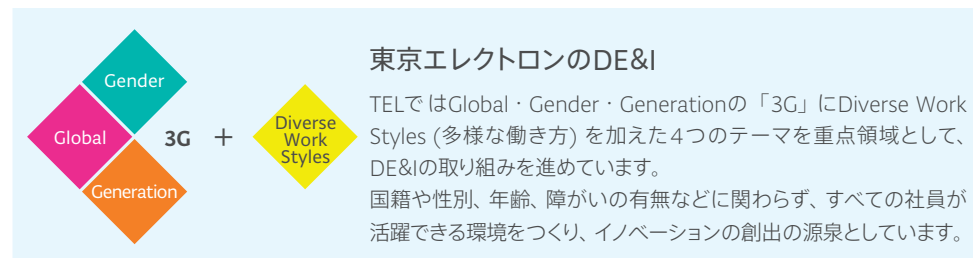
高度専門人材の育成

高度な専門技術・スキルを企業競争力の重要な源泉と位置づけ、専門性を軸としたキャリア形成の仕組みとしてTCL (Technical Career Ladder) を導入しています。チーフエンジニアやエキスパートなどで構成されるTCLは、専門性を生かした成果を正当に評価し、本人の意欲や強みに応じたキャリアの選択を可能にしています。TCLの運用を通じて、自身の専門性を発揮し続けられる環境を整えるとともに、技術交流会や技術ワークショップなどのプログラムを通じて専門的な知見が事業や組織の成長に結び付くことを目指しています。

ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン (DE&I)

当社では経営層の強いコミットメントのもと、継続的なイノベーションの創出や企業価値の向上につながる重要な取り組みとして、DE&Iを積極的に推進しています。「ONE TEL, DIFFERENT TOGETHER™」をスローガンに、国籍、性別、世代を大きなテーマとして捉えた3G (Global・Gender・Generation) の考えをDE&I推進の軸としています。一方で、3Gのように目に見える多様性に加え、性格、考え方、働き方、価値観など、目に見えない多様性も数多く存在しています。このような背景から、当社はDE&Iを特別なものではなく、誰もがもっている多様性を理解してそれぞれの個性や価値観を認め合うことで、相互信頼できる風土の醸成が重要だと考え、その推進のためにさまざまな取り組みをおこなっています。

人材



当社ウェブサイト「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン (DE&I)」
www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/human-resource/#de_and_i

■ UPWARDS※

UPWARDSは、日本側5大学および米国側6大学、そして支援企業のマイクロン・テクノロジーおよび当社との日米半導体連携事業です。2023年から2028年までの5年間にわたり、半導体分野における人材育成の拠点の形成と研究開発の強化を目指しています。この取り組みでは、金銭的支援にとどまらず、大学におけるカリキュラム支援や組織支援、また学生向けのサマーキャンプやインターンシップの提供など、未来に向けて多面的な支援を実施しています。産学連携、そして日米連携により、これまでにない新たなアプローチで半導体業界にポジティブな影響をもたらすために日々活動を続けています。

※ UPWARDS: U.S.-Japan University Partnership for Workforce Advancement and Research & Development in Semiconductors. 半導体の人材育成と研究開発に関する未来に向けた日米大学間パートナーシップ



学生向けサマーキャンプ

■ 男性育児休業（男性育休）ワークショップ

当社グループでは、年に数回、男性育休ワークショップを開催しています。このワークショップでは、人事部による制度説明に加え、実際に育休を取得した社員による体験談の共有やQ&Aセッションをおこなっています。育休取得を検討している社員だけでなく、将来のライフデザインの参考や、育児中の部下や同僚のサポートをする目的で参加する社員も多く、毎回多くの関心を集めています。このような取り組みを通じて、社員がお互いの立場を理解し尊重し合う風土が醸成され、その結果、男性の育児休業の取得率向上につながっています。

ワーク・ライフ・バランス

■ 休暇制度

当社では、社員一人ひとりが心身ともに健やかに働ける環境を整えるために、適正な労働時間の管理と休暇制度の拡充および取得促進に取り組んでいます。具体的には、有給休暇取得率（日本）80%以上とする目標を掲げ、計画的な取得を促す啓発活動をおこなうとともに、取得状況の定期的なモニタリングや取得率向上に向けたマネジメントを推進しています。2026年3月期の有給休暇取得率は78.0%で、目標に近い結果となりました。

また、社員が心身のリフレッシュを図り、就業意欲を高めることを目的として、リフレッシュ休暇制度をグローバルで導入しています。日本では、勤続10年から25年以上の社員を対象に、2週間から1カ月の特別休暇（法定外有給休暇）を付与するとともに、2025年4月から勤続5年および30年の社員も取得できるよう制度の拡充をおこないました。2026年3月期には、日本で1,950名、海外で1,327名の社員がリフレッシュ休暇を取得し、前期比で91.8%増となりました。

さらに、育児休業、子の看護休暇※1、子育て応援休暇※2、有給の介護休暇など、さまざまなライフイベントに対応した柔軟な制度を導入しています。育児休業期間については、「子どもが満3歳に達する日」までの延長を認めており、育児による勤務時間短縮措置の対象を小学校卒業までの子どもを養育する社員にまで拡充しています。

※1 子の看護休暇: 小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする社員に対し、年5日の有給休暇を付与

※2 子育て応援休暇: 中学校就学の始期に達するまでの子の養育をする社員に対し、年5日の無給休暇を付与

■ 健康経営

当社はCEOを健康推進統括責任者として健康経営を推進し、社員一人ひとりの健康を踏まえた施策を展開しています。具体的には、法令に基づく各種健康診断や担当産業医による長時間労働者への面接指導に加え、希望者には社外の産業カウンセラーによるカウンセリングの機会も提供しています。また、マネジメント層を対象としたラインケア※セミナーも定期的に開催し、必要に応じて国内グループ会社の健康担当者や医療従事者との連絡会議を実施して、健康に関するサポート体制を強化しています。

このような取り組みを通じ、国内グループ各社全体で「健康経営優良法人2025」に認定されました。今後も継続的に取り組みの改善を図り、一層の健康経営の推進に努めていきます。

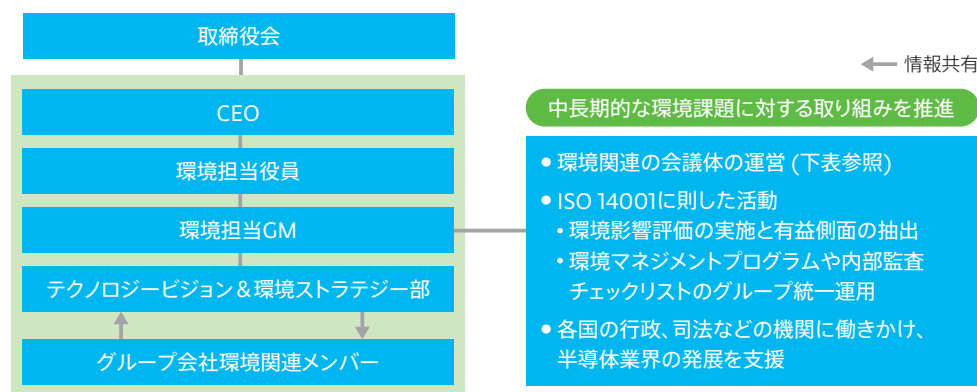
※ ラインケア: 管理職（部長や課長などの管理監督者）が、自身が管理する部下やチームメンバーの心の健康状態を気づかい、ケアをおこなうこと

環境

環境マネジメント体制

環境対応の重要性が高まる中、当社は環境担当GMを責任者とするテクノロジービジョン＆環境戦略部を本社に設置し、複数の会議体の運営や中長期的な環境課題に対する活動を推進しています。また、下表の会議体を通じ、CEOを含むマネジメント層に各取り組みの進捗状況を報告しています。

環境マネジメント体制図



■ 主な会議体

会議名	主な参加メンバー	会議内容	開催頻度
環境活動定例 報告会	CEO、コーポレートオフィサー、 環境担当GM	グローバル環境会議やTELコーポレート環境会 議での討議事項の報告、承認案件の審査	4回/年
環境ステアリング 会議	製造会社社長、 環境担当GMなど	環境課題への対応の進捗についてモニタリング や監督	4回/年
TELコーポレート 環境会議	環境担当GM、 所属長など	グループ全体の環境活動の推進、 グループ全体での目標設定	2回/月
グローバル環境 会議	本社とグループ会社の役員 が任命したメンバー	環境課題に対する個別目標の設定、進捗のモ ニタリング、目標達成に向けた働きかけ	2回/年

E-COMPASS

当社は半導体製造装置のリーディングカンパニーとして、環境にフォーカスしたイニシアティブであるE-COMPASSを展開しています。E-COMPASSを中心に、サプライチェーン全体で技術的にも社会的にも価値ある製品・サービスを提供し、持続的な成長につなげていきます。



スコープ1、2 & 3 2041年3月期までにネットゼロを実現

E-COMPASS 

半導体	製造装置	事業活動
デバイスの高性能化と低消費電力化 	装置のプロセス性能と環境性能の両立 	事業活動全体におけるCO₂排出量削減 

■ お取引先さまとの取り組み

当社は取引先さまとのさらなる連携強化を図るため、年間スケジュールを公開し、各種イベントを実施しています。取引先さまと目標を共有し、ネットゼロに関する説明会を開くなど取り組みを推進しました。こうした活動が評価され、非政府組織CDPのサプライヤーエンゲージメント調査2025において、最高評価であるAリスト企業に選定されました。



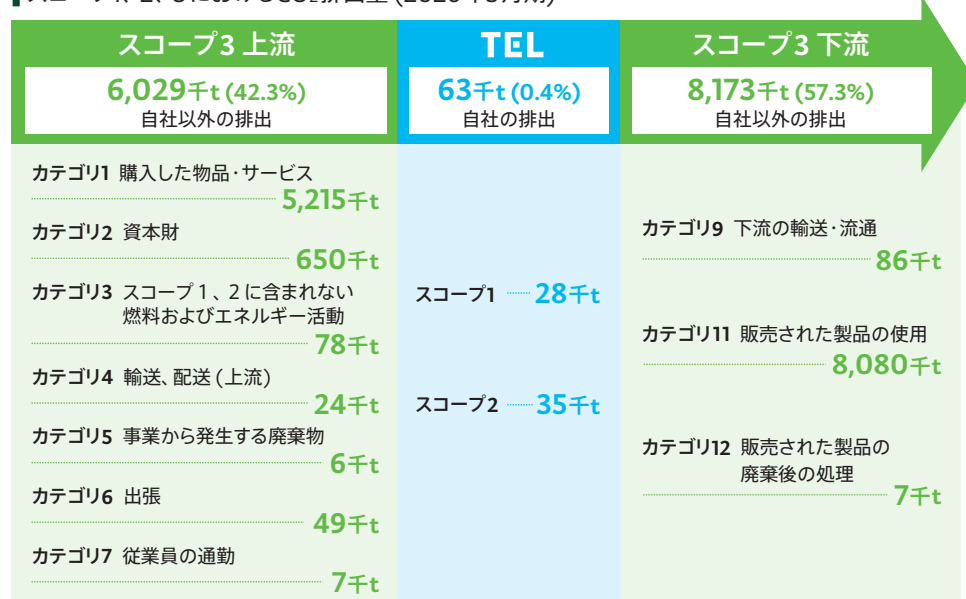
■ TEL E-COMPASS Day 2026

お取引先さまを対象とした説明会「TEL E-COMPASS Day 2026」を2026年3月にオンラインと会場のハイブリッド形式で開催し、315社のお取引先さまにご参加いただきました。

環境

バリューチェーン全体のCO₂排出量

当社は最先端の技術と確かなサービスにより環境問題の解決を目指し、バリューチェーン全体で生じる環境負荷の把握と、その削減に向けた事業活動を推進しています。

■ スコープ1、2、3におけるCO₂排出量 (2026年3月期)

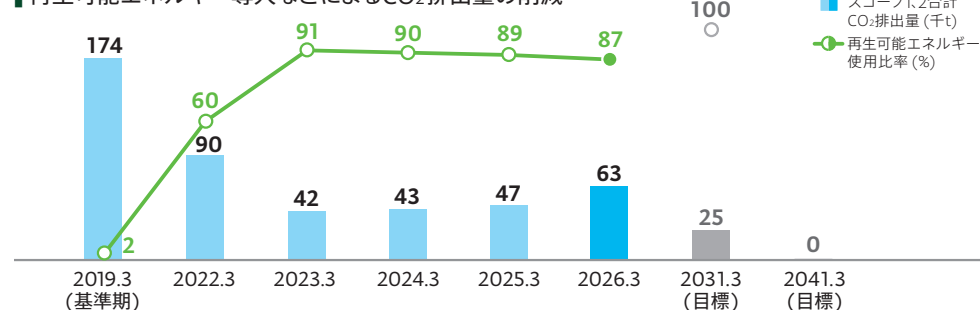
スコープ1: 自社が所有または管理する燃料・ガス使用の排出源から発生する温室効果ガスの直接排出

スコープ2: 自社が購入した電気、蒸気、熱の使用に伴う温室効果ガスの間接排出

スコープ3: スコープ1、2を除く製品輸送、従業員の業務上の移動、アウトソーシングした主な生産工程など企業のバリューチェーンからの排出。上流活動 (購入または取得した製品・サービスに関連する排出) と下流活動 (販売した製品とサービスに関連する排出) に分けられる

■ 自社の排出 (スコープ1、2) への取り組み

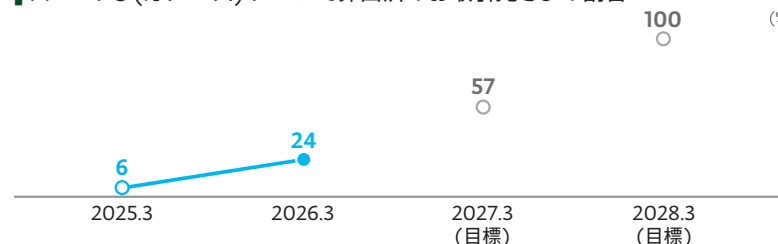
2026年3月期の全社における再生可能エネルギー使用比率は87%となりました。海外拠点においては開発設備の導入により電力消費量が増加したため、今後は海外での再生可能エネルギー電力の導入を一層加速していきます。

■ 再生可能エネルギー導入などによるCO₂排出量の削減

■ 自社以外の排出 (スコープ3) への取り組み (カテゴリ1)

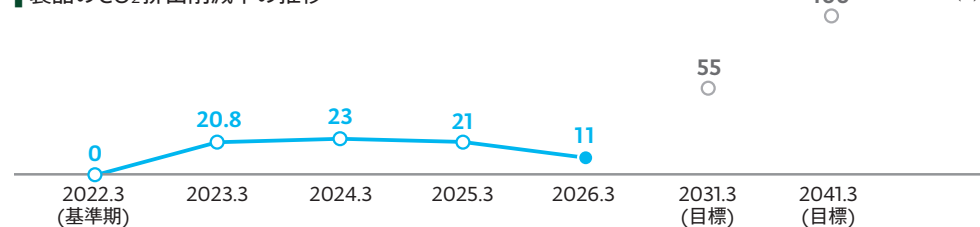
購入した物品・サービスにおけるCO₂排出量の削減に向けて、当社ではお取引先さまからの実データの取得に取り組んでいます。説明会や個別面談などを実施し、2028年3月までにはすべてのお取引先さまに対してスコープ3 (カテゴリ1) を算出いただけるよう推進しています。

■ スコープ3 (カテゴリ1) について算出済のお取引先さまの割合



■ 自社以外の排出 (スコープ3) への取り組み (カテゴリ11)

2026年3月期は、CO₂排出量の多い製品ポートフォリオの増加に伴い、製品使用時のウェーハ1枚当たりのCO₂排出量が相対的に増加したことから、基準期比11%の削減となりました。今後は、CO₂排出量の少ない製品の展開を強化していきます。

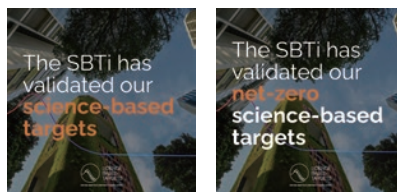
■ 製品のCO₂排出削減率の推移

環境

■ SBT認定目標

当社は、環境中期目標およびネットゼロ目標についてSBT※の認定を取得し、科学的根拠に基づく目標の確実な達成に努めるとともに、サプライチェーン全体での温室効果ガスの削減に取り組んでいます。

※ SBT: Science Based Targets。SBTはパリ協定が求める水準と整合した、5年～15年先の目標年として企業が設定する目標



目標年	対象		目標値	2026年3月期/進捗
2031年 3月期	スコープ1、2	CO ₂ 排出量	70%削減 (2019年3月期比)	64%減
	再生可能エネルギー (電力)	使用比率	100%	87%
	スコープ3	ウェーハ1枚当たりのCO ₂ 排出量※	55%削減 (2022年3月期比)	11%減
2041年 3月期	スコープ1、2、3	CO ₂ 排出量	ネットゼロ (実質ゼロ)	グループ全社での体制の整備 と削減に向けた活動を実施

※ お客さまの再生可能エネルギー導入による削減を含む

■ 業界連携を通じた脱炭素化への取り組み

当社は2022年より国際半導体製造装置材料協会 (SEMI) の半導体気候関連コンソーシアム (SCC) に参画しています。気候変動への対応の重要性がさらに高まる中、SCCのメンバー企業とのコラボレーションを通じて、世界の半導体産業による炭素排出量の削減に取り組んでいます。また、2024年にはSEMIのエネルギーコラボレイティブ (EC) にも参画しています。ECはアジア太平洋地域におけるクリーンエネルギー導入の推進に取り組んでおり、各国の政策決定者や関連機関などに対してアドボカシー活動を展開し、さまざまな提言をおこなっています。



■ 製品開発における取り組み

当社は環境負荷を低減した製品開発に積極的に取り組んでおり、E-COMPASSプログラムを通じて先進的な環境技術の開発をおこなっています。



高アスペクト比のエッチングを実現する新技術クライオジェニックエッチング (極低温エッチング)

地球温暖化係数が高いフッロカーボン系ガスの多くをフッ化水素ガスへ置き換えることで、クライオジェニックエッチング第一世代機と比べウェーハ1枚当たりのCO₂排出量を**84%削減** / 電力消費量 **43%削減**



CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro DICE™

従来比で**50%以上**※1のレジスト塗布起因の欠陥低減とコスト低減
クリーンルーム内のフットプリントの効率: 生産性と環境性能を従来比**25%以上**※2向上

※1 当社試算。従来装置のディフェクト性能・薬液消費量との比較

※2 当社試算。従来装置のスループット・フットプリント・用力、排気量との比較



EVAROST™

消費電力および冷却水やガスの用力使用量の低減などにより、従来装置 TELINDY PLUS™と比較して、ウェーハ1枚当たりのCO₂排出量を約**25%削減**

■ 物流における取り組み

当社は、物流においてSTW※の採用とモーダルシフトの推進に積極的に取り組んでいます。

※ STW: Strong Triple Wall。3層からなる強化段ボール

■ 物流目標

目標年	対象	目標値	2026年3月期/進捗
2027年3月期	CO ₂ 排出量	30%減	26%減
2026年3月期	木枠からSTWへの切り替え	50%	48%

環境

■ 物流における環境負荷低減

東京エレクトロン宮城および東京エレクトロン九州では輸送による環境負荷低減のため、鉄道へのモーダルシフトを継続して推進しています。また化石燃料からより低炭素な燃料への転換も進めており、一部車両へのバイオ燃料に加え、液化天然ガスを使用した船舶の利用を進めています。その結果、2026年3月期は、陸上輸送（長距離）で転換可能な路線のフェリー利用率90%以上とするとともに、EVトラックの活用は年間延べ約800台となりました。



出典: 東京エレクトロンBP

E-COMPASS Logistics & Facility Day 2025

E-COMPASS Logistics & Facility Day 2025をオンラインと会場のハイブリッド形式で実施し、物流および施設に携わる283名のお取引先さまにご参加いただきました。本イベントでは環境に関する当社の方針やビジョンを共有するとともに、お取引先さまからはEV車の積極的な導入や当社と共同で進めているSTWなどについてご紹介いただきました。

■ 自然資本

TNFDへの参画

当社は、2024年3月期に自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）の理念に賛同し、TNFDフォーラムに参画しました。TNFDの推奨するLEAPアプローチ※に基づく優先地域の特定や現状の整理、およびお取引先さまにおける状況や認識を確認するためのヒアリングをおこないました。今後、さらなる分析・評価により、内容を随時更新する予定です。

※ LEAPアプローチ: Locate（発見する）Evaluate（診断する）Assess（評価する）Prepare（準備する）のアプローチ

当社ウェブサイト「生物多様性および森林保全（TNFD）」
www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/environment/index.html#tnfd

水資源の取り組み

当社は中期経営計画における重要指標の1つとして水使用量に関する目標を設定し、全社的な取り組みを進めています。また、東京エレクトロン九州の合志事業所では環境保全活動として水田涵養をおこない、地下水保全に取り組んでいます。当社は非政府組織CDPの水資源管理に関する調査において、最高評価であるAリスト企業に選定されました。

■ サーキュラーエコノミー

当社はパーツの再生利用、超純水の循環使用、廃棄物削減などを通じ、循環社会（サーキュラーエコノミー）の実現に取り組んでいます。

パーツの再生利用

当社は長年のアフターマーケット（保守や修理など）で培った技術を利用し、数多くのパーツの再生利用をしており、2025年9月時点での主要3顧客における高周波（RF）システム再生利用率※は87%となりました。

※ 再生利用率: 特定のパーツにおける再生利用件数 / (再生利用件数 + 新品部品の購入件数)

超純水の循環使用

循環使用による超純水の使用量削減と安定運用の実現に向けて、洗浄工程で使用する超純水※について、装置待機中に配管から排出していた超純水の95%を回収し、循環再使用するシステムを確立しました。

※ 超純水: 水中の不純物を極めて低いレベルまで除去した、洗浄に適した高純度の水



廃棄物削減

当社は廃棄物削減の取り組みとして、廃棄物排出量の抑制とリサイクルに努めています。廃棄物の適正管理を目的とした電子マニフェストの運用の他、廃棄物集計状況や設備の現場確認をおこない、廃棄物量を削減するための施策を実施しています。これらの取り組みの結果、リサイクル率はグローバル全体で98.5%となり、2007年3月期より20年連続で目標とする「リサイクル率97%以上」を達成しています。



環境

気候関連財務情報開示タスクフォース (TCFD)^{※1} 提言に関する取り組み

当社は、気候変動が事業におよぼす影響について「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つの枠組みで整理し、想定されるリスクや機会などについて検討をおこない、さまざまな対応策を講じています。

時間軸 短期 5年以内、中期 2031年3月期、長期 2051年3月期

範囲 当社グループ全体および上流・下流を含むバリューチェーン全体

検討した内容 既存・新規事業に関する現在および新たな規制、技術リスク、法的リスク、訴訟リスク、市場リスク、評判リスク、急性的・慢性的な物理的リスク

種類 (シナリオ)	リスクまたは機会の項目	発現時期	想定されるリスクまたは機会	当社への影響	影響度の評価 ^{※2}	当社の対応
移行リスク (1.5°Cシナリオ)	● 低炭素移行に係るコストの増加	短期 ～中期	● 2041年3月期に31,775円/t-CO₂程度の炭素税^{※3}が課されると想定 ● 各国の炭素排出目標/政策の強化 ● 電気代/燃料代の高騰 ● グリーン電力/グリーン電力証書単価の高騰	● 2041年3月期における当社の温室効果ガス (GHG) 排出量および再生可能エネルギー使用量が2026年3月期と同水準であるとする、2041年3月期の炭素税は20億円/年増加 ● 輸送費の増加 ● 調達価格の増加	Low	● SBT認定目標に基づく中期環境目標達成に向けた取り組み (省エネ化の推進/再生可能エネルギー導入の促進) の実践 ● GHG排出量削減の取り組みにより、2041年3月期に想定される炭素税の負担増加額は、2026年3月期算定^{※4}では60億円削減 ● Tokyo Electron Taiwanでの新築建屋における自家消費太陽光発電設備の設置 ● EVトラック導入、共同配送や鉄道・船舶輸送化などのモーダルシフト推進
	● 低炭素移行に係るお客さまおよび市場からの要請の変化	短期 ～長期	● お客さま、投資家さま、求職者、NGO、地域社会からの評価の低下 ● 環境対策の開発における不確実性 ● 再生可能エネルギーの導入遅延	● レピュテーションリスクの増加 ● 設備投資・研究開発費の増加 ● 売上高の減少 ● 規制違反による訴訟や罰金の発生	Low ～High	● SBTネットゼロ目標の認定を取得 ● E-COMPASSの取り組みにより、中長期環境目標の達成に向けた活動を展開 ● 各国で改訂される環境法規制に適切かつ迅速に対応 ● TCFDへの賛同と枠組みの活用により、リスクマネジメントを展開 ● 統合報告書やウェブサイトなどで上記の活動に関する情報開示を推進
物理リスク (4°Cシナリオ)	● 洪水、土砂災害、風水害 (大雨・台風) などの異常気象	短期 ～中期	● 当社、お客さま、お取引先さまへの影響 (サプライチェーンの寸断、生産・出荷の遅延、操業停止など)	● 調達額の増加 ● 売上高の減少 ● 保険料の増加	High	● 事業継続マネジメント (BCM) に基づいた事業継続計画 (BCP) の更新と活動の実施 ● 取引先BCPアセスメントによるリスク対応の実施 ● 風水害 (大雨・台風) などへの全社的な対応基準を整理。全従業員を対象としたウェブ教育の実施、また災害発生に備えた保険への加入 ● 被災状況の早期確認と速やかな復旧を目指した調達品生産拠点のデータベース化
	● 気温上昇	中期 ～長期	● 気温上昇に伴いクリーンルームなどにおける空調装置の稼働増加	● エネルギーコストの増加	Low	● サプライチェーンにおけるE-COMPASSの取り組みにより、中長期環境目標の達成に向けた活動を展開 ● サプライチェーン上の気候変動対応、環境規制対応、環境技術革新など最先端の研究開発をグローバルレベルで推進し、革新的な技術をもつBest Productsをタイムリーかつ継続的に提供
機会 (共通)	● 環境に関わるオペレーションの効率化	短期 ～中期	● 生産性の向上	● エネルギーコストの減少	High	● 社内の環境への取り組み事例を広く募集し、優れた取り組みを「Sustainability Award」として表彰
	● 技術革新による製品・サービスにおける付加価値創出	中期 ～長期	● GHG低排出製品・サービス開発のためのイノベーション、低消費電力デバイスの製造に寄与する装置や技術の開発	● 売上高の増加 ● レピュテーションの向上	Medium ～High	● E-COMPASSの取り組みにより、サプライチェーンにおける気候変動対応や環境規制への適応、環境技術革新を推進し、中長期環境目標の達成を目指す ● グローバルレベルで最先端の研究開発をおこない、革新的な技術をもつBest Productsをタイムリーかつ継続的に提供



詳細は当社ウェブサイト「TCFD」をご参照ください

www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/environment/index.html#tcfd

※1 現在は国際サステナビリティ基準審議会 (ISSB) に統合

※2 影響度の評価: 当社内にてリスクや機会の影響度を評価した結果を記載

※3 炭素税: 温室効果ガス排出に伴う増税分はIEA (International Energy Agency: 国際エネルギー機関) のNZEシナリオ (Net Zero Emissions by 2050 Scenario) を参照。1米ドルを155円で換算

※4 2041年3月期の排出量が2026年3月期と同水準であるとした場合の算定

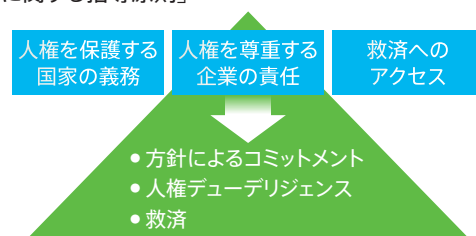
人権

人権方針と推進体制

当社は企業の社会的責任を自覚し、高い倫理観に基づいた行動が重要であると考えています。また人権の重要性と、企業として人権を尊重する責任を認識しています。

これを踏まえ、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」と、その中で言及されている「国際人権章典」「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」「国連グローバル・コンパクトの10原則」および「RBA行動規範※1」を参照し、「東京エレクトロングループ人権方針※2」を制定しています。

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」



本方針では重要と考える人権項目を5つ定めています。当社では、すべての役員および従業員に本方針の周知徹底を図るとともに、お取引先さまに対しても本方針に沿った事業活動の展開を要請しています。また、株主・投資家さまやお取引先さまをはじめとするすべてのステークホルダーと積極的に対話をおこない、社会からの要請や期待に応えるよう努めています。

当社では、サステナビリティ統括部が中心となり、当社グループのサステナビリティマネージャーが出席するサステナビリティグローバル会議において、人権に関する課題や取り組み内容を共有し、人権尊重の活動を推進しています。また、重要案件についてはサステナビリティ委員会で審議され、CEOが出席するコーポレートオフィサーズ・ミーティングで承認されます。担当のディビジョンオフィサーは重要案件の状況や進捗、結果などについて取締役会に報告し、取締役会はそれを監督しています。

重要と考える人権項目

- 自由、平等、非差別
- 雇用の自主性
- 製品安全と職場の安全衛生
- 結社の自由
- 適切な労働時間と休憩・休日・休暇の確保

※1 RBA行動規範: RBA (Responsible Business Alliance) が、エレクトロニクス業界のサプライチェーンにおいて、労働環境が安全であること、労働者が敬意と尊厳をもって扱われること、製造プロセスや調達を与える環境負荷に対して企業が責任をもっていることを確実にするために規定した基準

※2 当社ウェブサイト「東京エレクトロングループ人権方針」
www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/human-rights/index.html

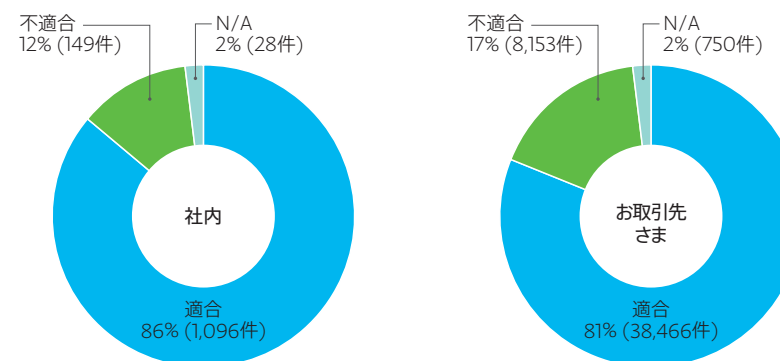
人権デューデリジェンス

当社では、毎年国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、グループ全体およびお取引先さまにおける人権への負の影響（人権リスク）の特定・評価をおこなっています。その上で、特定された負の影響を防止・軽減するための取り組みをおこない、それらの取り組みの実効性を追跡・評価し、適切に情報開示をおこなう人権デューデリジェンスを積極的に実施しています。

人権リスクの特定と是正のアクション

2026年3月期に、国内外の当社グループ19拠点と資材・人材・通関・梱包などのお取引先さま707社を対象として、RBAの監査基準に基づく「人権調査」を実施しました。

2026年3月期の「人権調査」



RBAの監査基準に基づく当社の適合および人権リスクの分類と定義は以下のとおりです

適合: 各分野について、課題は認められず要件に適合している状態にある

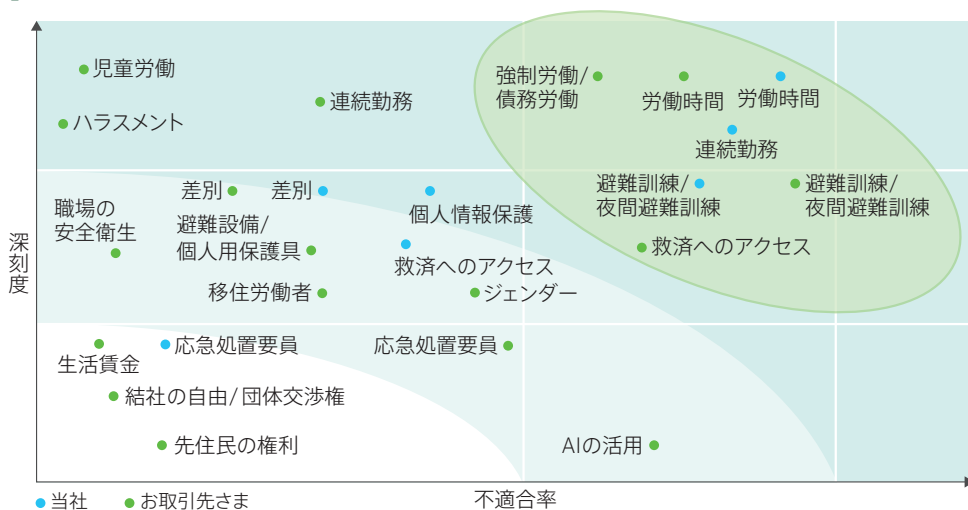
不適合: 要件を満たしていない状態にある

N/A: 設問に対して「設問内容が該当しない」と回答されたものを表す

人権

「人権調査」の結果から、深刻度と不適合率の観点より以下のとおり優先度の高い人権リスクを特定しました。特定したリスクについてはサプライチェーン全体で負の影響を防止・軽減するため、是正・緩和計画の立案と改善に向けた取り組みを実施しています。

「人権調査」から特定した主な人権リスク



社内: 優先度の高い人権リスクと是正のアクション

人権リスク	主な課題	是正・緩和対象拠点数	実施済拠点数※	是正のアクション
労働時間	労働時間の超過	11拠点	5拠点	- 労働時間に関する周知徹底 - 週ごとの労働時間管理の実施 - 定期的なモニタリングによる注意喚起と効果の確認
連続勤務	連続勤務日数の超過	9拠点	4拠点	- 連続勤務に関する周知徹底 - 週ごとの連続勤務管理の実施 - 定期的なモニタリングによる注意喚起と効果の確認
避難訓練	従業員の参加率100%未達	5拠点	1拠点	- 原則参加への意識づけ - マネージャーからの参加呼びかけ - 不参加者へのフォロー対応
夜間避難訓練	日没後の避難訓練が未実施	8拠点	4拠点	暗闇の状況を想定した訓練の計画と実施

※ 2026年6月時点

お取引先さま: 優先度の高い人権リスクと是正のアクション

人権リスク	主な課題	是正・緩和対象社数※1	実施済社数※2	是正のアクション
強制労働/債務労働	- 雇用関連費用の労働者負担 - 方針・手順の整備	11社	9社	- 雇用関連費用の支払い、運用の構築 - 方針の制定
労働時間	- 週当たり労働時間の超過 - 連続勤務日数の超過	7社	4社	- 労働時間に関する周知徹底 - 週ごとの労働時間管理の実施 - 定期的なモニタリングによる注意喚起と効果の確認
避難訓練/夜間避難訓練	- 避難訓練未実施 - 全員参加要件への対応 - 日没後の避難訓練未実施	26社	11社	- 避難訓練計画作成 (全員参加要件を含む) - 消防署との連携 - 日没後訓練の実施、夜間避難に関する教育実施
救済へのアクセス	- 通報窓口の設置と運用 - 手順の確立 - 匿名通報の受付	7社	5社	- 窓口の設置 - 運用手順書の整備 - 匿名通報の受付開始

※1 是正・緩和対象のお取引先さまのうち、個別に改善要請 (改善計画の立案と実施) をお願いしたお取引先さま数

※2 2026年6月時点

実効性の評価

当社では、特定された人権リスクの防止・軽減に向け、是正のアクションの実行前と実行後の状況を確認することで、その実効性を検証しています。実効性が十分でない是正のアクションについては、内容の見直しをおこなうことで改善に努めています。



当社ウェブサイト「人権デューデリジェンス」

www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/human-rights/index.html#dd

救済

企業における人権尊重の取り組みでは、人権侵害を受けた人が確実に救済へアクセスできることが極めて重要です。当社は守秘性・匿名性の確保や報復・不利益取り扱いの禁止に配慮した信頼性の高いグリーバンスメカニズム (苦情処理メカニズム) を構築し運用しています。従業員やお取引先さまなどステークホルダーからの声に誠実に向き合い、迅速かつ適切に対応するとともに、人権に特化したグリーバンスメカニズムの定着を図り、救済へのアクセスを提供していきます。

サプライチェーンマネジメント

サプライチェーンマネジメントについての考え方と体制

当社は、健全で持続可能なサプライチェーンを構築するため各国の法令、社会規範およびRBA行動規範に基づいた調達方針を策定し、お取引先さまとともに本方針にもとづく活動を実践しています。

また、資材の調達先、人材派遣・請負会社、通関関連業者を含む物流業者、施設管理会社など、パートナーとして当事業を支えるお取引先さまとの信頼関係の構築に努めています。

お取引先さまとの継続的なコミュニケーションを通じて、労働、安全衛生、環境、倫理などのあらゆる観点からサプライチェーンにおける課題を確認しています。これらの課題は、CEOによる監督のもと関連部門で共有し、改善策に取り組んでいきます。今後も、グローバルスタンダードに準拠したオペレーションをお取引先さまと協働で展開することで、サプライチェーンにおける価値創造に努めていきます。



当社ウェブサイト「サプライチェーンマネジメントについての考え方と体制」
www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/supply-chain-management/index.html

サプライチェーンにおける取り組み

■ 責任ある鉱物調達

当社は、人権侵害や労働問題を引き起こす要因となっている不正な方法により採掘・採取された鉱物調達への対応を企業の社会的責任であると捉え、責任ある鉱物調達調査をおこなっています。2026年3月期は3TG（ tantalum、 niobium、 tin）とコバルトを対象鉱物として、12回目となる調査を実施しました。紛争非関与と判定する根拠の1つであるRMAP※準拠製錬所は293社特定することができました。また、不正な方法で採掘・採取された3TG、コバルトを使用した調達品は確認されませんでした。

調査結果についてはお取引先さまへ共有し、調査の精度向上とRMAP認証を取得した製錬所への切り替えを要請するとともに、今後もデューデリジェンス活動を実施していきます。

※ RMAP: Responsible Minerals Assurance Process

当社ウェブサイト「責任ある鉱物調達」
www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/supply-chain-management/index.html#minerals

■ 調達BCP

当社はBCPの一環として、お取引先さまとともに継続的な災害対策活動に取り組んでいます。具体的には地政学リスクなどさまざまなリスクに備え、主要部品や材料などの供給元を複数化するとともに、リスクの低い部品・材料の採用と開発を共同で推進することにより、安全性と柔軟性の高いサプライチェーンを構築しています。また複雑化するサプライチェーンを適切に把握するため、ITシステムを活用しサプライチェーンの可視化を進めるとともに、お取引先さまを対象にBCPアセスメントを実施し、その結果を分析・フィードバックし改善活動につなげることでリスクの低減に努めています。

当社ウェブサイト「調達BCP」
www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/supply-chain-management/index.html#bcp

■ RBA推進プログラム

2015年にRBA (Responsible Business Alliance) へ加盟し、RBAが定める行動規範の遵守に努めています。お取引先さまにもRBA行動規範への理解と遵守を求め、年間を通じたRBA推進プログラムに取り組むことで、リスクの低減や課題の解決を図っています。

同意書の取得

当社では、サプライチェーンにおけるすべての人々が自由な意思に基づいて労働することを確実にするため、強制労働や債務労働を一切許容しないことを「東京エレクトロングループ人権方針」に明記しています。また、お取引先さまとともに確実に取り組みを進めるため、労働者の権利を尊重する「RBA行動規範」の遵守を確認する同意書への署名をお願いしています。

サプライチェーンマネジメント

TELサプライチェーンサステナビリティアセスメント (TSSA)

1. アセスメントの実施

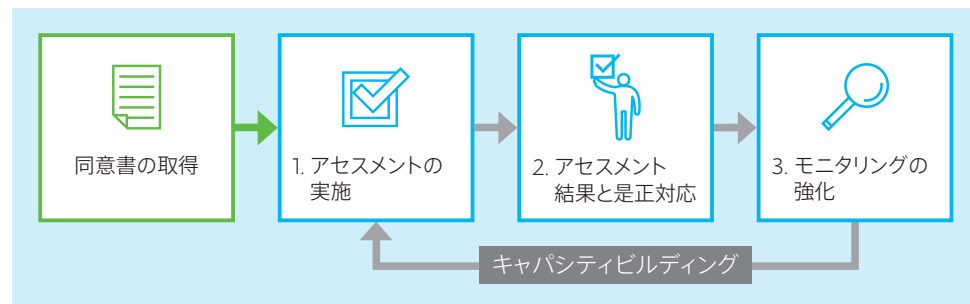
お取引先さまの潜在的なリスクを評価するため、RBA監査基準を基に当社が重要と判断した主要項目で構成した「TELサプライチェーンサステナビリティアセスメント (TSSA)」を年1回実施しています。2026年3月期は資材の調達先、人材派遣・請負会社、通関関連業者を含む物流業者、施設管理会社などのお取引先さま計707社を対象にTSSAを実施し、すべてのお取引先さまから回答をいただきました。また、人権デューデリジェンスの一環として「人権の尊重」に関連する項目を追加し、人権に関する取り組み状況についても確認しました。

2. アセスメント結果と是正対応

お取引先さまの回答内容を「Low Risk」「Medium Risk」「High Risk」の3段階で評価し、お取引先さまへ個別にフィードバックするとともに、確認されたリスク項目については是正を要請しています。特に当社が優先取り組み課題として設定した項目に不適合があった場合は、優先的に是正を進めるようお願いしています。2026年3月期は、Low Risk 88.8%、Medium Risk 11.2%の結果となり、High Riskは確認されませんでした。

3. モニタリングの強化

特定の課題にリスクが認められたお取引先さまについてはモニタリングを強化し、改善活動を支援しています。2026年3月期は48社を選定し、ヒアリングなどのコミュニケーションを通じて是正計画、是正内容および完了状況を確認しました。



キャパシティビルディング

TSSA開始時には説明会を実施し、RBA行動規範に関する解説や好事例の紹介をおこなうことで、お取引先さま各社での取り組みを支援しています。これによりお取引先さまの理解向上と自律的な改善を促進しています。

当社ウェブサイト「サステナビリティの展開」
www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/supply-chain-management/index.html#sustainability

当社におけるRBA展開

当社では、主要製造拠点を対象にRBAが提供するオンラインツールを用いてRBA SAQ (Self-Assessment Questionnaire) を毎年実施し、潜在的なリスクや取り組み状況を確認するとともに、課題が判明した場合は是正を推進しています。2026年3月期からは対象を本社およびグループ会社へ拡大し、グループ全体でRBA行動規範の遵守に向けた取り組みを強化しています。

さらに主要製造拠点では、RBAの第三者監査 (RBA VAP) を継続的に受審しており、2024年3月期から2026年3月期にかけて受審したすべての監査において、プラチナ認証を取得しました。

会社名	事業所	取得年月	スコア	ステータス※
東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ	本社、穂坂	2023年7月	200	プラチナ
		2025年8月	200	プラチナ
	東北	2025年11月	200	プラチナ
東京エレクトロン九州	本社	2025年3月	200	プラチナ
東京エレクトロン宮城	本社	2025年4月	200	プラチナ

※ プラチナ: 200点満点、ゴールド: 180～199点、シルバー: 160～179点、それ以下は認定対象外

当社は、これらの取り組みを継続的に実施し改善を重ねることで、事業リスクの低減と強固な事業基盤の構築を図ります。さらに、競争力の向上と社会課題の解決への貢献を通じて、すべてのステークホルダーからの信頼を獲得し、企業価値の向上に寄与していきます。

当社ウェブサイト「RBAの展開」
www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/supply-chain-management/rba/index.html

安全

安全についての考え方

当社では、経営理念として安全第一の考え方を明文化しています。

社会的責任を果たす企業として、「Safety First」のスローガンのもと、開発・製造・輸送・据付・メンテナンスなど各種の業務遂行において、経営層から現場担当者まですべての人が安全を最優先事項としています。

Safety First



安全教育

当社では、全従業員に対して、「基礎安全教育」を実施しています。

加えて、製造現場やクリーンルームで作業するエンジニアは、専門性の高い「上級安全教育」を入社時に受講しています。「上級安全教育」は毎年内容を刷新し、更新教育を実施しています。

また、新たな取り組みとしてデジタルサイネージによる安全キャンペーンを実施しています。さらに、各拠点のホールやエントランスに設置したディスプレイでは、当社で発生した事故やニアミス・ハザードの事例を紹介し、安全意識の向上を図っています。



ハザード表示例

製品の安全

当社は、開発段階から製品のライフサイクル全体を見据えたリスクアセスメントを実施し、その結果を設計に反映することで、製品の本質安全設計※1を進めています。また、国際的な安全規格やSEMI Standards※2に基づき、当社から出荷する装置は第三者審査機関による適合確認をおこなっています。さらに装置を納入する各国・各地域の法規制にも適切に対応し、高品質かつ安全な装置を提供することで、お客さまとの信頼関係を構築しています。

※1 本質安全設計: 機械の設計を工夫することにより、機械が人に危害をおよぼす原因そのものを取り除くこと

※2 SEMI Standards: 半導体製造装置、フラットパネルディスプレイ製造装置、材料メーカーなどに貢献する国際的な業界団体であるSEMIが、これらの国際工業規格の統一を目的に定めた規格

事故発生時の対応

事故が発生した際には事故報告システム (TIRS※) を用いて、経営層を含む当社グループ全体の安全関係者と速やかに情報を共有しています。事故対応や再発防止策の実施状況は当該部署が主体となって確認し、その結果を経営者が出席する会議で報告します。報告内容については安全衛生委員会などを通じすべての従業員に共有されます。

※ TIRS: TEL Incident Reporting System。事故発生後24時間以内に初期報告され関係者に共有されるシステム

活動の成果と新たな取り組み

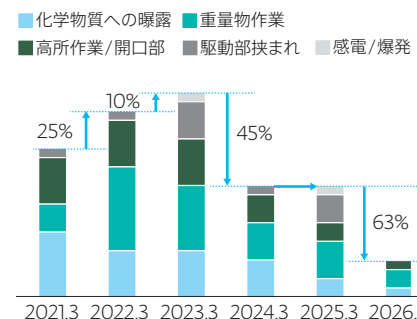
当社では、ストップワークの再教育と現場巡視の強化により、重点管理人身事故の防止に注力しています。2026年3月期には、重点管理人身事故※1は前期比で63%減少しました。

また、報告件数が最も多いエルゴノミクス関連事故に対しては、AIを活用した姿勢解析ソフトを導入し、再発防止対策を進めています。身体に負担を強いる50種類以上の作業を対象に原因を分析し、グループ各社でおこなわれている類似作業については、作業姿勢の適正化や負荷の軽減など、最適な対策を展開することで、TCIR※2は0.22を達成しています。

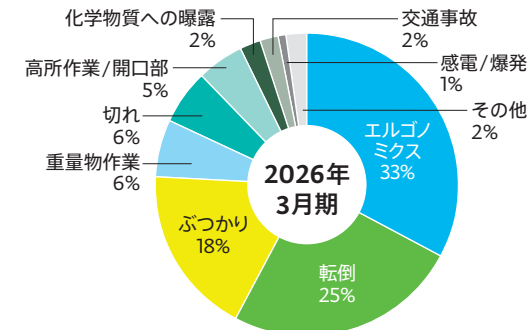
※1 重点管理人身事故: 当社において再発防止に特化している事故。高所や開口部、重量物取り扱い時の事故、化学物質への曝露、装置駆動部との接触など、身体に深刻な影響をおよぼす可能性のある人身事故が対象

※2 TCIR: Total Case Incident Rate。労働時間20万時間当たりの人身事故発生率

重点管理人身事故増減率



人身事故種別割合



品質

品質についての考え方

従業員一人ひとりが、品質保証活動を正しく理解し実践するためには、達成すべき目標を明確に定義し、それを広く浸透させる環境の整備や文化の醸成が重要です。当社は、品質保証のあるべき姿を明確にした上で「品質についての考え方※1」と「品質方針※2」を策定し、達成すべき品質指標を設定しています。これらの方針や考え方をもとに、品質の重要性を従業員に継続的に発信することで、目標の共有と意識の定着を図っています。さらに、品質に関する規程や教育について適宜見直しをおこなうとともに、さまざまな教育プログラムを通じて、従業員一人ひとりの品質に対する意識の向上に努めています。新入社員を対象に基礎的な品質教育をおこなう他、全従業員を対象とした継続的な業務改善教育も実施しています。また品質情報の見える化を進めることで、従業員が常に自身の役割と目的を明確に認識し、日々の業務の中で主体的な品質活動を実践できる体制を整えています。これにより、製品の品質トラブルに対する未然防止を一層強化しています。加えて、従業員がさまざまな場面で相互に品質確認を徹底し、業務プロセスの継続的な改善に取り組むことで、事業の持続的な成長につなげています。こうした取り組みを通じて、お客さまの期待を上回る高品質の製品やサービスの提供を実現しています。

※1 当社ウェブサイト「品質についての考え方」 www.tel.co.jp/sustainability/productivity/value-chain/index.html#basic

※2 当社ウェブサイト「品質方針」 www.tel.co.jp/sustainability/productivity/value-chain/index.html#acc_1

品質向上に向けた取り組み

当社では、全社共通の品質方針に基づくルールを、開発・設計・製造・サービスなど主要業務区分ごとにTELマニュアル (TM)、TELガイドライン (TG) として体系化しています。これらのルールは、製造拠点を含む当社グループ全体やお取引先さまと共有し運用されています。共通ルールの遵守は、製品およびサービスの品質確保における基本となることから、本社の品質統括部門が製造およびサービス拠点を対象に、運用ルールの理解度と運用状況を定期的に確認しています。加えて、各製造拠点では、お取引先さまへの品質監査を定期的実施することで、お取引先さまとともに品質向上における体制の強化に取り組んでいます。

また、各製造拠点ではこのTMおよびTGを基盤とした品質マネジメントシステムを構築しており、国際規格ISO 9001:2015を取得しています。さらに、内部監査および第三者機関による監査を重ね、PDCAサイクルを効率的に運用することで、品質マネジメントシステムの継続的な改善活動に取り組んでいます。グループ各社の品質保証部門では、前期の実績をもとに毎年品質に関する目標を設定し、達成状況の定期的なレビューをおこなっています。具体的には、お取引先さまからの納入部品の不適合数をモニタリングし、不良率をKPIとすることで毎月の進捗状況を確認するとともに、前期に発生した納入部品の不具合件数をもとに削減状況を評価しています。

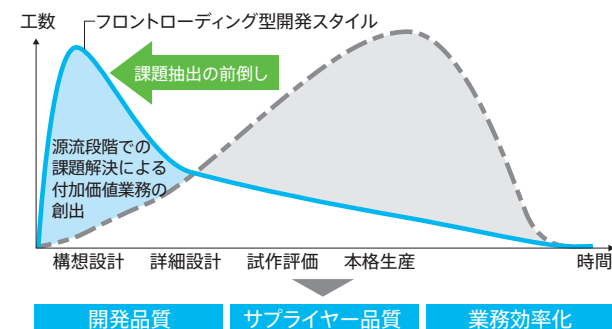
さらに、自工程保証※1により、品質のリスクマネジメントや開発・設計審査を厳密に実施し、シミュレーションを用いた顧客運用の事前検証を徹底しています。この取り組みにより、各工程の精度を高め、手戻りによる対応コスト※2の低減に取り組み、上流工程における従業員の高付加価値業務への注力を可能にするShift Left (フロントローディング)※3を推進しています。具体的には、開発・設計プロジェクトごとにリスク抽出する設計プロセスから、リスクを一元化・共有化する設計プロセスへと移行することで、リスク抽出漏れの防止につなげています。また、過去のトラブル事例を踏まえ、新たに想定されるリスクを特定し、それを業務プロセスへ反映する仕組みを確立することで、革新的な開発の対応力を高めています。

※1 自工程保証: 各工程で不適合を生じさせない、後工程に流さないことを総的に進める取り組み

※2 手戻りによる対応コスト: 不適合が生じた際に工程をさかのぼってやり直すためのコスト

※3 当社ウェブサイト「品質」 www.tel.co.jp/sustainability/productivity/value-chain/#shift_left

Shift Left (フロントローディング) の取り組み



デジタルトランスフォーメーション (DX)

半導体は経済活動と社会を支える基盤であり、当社を取り巻く市場は今後も拡大が見込まれます。当社は、革新的な技術をもつBest Productsと付加価値の高いBest Technical Serviceの提供を通じて、企業価値の向上に取り組んできました。持続的な価値創造でさらなる成長を実現するため、「開発・製造を中心とした高付加価値の創出※」に加え、「経営・業務オペレーティングモデルの高度化を通じた戦略の実行力の強化」をDXによる変革の2つの柱に位置づけて、実行しています。

中核機能として、装置開発からサービスまでを一連で捉えたDXソリューション「Epsira™」の開発を推進する体制を構築するとともに、経営企画、業務プロセス改革、デジタル/IT機能を一体的に統合し、戦略立案から業務変革・実行までを全社の業務部門とシームレスに連携して推進する体制を整えています。

※ 研究開発 P.29-32 据付・保守サービス P.41-44

詳細は当社ウェブサイト「デジタルトランスフォーメーション (DX)」をご参照ください www.tel.co.jp/sustainability/dx

戦略と実行の循環を実現するオペレーティングモデル

業務改革の推進を通じて当社が目指すオペレーティングモデルの特徴は、戦略を現場で一貫して実行するとともに、業務から得られる情報を適時に経営判断へ反映する循環型の仕組みにあります。業務のあるべき姿を起点に、業務プロセス、データ、IT、人の役割を一体で設計・運用することで、環境変化に応じて柔軟に判断・実行できる仕組みを構築しています。

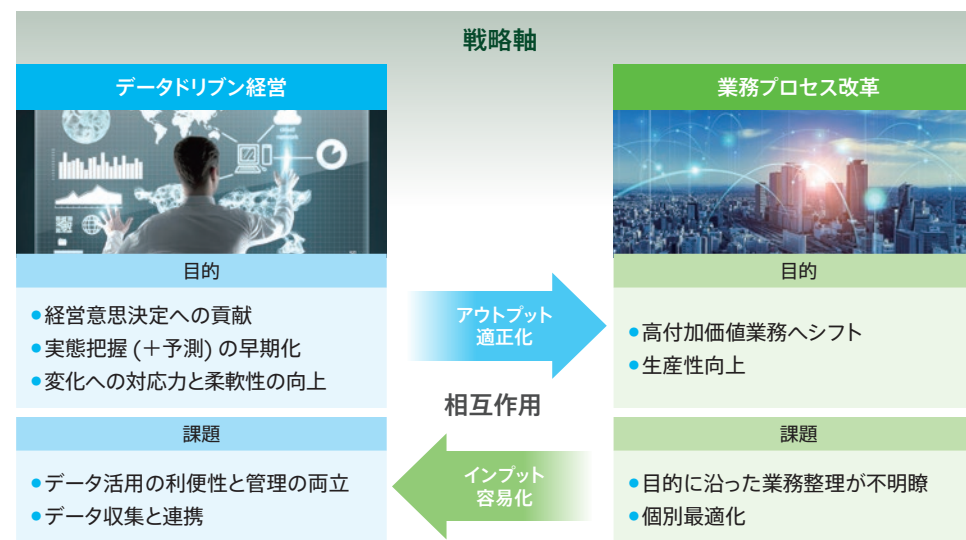
こうした取り組みにより、事業規模の拡大に伴う業務量の増加を人員増加に依存することなく、組織全体の効率性と処理能力を高めて生産性を向上させ、事業成長を支える基盤を強化しています。同時に、社員一人ひとりが能力を発揮し付加価値の高い業務に集中できる新たな働き方 (New Work Style) の実現に向け、個々の意欲や強みが主体的な行動と成果につながる環境を整えることで、「やる気重視経営」を推進しています。また、生産性、業務プロセスのリードタイム、工数などの指標を用いて取り組みの効果を把握・管理し、経営会議やディビジョンオフィサーズ・ミーティングにおいて進捗や成果を共有・議論しています。整理された情報は、取締役会における経営の考え方の検討に反映・活用されています。

データに基づく経営と業務プロセス改革

循環型オペレーティングモデルを経営や業務の中で機能させるため、当社は「データドリブン経営」と「業務プロセス改革」を戦略軸として位置づけています。

データドリブン経営では、グループ全体のデータ基盤を強化し、役割や機能に応じた指標設計を通じて状況把握および意思決定の質・スピードの向上を図ります。業務プロセス改革では、全体最適の視点からデジタル技術を活用して業務のあり方を再設計し、標準化・最適化された業務プロセスによりデータの質と可視性を高め、データドリブン経営を下支えします。

これらの活動が相互に連動することで、戦略と実行の循環を日々の業務に定着させ、開発・製造をはじめ事業活動全体で高度なデータ活用と業務最適化を実現します。経営目標に基づくロードマップの策定およびAIや市民開発を含むデジタル技術活用の環境整備をおこなうとともに、現場での実践を通じて変革を推進し、経営・業務の仕組みの最適化を牽引することで、継続的な高付加価値の創出と全社的な価値創造を支えています。



情報セキュリティ

当社が継続的かつ確実に事業を展開していくためには、安全・安心にデータを活用できる環境の整備が欠かせません。そのため、情報セキュリティの確保を経営上の重要課題と位置づけ、お客さまやお取引先さまの情報および先端技術に関する機密情報の保護を継続的に強化しています。さらに、サプライチェーン全体の安定的な稼働を担保するため情報セキュリティの強化に努めています。

主な活動

 情報セキュリティ体制	本社の執行役員を委員長とするTELグループ情報セキュリティ委員会を設置し、グループ全体の情報セキュリティ戦略を策定しています。また各社の情報セキュリティ委員会と連携し共通認識をもつことで、グループ全体で統一された情報セキュリティレベルを確保するとともに、本社の統括のもと、各種セキュリティ施策を迅速に展開できる体制を構築しています。	 セキュリティに対する脅威への対応	脅威や技術動向の変化を踏まえ、PCやサーバーのセキュリティ強化、多要素認証の導入、ネットワークセキュリティの強化など、技術的対策を継続的に推進しています。また、24時間365日体制でサイバー攻撃や内部不正などの脅威を監視しています。万が一インシデントが発生した場合は、速やかに関連部門と情報を共有し、迅速に対応できる体制を整えています。
 情報セキュリティマネジメント	NIST※1などの国際標準で定められた要件を参考に情報セキュリティポリシーを策定し、グローバルに展開するとともに、適宜見直しをおこなっています。併せて、すべての従業員を対象に情報セキュリティ教育を継続的に実施し、セキュリティ意識とリテラシーの向上を図っています。また、本社よりISO/IEC 27001※2認証の取得を進めており、グループ全体に範囲を順次拡大中です。	 製造拠点や製品におけるセキュリティ	製造システムが安全かつ安定的に稼働するよう、製造拠点のセキュリティ対策を強化しています。また、お客さまに安心して製品・サービスをご利用いただけるよう、製品のみならず製造工程およびフィールドサポートについてもセキュリティ対策を実施しています。
 サプライチェーンセキュリティ	情報セキュリティへの脅威からサプライチェーン全体を保護するため、お取引先さまに対して定期的に情報セキュリティのアセスメントを実施しています。アセスメントで確認された課題については、お取引先さまとともに改善に取り組むことで、セキュリティ対策の継続的な強化に努めています。	 社外活動と情報セキュリティ人材の強化	SMCC※3におけるセキュリティ標準化に向けた取り組みなど、社外でのセキュリティ活動に参加し、半導体業界や社会全体の情報セキュリティレベル向上に貢献しています。さらに、産官学など多様な組織が参画する社外のセキュリティ団体に加盟し、さまざまなセキュリティ情報の共有をおこなっています。また、当社の情報セキュリティを支える新たな人材の採用と育成にも積極的に取り組んでいます。

※1 NIST: National Institute of Standards and Technology. 米国立標準技術研究所

※2 ISO/IEC 27001: 情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS: Information Security Management System) の国際規格

※3 SMCC: Semiconductor Manufacturing Cybersecurity Consortium. 半導体業界の国際団体であるSEMIの中でサイバーセキュリティ強化を検討するコンソーシアム



詳細は当社ウェブサイト「情報セキュリティ報告書」をご参照ください

www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/security/index.html#report

リスクマネジメント

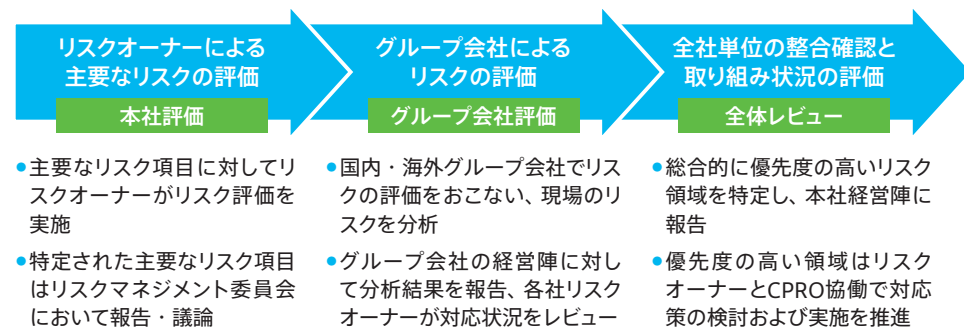
リスクマネジメントの考え方

当社グループでは、半導体を取り巻く地政学や市場変化などのさまざまなリスクに適切かつ迅速に対応するとともに、持続的な成長を実現すべくリスクマネジメント体制を構築しています。事業を遂行する上で直面しうるリスクについて、将来を見据えて十分に検討をおこない、その影響を最小化するだけでなく、それらを事業機会として捉え、適切に対応することが社会から信頼される企業であるために不可欠であると考えています。

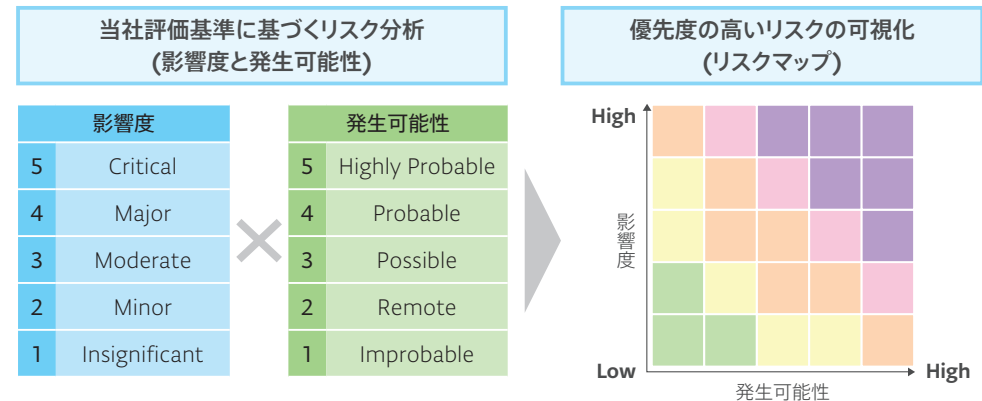
リスクマネジメントの体制と実行

グループ全体でより実効的な活動を推進するため、コーポレートリスクマネジメント推進室 (CPRO) を本社のコーポレート企画本部に設置し、エンタープライズ・リスクマネジメント※をさらに推進しています。

※ エンタープライズ・リスクマネジメント: リスクマネジメント活動に関する全社的な仕組みやプロセス



リスクの評価方法



当社グループにおけるリスクマネジメントに関する活動については定期的に監査役および取締役会に報告しており、取締役会は、各リスクオーナーを中心に実行されるさまざまな取り組みを監督しています。また、取締役会による監督に加え、当社グループはRBAが認定する第三者機関によるVAP (Validated Assessment Program) 監査を定期的に受審し、リスクマネジメントを含む管理・運用体制について外部評価を受けています。

さらに、グループ全社を対象としたBCPの見直しや運用改善にも継続的に取り組んでおり、緊急時における事業継続対応を実行するための実践的な能力の向上を図るため、定期的にBCP訓練や防災訓練などを実施しています。

加えて、リスクマネジメント活動においても積極的にDXの推進をおこなっており、デジタル技術を活用したダッシュボードを導入しています。これにより、グループ全社におけるリスク評価やリスク対応策の可視化、および各オーナーと各担当所管部門間でのグローバルかつ横断的な情報連携を実現しています。

今後も、自律性および実効性の高いリスクマネジメントの実践を目指し、主要な16のリスク項目に対して各オーナーが主体となり、グループ全体のリスクマネジメントを一層強化する活動を展開していきます。

詳細は当社ウェブサイト「リスクマネジメント」をご参照ください www.tel.co.jp/about/riskmanagement/

リスクマネジメント

主要な16のリスク項目

リスクについてはリスクの評価方法を用いて毎期見直しをおこなっており、主要な16のリスク項目は以下のとおりです。

項目	想定される主なリスク
1 市場変動	半導体市場の急激な縮小による過剰生産および在庫の増加。急激な需要の増加への対応不能による販売機会の損失
2 研究開発	新製品の投入遅延や、お客さまのニーズとの不一致による製品競争力の低下
3 地政学	グローバルな地政学的対立や地域紛争、各国・各地域の安全保障政策、産業政策などによるサプライチェーンの停滞やマクロ経済環境の悪化による事業活動の制約
4 調達・生産・供給	お取引先さまの供給能力を上回る需要の増加、法改正や労働人口減少による部品調達の停滞、国内外の物流網の逼迫、自然災害による生産停止などに起因する製品の供給遅延
5 安全	当社製品の安全性に関する問題や、重大な人身事故の発生による損害賠償および社会的信用の低下
6 品質	製品不具合の発生による損害賠償や対策費用の発生および当社グループのブランドへの信頼低下
7 環境対応	各国・各地域の気候変動政策や環境法令への不適切な対応による追加対応費用の発生、製品競争力や社会的信用の低下および課徴金・損害賠償の発生
8 リーガル	事業を展開する各国・各地域の法令・規制への抵触による業務停止・制限、社会的信用の低下および課徴金・損害賠償の発生

項目	想定される主なリスク
9 知的財産	独自技術の専有化不足による製品競争力の低下および第三者が保有する知的財産権の侵害による生産・販売の制約や損害賠償の発生
10 情報セキュリティ	当社・お取引先さまに対するサイバー攻撃や内部不正に伴う情報漏洩などによる技術的優位性の棄損、業務の停止、社会的信用の低下および損害賠償の発生
11 人材	必要な人材の継続的な採用・維持が困難になり、多様な価値観・専門性をもった人材が活躍できる環境整備ができないことによる製品開発力や顧客サポートの質の低下
12 感染症・自然災害など	全世界的または一部の地域で大規模な感染症や自然災害、テロなどが発生し、当社役員・従業員などやその家族の安全が脅かされ、各国間の移動が制限されることで発生する事業活動への影響
13 ファイナンス	国際情勢や金利変動などの要因で急激な為替変動が発生することによる業績への影響。各国・各地域の税法などに関して各国当局との解釈の相違による追加の税負担の発生
14 M&A	買収対象企業や事業に対するデューデリジェンスまたはPMI（ポスト・マージャー・インテグレーション）が不十分なことによる企図した成果を実現できない。また、潜在的なターゲットを競合に先に買収されることなどによる競争力への影響
15 IT&オペレーション	基幹システムにおける大規模な障害の発生によるビジネスへの影響。デジタル化や業務プロセス改革の遅延による成長分野・新規制への対応の非効率化
16 拠点展開	世界的な新規ビジネスの増加に対するグローバル拠点戦略の検討や計画の実行遅延などによる新規拠点の展開や既存拠点の強化・統制の非効率化

コンプライアンス

コンプライアンスの考え方

当社は業界のリーディングカンパニーとして、企業倫理およびコンプライアンスを重要な価値観と位置づけています。

当社ウェブサイト「コンプライアンスの考え方」 www.tel.co.jp/about/compliance/index.html#compliance01

コンプライアンス体制

当社では、グローバル企業として求められるコンプライアンスプログラムを効果的に推進するため、本社にチーフ・コンプライアンス・オフィサー (CCO) や専任部署であるコンプライアンス部を設置しています。また、海外の主要拠点においてはコンプライアンス担当責任者を任命し、CCOおよびコンプライアンス部に直接報告する体制を構築することで、グローバル全体でのコンプライアンス体制の強化を図っています。

コンプライアンスの取り組み

■ 企業倫理およびコンプライアンス

当社は、企業倫理およびコンプライアンスのより効果的な浸透・推進を目的に、当社グループの行動規範として「東京エレクトロングループ倫理基準」を制定し、倫理委員会を設置しています。

2026年2月には、当社グループの取締役および従業員を対象に倫理基準に関する教育を実施し、遵守誓約を取得しました。この教育では、CEOからのメッセージを含め、高い倫理観をもち、自らが会社の成長を支える一員であることを改めて認識するとともに、倫理基準の遵守が社会的責任の遂行および持続的な発展の実現に不可欠であることを伝えています。

■ 贈収賄防止および競争法に関する取り組み

倫理基準「贈収賄および腐敗行為」に明記されているように、当社はいかなる状況においても、場所や理由を問わず、いかなる相手に対しても賄賂※を提供しません。また、「公正か

つ自由な競争」に基づき、公正で自由かつ競争力のある市場環境下での事業展開を追求し、違法な反競争的活動をおこないません。

当社グループでは、「贈収賄・腐敗防止に関する基本方針」および「競争法コンプライアンスに関する基本方針」を制定し、その実践に努めています。

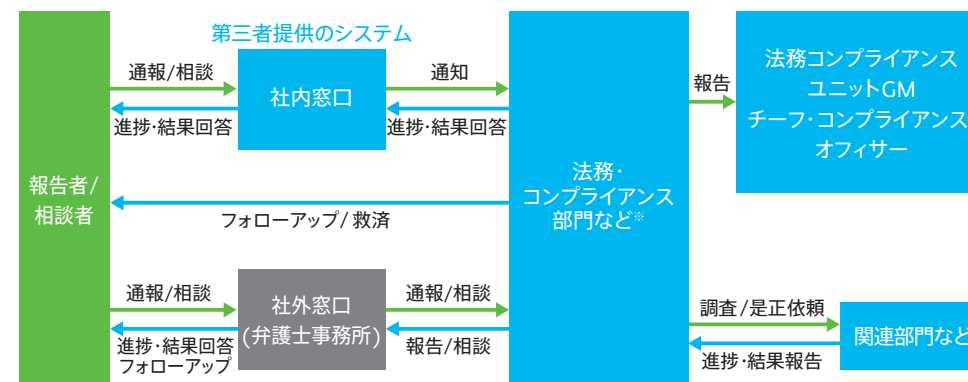
※ 賄賂には現金、交際接待、ギフト、会社施設への訪問に関連するツアー、旅行への招待、健康管理サービス、雇用、性的サービス、寄付やスポンサーシップを装った支払も含まれます。

当社ウェブサイト「贈収賄防止および競争法に関する取り組み」
www.tel.co.jp/about/compliance/index.html#compliance05

■ 内部通報制度

当社は、従業員が安心、安全に職制以外のルートで情報提供および救済を求められるよう、法令または企業倫理に反する行為もしくはその可能性のある行為について通報・相談できる内部通報制度を確立しています。本制度では、「守秘・匿名性の確保」、「報復行為および不利益取り扱いの禁止」を徹底し、コンプライアンス違反行為に関与した従業員などが自ら通報・相談をおこなった場合には、懲戒処分などを減免できる「社内リニエンシー制度」を導入しています。これにより、積極的な情報提供を促し、問題の早期発見・解決につなげています。

■ グローバル内部通報の対応基本フロー



※ 会社から指定された通報対応従事者

コンプライアンス

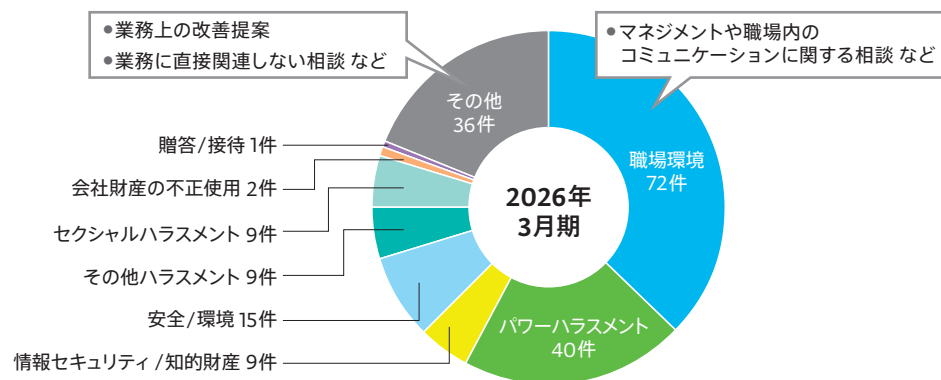
この内部通報制度では、お取引先さまや退職者も利用可能な第三者機関のシステムを活用した、グローバル統一の社内窓口「TELグループ倫理・コンプライアンスホットライン」および弁護士事務所に直接相談できる社外窓口を設置し、運用しています。社内窓口は、電話や専用サイト経由で24時間365日利用可能であり、従業員が使用するすべての言語に対応しています。

これらの窓口寄せられた通報・相談には真摯に対応し、社内規程に則って調査を実施しています。コンプライアンス違反が認められた場合、就業規則に基づく処分や職場環境の改善など、必要な正措置および再発防止策を講じています。

2026年3月期に内部通報窓口寄せられた通報・相談件数は193件、そのうちコンプライアンス違反と認定された事案は19件（立件・起訴された事案0件）でした。主な内容は、ハラスメントを含む職場環境に関するもので、これを受けてハラスメント防止を目的とした定期的な教育を実施するとともに、当事者および関係者へのフォローアップを徹底しています。

その一方で、2026年3月期の台湾でのインシデントを踏まえ、全従業員に対する情報セキュリティ教育や実践的なワークショップを実施するなど、全社的な体制強化や従業員のリテラシー向上に取り組んでいます。

通報・相談内容の内訳



資本市場との対話

当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営層が率先してIR (Investor Relations)・SR (Shareholder Relations) 活動に取り組んでいます。

IR活動においては、四半期ごとの決算説明会や中期経営計画説明会、IR DayにCEOおよび各担当役員が登壇し、事業戦略や成長ストーリーをステークホルダーの皆さまや機関投資家さまに共有しています。また、当社では投資家さまとの深い議論を促進するためIR専門部署を設置し、対話を通じていただいたご意見を経営層へフィードバックすることで、企業価値向上につなげています。2024年3月期にはニューヨークにIR分室を開室して北米地域における投資家さまとの対面での対話の機会を増やし、当社をはじめとする日本の半導体製造装置業界についての認知拡大に努めています。なお、投資家さまとの対話を通じて把握した2026年3月期における関心事項は、市場動向や業績の概況に加え、最先端技術、競争優位性、地政学的リスクでした。

SR活動においても、当社役員を中心に主要な投資家さまや議決権行使助言会社との建設的な対話に取り組んでいます。株主総会前における議案の説明にとどまらず、年間を通してコーポレートガバナンス、環境・人権・人的資本を含むサステナビリティへの取り組みなど、さまざまなテーマに関して対話を重ね、相互理解を深めるとともに、情報開示の充実につなげています。

両活動を通じて投資家さまとの対話で得られたご意見などは、定期的に経営層および取締役会に報告しています。

主な活動

対話の機会※1	IR活動	●機関投資家さま向け個別ミーティング 国内投資家223件、海外投資家359件、証券会社カンファレンス332件、国内ロードショー※2 8件、海外ロードショー 35件、当社主催スモール2件、その他※3 45件 計1,004件（うち経営層同席70件） ●工場・施設見学会5件（うち海外研究所見学会1件）
	SR活動	●機関投資家さま向け個別ミーティング25件
情報の提供	決算説明会 中期経営計画説明会 IR Day	●同時通訳を活用した配信 ●説明会から1営業日以内のアーカイブ配信、2営業日以内の質疑応答集の開示
	定時株主総会	●招集通知のウェブサイト掲載や早期発送 ●プレゼンテーション資料、質疑応答集の開示
資料の開示	IR関連	●有価証券報告書、半期報告書、統合報告書、データブック（各年1回） ●決算短信、決算説明会資料、Investors' Guide（各年4回）

※1 2026年3月期 ※2 ロードショー：株主・投資家さまを直接訪問するIR活動 ※3 SEMICON West、SEMICON Japanなど

コーポレートガバナンス

ハイブリッド型のガバナンス体制

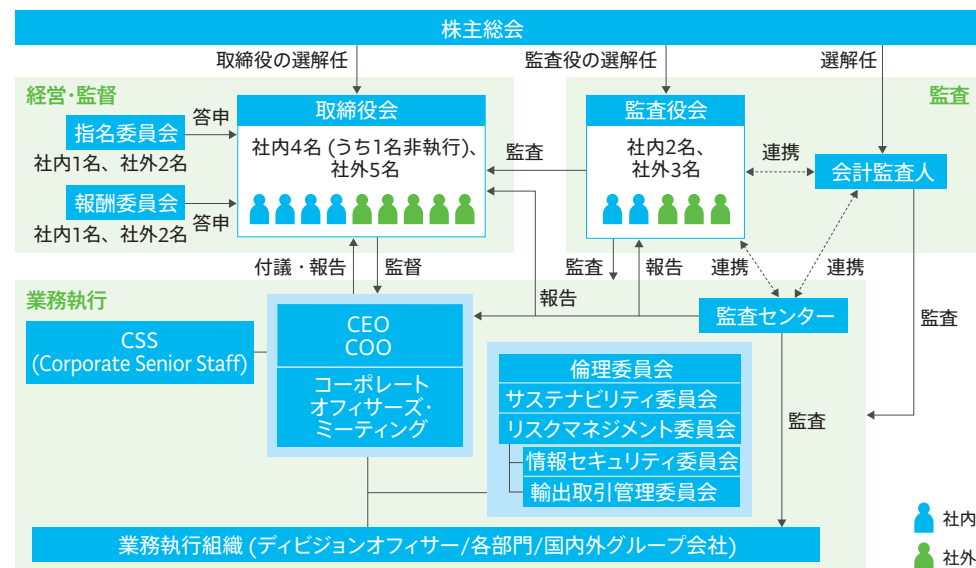
当社は、取締役会から独立した監査役会による監査機能を確保しつつ、取締役の過半数を社外取締役とすることで、取締役会の独立性を高め、監督機能を強化しています。また、指名委員会および報酬委員会を設置して、いずれも委員の過半数を社外取締役とし、委員長も社外取締役が務めています。さらに、コーポレートオフィサー制度を導入し、適切な権限委譲により、迅速な意思決定と機動的な業務執行による強い執行体制の整備を図っています。このように、監査役会設置会社の長所を活かしつつ、指名委員会等設置会社の要素も取り入れた、ハイブリッド型の実効性あるガバナンス体制を構築しています。

コーポレートガバナンスの変遷

年	社外取締役 (比率)	■ 制度全般 ■ 指名・報酬関係 ■ 取締役会実効性評価
1998	1名	■ 報酬委員会設置 ■ スtockオプション制度導入
1999		■ 代表取締役の個別報酬開示
2000		■ 指名委員会設置
2002	2名	■ 取締役任期2年 → 1年
2003		■ 執行役員制度導入
2016		■ 自己評価開始
2017		
2018	3名	■ 中期インセンティブ制度導入
2019		■ 報酬委員会委員長: 社外取締役 ■ 第三者機関関与開始
2020		■ 社外取締役の株式報酬制度導入
2021	4名 (33%)	■ 指名委員会委員長: 社外取締役 ■ 株式保有ガイドライン、クローバックポリシー導入
2022	3名 (50%)	■ コーポレートオフィサー制度導入 ■ 指名委員会・報酬委員会: 社外取締役 過半数
2023		
2024	4名 (57%)	
2025	5名 (63%)	■ 役員報酬制度見直し
2026	5名 (56%)	

コーポレートガバナンスの枠組みの詳細は、当社ウェブサイト「コーポレートガバナンス」をご参照ください
www.tel.co.jp/about/cg/

コーポレートガバナンス体制図



指名委員会・報酬委員会の構成と活動状況

	指名委員会	報酬委員会
	2026年7月1日現在	2026年7月1日現在
委員の構成	委員長 鈴木 ゆかり (社外) 委員 篠原 幸弘 (社外) 田原 計志 (社内)	委員長 ジョセフ・クラフト (社外) 委員 ジェニファー ロジャーズ (社外) 田原 計志 (社内)
開催回数 (2026年3月期)	7回	8回
主な審議内容	- 取締役の選解任に関する株主総会議案関連事項 - CEOの選解任に関連する事項 - 東京証券取引所が定める独立役員要件を満たす取締役候補者 - CEO等の後継者育成状況に関する監督	- 報酬制度及びプロセスに関する議論 - 中期インセンティブ2025年プランの決定 - 代表取締役のミッション及び個人評価の決定 - 代表取締役の基本報酬、短期業績連動報酬の決定 - 社内取締役等の報酬決定プロセスの確認 - 役員報酬制度に関する開示及び株主総会議案の決定

コーポレートガバナンス

取締役、監査役、およびコーポレートオフィサー一覧 (2026年7月1日現在)

取締役

	かわい としき 河合 利樹 代表取締役社長 CEO コーポレートオフィサー
	いしだ ひろし 石田 博之 代表取締役副社長 COO コーポレートオフィサー
	たはら かずし 田原 計志 取締役 取締役会議長
	はやし しんいち 林 伸一 取締役 コーポレートオフィサー 専務執行役員 東京エレクトロン九州 (株) 代表取締役社長
	さ さ き みちお 佐々木 道夫 社外取締役 (株) SHIFT 取締役会長
	ジョセフ・クラフト 社外取締役 Rorschach Advisory Inc. CEO ソニーグループ (株) 社外取締役 日本電気 (株) 社外取締役
	すずき 鈴木 ゆかり 社外取締役 セコム (株) 社外取締役 (株) 三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役
	しのはら ゆきひろ 篠原 幸弘 社外取締役
	ジェニファー ロジャーズ 社外取締役 アシュリオンジャパン・ホールディングス 合同会社 ゼネラル・カウンセラー・インター ナショナル (株) 三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役 (株) アシックス 社外取締役

監査役

	ななざわ ゆたか 七澤 豊 監査役
	まつうら つくひこ 松浦 次彦 監査役
	みうら りょうた 三浦 亮太 社外監査役 弁護士法人三浦法律事務所 パートナー
	えんどう ゆたか 遠藤 寛 社外監査役
	まきの こ 牧野 あや子 社外監査役 牧野公認会計士事務所 所長 (株) 第一ライフグループ 社外取締役 (監査等委員)

コーポレートオフィサー

	あきやま けいいち 秋山 啓一 コーポレートオフィサー 専務執行役員
	ただ しんご 多田 新吾 コーポレートオフィサー 常務執行役員
	あ そ たつや 阿曾 達也 コーポレートオフィサー 常務執行役員
	どう かずひろ 堂 和寛 コーポレートオフィサー 常務執行役員

各取締役の選任理由の詳細は、当社ウェブサイト
「第63期定時株主総会招集ご通知」をご参照ください
[www.tel.co.jp/ir/stocks/asm/
m0nu5200000000ij-att/63_01.pdf](http://www.tel.co.jp/ir/stocks/asm/m0nu5200000000ij-att/63_01.pdf)

コーポレートガバナンス

スキルマトリックス

各取締役・監査役が、「グローバルビジネス」「ガバナンス」「サステナビリティ」のほかに、指名委員会及び取締役会において定めた、以下のようなスキルを発揮することにより、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を実現します。

氏 名			期待するスキル項目					
			企業経営	半導体市場	製造・開発	営業・マーケティング	財務会計・資本市場との対話	法務・リスクマネジメント
取締役	河合 利樹	再任	●	●	●	●		
	石田 博之	新任		●		●		
	田原 計志	再任	●	●	●	●		
	林 伸一	新任	●	●	●			
	佐々木 道夫	再任 社外	●		●	●		
	ジョセフ・クラフト	再任 社外					●	●
	鈴木 ゆかり	再任 社外	●			●		
	篠原 幸弘	再任 社外	●		●			●
	ジェニファー・ロジャーズ	新任 社外						●
	七澤 豊			●			●	
監査役	松浦 次彦		●	●	●	●		
	三浦 亮太	社外						●
	遠藤 寛	社外	●				●	
	牧野 あや子	社外					●	●
			8	6	6	6	4	5

期待するスキル項目の定義及び選定理由

企業経営	取締役会の監督機能を果たすとともに、攻めと攻めのガバナンスを実現するためには、企業経営の経験（代表取締役、会長・社長経験者）が必要である。
半導体市場	技術革新が速く、市場の変化も活発な半導体製造装置業界において攻めの経営をより一層推進していくためには、半導体市場に関する知見が必要である。
製造・開発	技術動向やお客さまのニーズを踏まえた研究開発力を強化するとともに、環境に配慮した効率的な製造オペレーションを構築していくためには、当社または他の製造業における製造・開発に関する知見・経験が必要である。
営業・マーケティング	お客さまの唯一無二の戦略的パートナーとして、最適なソリューションの提案によるお客さまのさらなる価値創造に寄与するためには、当社または他の製造業における営業・マーケティングに関する知見・経験が必要である。
財務会計・資本市場との対話	成長戦略や財務戦略の策定と実行、資本効率の向上、株主還元を通した株主価値のさらなる向上を目指していくためには、財務会計、M&Aに関する知見、または、資本市場との対話についての知見・経験が必要である。
法務・リスクマネジメント	複雑化、多様化するリスクについて、ビジネスの成長の機会として、グループ全体で適切に対応するためには、法務、コンプライアンス、リスクマネジメントに関する知見が必要である。

取締役会議長メッセージ



田原 計志
取締役
取締役会議長

東京エレクトロンのビジョンは、「半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社」です。私が2025年6月に取締役会議長に就任して以降、このビ

ジョンの実現に向け、公正で透明な経営をおこなうとともに、変化し続けるさまざまなグローバルリスクを中長期的な視点で予測し対応することを常に念頭に置いて、コーポレートガバナンス体制の整備・強化に継続的に取り組んでまいりました。

2025年3月期の取締役会実効性評価において、「会社の成長・将来の姿に応じた取締役会の役割・目指す姿について監督・執行間で目線合わせをおこなう」、「当社のガバナンス体制について機関設計を含めた継続的な議論をさらに深化させる」、「執行人材の後継者計画の取り組みを加速する」、「コーポレートオフィサー制度の総括をおこない、今後の執行体制の在り方を検討する」の4点が課題・必要な取り組みとして挙げられました。2026年3月期はこれらのテーマについて、取締役会、指名委員会、オフサイトミーティング、また取締役会後に開催する社外役員とのフリーディスカッションなどさまざまな場で、議論を進めてまいりました。こうした議論を通して、改善に向けて進捗が見られたものがある一方で、新たな課題も認識されました。2027年3月期は、これらの課題認識を踏まえて、東京エレクトロンのコーポレートガバナンスを次の段階へ進めるため議論をさらに深化させ、具体的な実行に移していきたいと思っております。

オープンでフラット、風通しの良い企業風土という当社の強みを、取締役会においても大事にしながら、オープンでスピード感のある議論と最善の意思決定により、資本市場からの期待に応え、持続的な成長と中長期的な企業価値を向上すべく、実効性のある取締役会を実現してまいります。

コーポレートガバナンス

新任役員メッセージ



石田 博之
新任取締役

当社は技術力を重視し、それを半導体製造装置として具現化することで成長してきた企業です。長年にわたるお客さまとの強い信頼関係のもとに、マーケティングをおこない、付加価値の高い高度な技術革新を継続的に推進してきました。

今後も、半導体市場が成長を続ける限り、当社は事業領域を半導体に集中し、より難易度が増す技術革新が求められる分野へ一層注力して、産業の発展に貢献し、継続的な企業価値の向上を目指します。

また、人材は当社の最大の資産です。優秀な人材の確保・育成により一層注力し、一人ひとりがこれまで以上に高い価値創造に貢献できるように組織体制を整備します。能力開発と成長を支援することで、社員の士気と実行力を高め、お客さまとの信頼の基盤をより強固にし、技術開発の成功確率を高めていきます。

半導体市場の拡大に伴い技術課題がますます高度化する中、当社は技術力と人材力を両輪として強化し、持続的な事業成長と社会への貢献を実現してまいります。



林 伸一
新任取締役

私は、東京エレクトロン九州に入社以来、20年以上にわたり塗布現像装置の開発に従事し、また社長就任後も、洗浄装置や3次元実装装置の開発と生産に携わってまいりました。数多くのチャレンジと失敗を経験しながらも、常にお客さまの期待に応えることを追求してきました。

イノベーションは、多様なアイデアや悩み、失敗、経験が組み合わさって生まれるものです。当社にはそのイノベーションを育むための環境が整っています。他社にはない豊富な製品ラインアップ、開発と生産が一体となったものづくり体制、風通しが良くチャレンジできる企業風土、お客さまのニーズや市場の変化に対する高い適応力が強みです。

今後は、取締役会の一員となり、ONE TELとしての開発・生産の横連携のさらなる強化、挑戦する企業風土の維持・強化、当社の強みを生かした数多くの差別化技術の創出などを後押ししてまいります。

これにより、半導体の技術革新に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現していく所存です。



ジェニファー ロジャーズ
新任社外取締役

このたび、株主の皆さまのご選任により、半導体製造装置産業で中核的な役割を担うグローバル企業である東京エレクトロンの取締役に就任いたしましたことを、大変光栄に存じます。

半導体は多くの産業にとって不可欠な基盤であり、生成AIや技術革新の進展により、今後ますますその意義は高まると認識しております。市場環境や地政学的変化が続く中、当社がグローバルに果たす役割は一層大きくなっており、持続的な成長に向けた取り組みの重要性も増しております。

これまで6カ国で業務に従事し、グローバルな視点で事業を推進するとともに、多様なチームを率いてまいりました。その経験から、競争力を維持するためには、地政学的・金融的なリスクを的確に把握するだけでなく、機会を見極め、迅速に変革を実行することが重要であると認識しております。

こうしたグローバルでの経験に加え、金融業界における知見および法務・規制対応のバックグラウンドを活かし、当社の持続的な成長に貢献するとともに、株主およびステークホルダーの皆さまの期待に応えてまいります。

コーポレートガバナンス

取締役会実効性評価

2026年3月期の取締役会の活動を振り返り、アンケートおよび個別インタビューに基づく外部専門家による分析結果を踏まえて、社外役員による意見交換会や取締役会における討議を重ね、以下のとおり自己評価を実施いたしました。

 当社ウェブサイト「当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について」 www.tel.co.jp/news/ir/2026/jir4640000000p6-att/20260529_003.pdf

2025年3月期の課題と進捗状況	
課題	対応状況
取締役会の機能と役割 - 会社の成長・将来の姿に応じた取締役会の役割・目指す姿について、監督・執行間で目線合わせをおこなう。 - 当社のガバナンス体制について、機関設計を含め継続的な議論をさらに深化させる。	様々なテーマに関する議論を通じて、取締役会の役割や当社のガバナンス体制について、監督・執行間で目線合わせに継続的に取り組んだ。 2025年3月期の実効性評価の課題について、取締役会議長がコーポレートオフィサーに対しておこなったヒアリングの結果を踏まえ、コーポレートオフィサーズ・ミーティングで議論をおこなった後、取締役会メンバーによる討議を実施した。 - オフサイトミーティングにおける中期経営計画の集中討議などを通し、監督・執行間で取締役会が重視する監督上の論点について共有した。 - 取締役会終了後に開催するフリーディスカッションにおいて、当日の審議内容をはじめとする様々なテーマで意見交換をおこない、アジェンダ設定や議論のポイント等取締役会に関する課題認識を共有した。 - 当社に適した機関設計を検討するべく、複数回にわたって個別会議を開催して、監督と執行それぞれの考え方を共有し議論を深めた。
執行体制 - コーポレートオフィサー制度の総括をおこない、今後の執行体制の在り方を検討する。 - 執行人材の後継者計画の取り組みを加速する。	- コーポレートオフィサーによるコーポレートオフィサー制度の振り返りを実施し、コーポレートオフィサーズ・ミーティングでの戦略的な議論のさらなる充実が必要であるとの認識を共有した。 - 次世代経営人材を中心に構成されるディビジョンオフィサーズ・ミーティングにおいて、CEO参加のもと会社の経営課題に関する議論等を通じて、執行人材の後継者育成を推進した。 - 社外役員との継続的な協議を通じて、後継者計画の議論が進展し、あらためて指名委員会高度化の必要性が認識された。

2026年3月期の評価結果の概要と今後の取り組み

評価結果の概要	今後の取り組み
- 取締役会の役割・責務を、総じて高い実効性を担保しながら適切に果たしており、指名委員会・報酬委員会を含め有効に機能している。 - 外部専門家の分析・評価結果を踏まえ、持続的な成長に向けた会社のありたい姿に照らし、取締役会がどのような機能と役割を担うべきかについて継続的に議論していくとともに、執行側においては経営・執行機能のさらなる強化を図っていくことが引き続き必要であることを確認した。	- 当社の企業価値向上に向けて、取締役会の戦略的なアジェンダ設定と議論のさらなる充実を図る。 - 指名委員会の高度化に向けて、取締役候補者選出にあたっての取締役会との情報共有のあり方等について継続的に改善に取り組む。 - 機関設計をはじめとするガバナンス体制の今後のあるべき姿について、具体的な議論を継続する。

2026年3月期の取締役会および
オフサイトミーティングの主な議題

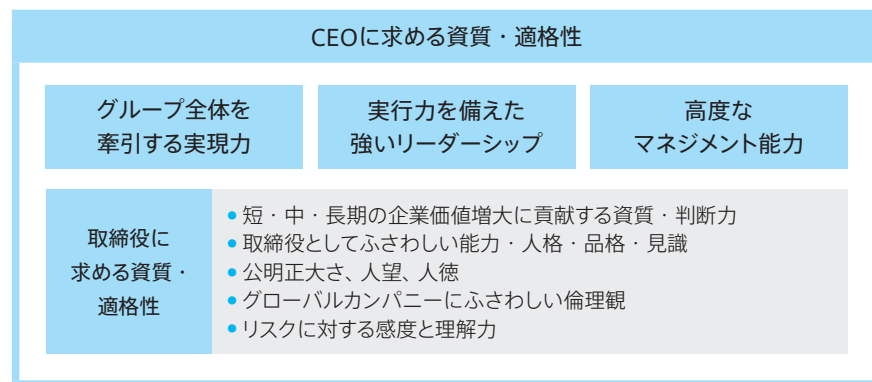
CEO	- CEOの業務執行状況報告（毎回） - CEOミッションの共有
中長期戦略	- 現中期経営計画の振り返り - 新中期経営計画に向けて - 中長期の開発戦略 - 米国におけるビジネスの現状 - 資本政策（キャピタルアロケーションと株主還元方針） - DX・AI導入による効果 - 人的資本
サステナビリティ	- SSB)基準に則った情報開示 - 人権・環境 - サプライチェーンマネジメント - 知的財産活動
リスク・コンプライアンス	- リスクマネジメント - 法務・コンプライアンス - 情報セキュリティ - 地政学 - インシデント事案
コーポレートガバナンス	- 内部監査に関する報告 - 投資先の状況（政策保有株式一部売却） - IR活動の状況 - 指名委員会・報酬委員会の活動状況 - 後継者育成計画の進捗状況 - 取締役会規程、コーポレートオフィサーズ・ミーティング規程の一部改訂 - 取締役会実効性評価の課題進捗状況 - 代表取締役評価クロズド・セッション

コーポレートガバナンス

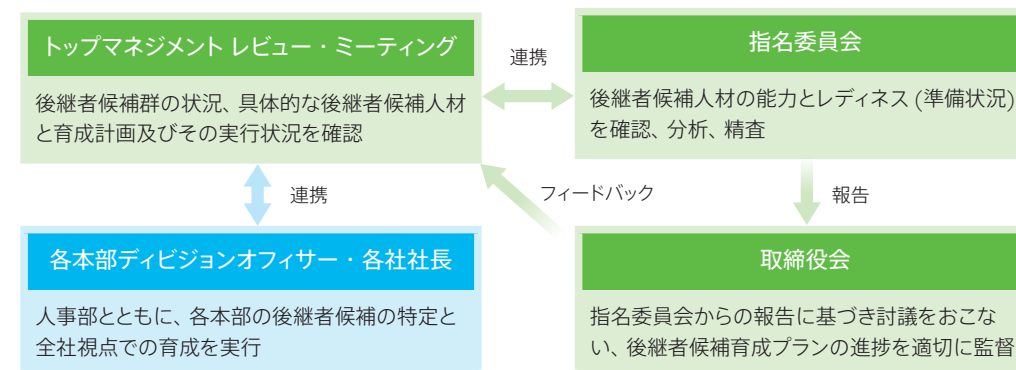
サクセッションプラン

当社は、指名委員会活動ガイドラインにおいて、CEOや取締役役に求められる資質や適格性（下図ご参照）やCEOの選解任検討の起点となる事項を定めています。

CEOの後継者育成については、TELサクセッションプランに基づき、次世代経営人材の候補者群を形成し、CEOによる監督のもと、グループ経営にかかわるミッション等を通じて、後継者の育成に努めています。代表取締役、指名委員、人事担当執行役員等が出席するトップマネジメント レビュー・ミーティングと、指名委員会、取締役会が連携して、具体的な後継者候補人材と育成計画及びその実行を進めています。なお、CEOは後継候補者となり得る階層の人材育成を進めるものの、後継候補者からの具体的な候補者指名に進む段階においては、その過程に関与しない方針です。



サクセッションプランの体系図



社外役員への情報提供

当社では、取締役会の実効性向上を図るため、専用の情報共有ツールを活用し、取締役会の資料を始め、重要な情報を適宜共有するとともに、社外役員向けに取締役会の議案について個別の事前説明をおこなう他、必要に応じて個別事案の詳細な説明の機会を設けるなど、的確な情報共有に努めています。

新任の社外役員には、当社の経営戦略や事業内容について関係部署からの説明の機会を設け（2026年3月期は計10回実施）、当社への理解を深めていただいています。

また、2026年3月期は、東京エレクトロン テクノロジーソリューションズの藤井事業所・穂坂事業所（山梨）および東北事業所（岩手）を社外役員とともに訪問しました。製造現場を視察するとともに、現場の従業員との対話の機会を設けることで、半導体製造装置への理解を深め、取締役会での建設的な議論につなげています。



東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
藤井事業所（山梨）の視察

コーポレートガバナンス

役員報酬制度

社内取締役の報酬については、中長期的な企業価値・業績向上との連動性を一層高めるために、以下のような報酬体系としています。

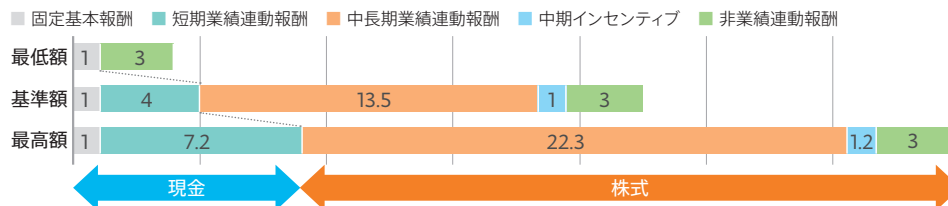
なお、社外取締役の報酬は、「固定基本報酬」及び「非業績連動報酬」で構成され、監査役の報酬は、経営の監査・監督が主たる役割であることを踏まえ「固定基本報酬」のみとしています。

役員報酬制度の概要 (制度の詳細は右表ご参照)

報酬の種類	固定基本報酬	短期業績連動報酬	中長期業績連動報酬	中期インセンティブ	非業績連動報酬
	現金	現金	株式報酬型 ストックオプション	株式交付信託	株式報酬型 ストックオプション 株式交付信託
社内取締役	●	●	●	●	●
社外取締役	●				●
監査役	●				

CEOの報酬構成割合

※ 数字は固定基本報酬を1とした場合の構成割合



報酬委員会委員長メッセージ



佐々木 道夫
社外取締役
前報酬委員長

社内取締役の報酬について、2025年3月期から「年次業績連動報酬」（現金）に代えて、「短期業績連動報酬」（現金）および「中長期業績連動報酬」（株式）を導入したことにより、株式報酬の比率が高くなり、中長期的な企業価値・業績向上との連動が一層強化され、競争力のある報酬体系になりました。この1年、「短期業績連動報酬」の財務を中心とした業績評価のKPI検証と年初に設定されたミッションに関する評価（非財務業績評価）、および「中長期業績連動報酬」の定量評価のKPI（3年）の途中経過の検証をおこなったほか、競合との比較・報酬競争力を加味した「中長期業績連動報酬」の基準額の見直しについて議論し、取締役会で承認されました。

一層強化され、競争力のある報酬体系になりました。この1年、「短期業績連動報酬」の財務を中心とした業績評価のKPI検証と年初に設定されたミッションに関する評価（非財務業績評価）、および「中長期業績連動報酬」の定量評価のKPI（3年）の途中経過の検証をおこなったほか、競合との比較・報酬競争力を加味した「中長期業績連動報酬」の基準額の見直しについて議論し、取締役会で承認されました。

短期業績連動報酬（現金）

- 単年度業績に連動
- 支給額の算定方法（右図）
[財務を中心とした業績評価]
ワールドクラスの目標達成において重視している連結営業利益率等で評価
[非財務業績評価]
個人別に設定されるミッション（評価項目）で評価。ミッションには、持続的な成長及び中長期的な企業価値向上に向けたサステナビリティに関する内容、並びに短期・中期経営戦略目標に対する取り組みに関する内容を含む

$$\text{基準額} \times \text{財務を中心とした業績評価} \times \text{非財務業績評価} = \text{支給額}$$

職責の大きさ等に応じて設定 0～150% ±20% 0～180%

中長期業績連動報酬（株式報酬型ストックオプション）

- 業績評価期間3カ年
業績評価期間終了後に、業績評価に応じた割合が権利行使可能
- 権利行使可能株式数の算定方法（右図）
[定量評価]
フィラデルフィア半導体指数との比較による相対TSR（株主総利回り）、競合企業との連結営業利益率、連結営業利益成長率の比較で評価
[定性評価]
長期的な企業価値向上に向けた取り組みを報酬委員会が評価

$$\text{基準額に基づく付与数} \times \text{定量評価} \times \text{定性評価} = \text{権利行使可能株式数}$$

職責の大きさ等に応じて設定 0～150% ±10% 0～165%

中期インセンティブ（株式交付信託）

- 対象期間（3事業年度）における最終事業年度の業績目標の達成度に応じた支給率（0%・50～120%）の範囲で支給
- 株式交付ポイントの算定方法（下図）
業績評価指標には、連結営業利益率と連結ROEを採用

$$\text{基準ポイント（職責の大きさ等に応じて設定）} \times 70\% \times \text{連結営業利益率連動係数} + \text{基準ポイント（職責の大きさ等に応じて設定）} \times 30\% \times \text{連結ROE連動係数} = \text{株式交付ポイント}$$

非業績連動報酬（社内取締役：株式報酬型ストックオプション、社外取締役：株式交付信託）

- 社内取締役
[株式報酬型ストックオプション]
付与数は職責の大きさ等に応じて設定。3年間の権利行使制限期間を設定
- 社外取締役
[株式交付信託]
対象期間（3事業年度）終了後に株式を交付

コーポレートガバナンス

監査役会の活動

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査方針、監査計画に従い、取締役の職務執行全般にわたって監査をおこなっています。

2026年3月期の主な活動状況

活動状況	常勤監査役	社外監査役
監査役会 (計8回)	●	●
取締役会 (計10回)	●	●
重要会議 コーポレートオフィサーズ・ミーティング (計23回)	●	
経営会議	●	●※1
四半期レビュー会議、倫理委員会など	●	
代表取締役との意見交換会 (計4回)	●	●※2
執行役員等への個別ヒアリング (国内子会社・海外現地法人含む) (計59名)	●	
あずさ監査法人との定例会議	●	●
各種稟議書、重要契約書、無償の利益供与関係資料などの閲覧	●	
グループ監査役連絡会 (計3回)	●	●
内部監査部門 (監査センター) からの報告 (計6回)	●	
グループ各社への往査 (計3拠点)	●	
法務コンプライアンスユニットからの定例報告 (計3回)	●	●

グループ監査役連絡会

国内グループ各社の監査役の連携強化のため、グループ監査役連絡会を、年3回国内各拠点で開催しています。当社の監査方針・監査計画の共有、各社の監査結果の報告、内部統制評価 (J-SOX) やガバナンス・コンプライアンス・情報セキュリティに関する情報交換などをおこなった他、直近では、東京エレクトロン宮城 (2025年12月訪問) や東京エレクトロンのTEL デジタル デザイン スクエア (札幌) (2026年6月訪問) を見学し、現地社員の方と意見交換をおこないました。



TEL デジタル デザイン スクエア見学

※1 経営会議は、経営方針・事業戦略・中期経営計画の共有および浸透を目的に、年に2回 (春・秋) 開催される会議で、当社部長以上、関連会社執行役員以上が出席します。社外監査役も任意で経営会議に出席しています。

※2 社外監査役は、半期ごと (計2回) に出席しています。

監査役会議長メッセージ



七澤 豊
常勤監査役

当社の監査役会は、当社グループ内での事業部門、管理部門などの経験、知見を有する社内の常勤監査役と、社外でのそれぞれ異なった豊富な専門的知見を有する社外監査役から、各自の複層的、多面的な視点から意見を寄せ合い、また、監査役会以外でも、社内管理部門、リスク・コンプライアンス部門、内部監査部門からの定期的な報告の他、常勤監査役による主要会議の傍聴やグループ各社の執行役員等への個別ヒアリングなどを通じて、気づきが生じたところを随時代表取締役に具申するなど、適時性、現認を心掛けた活動をおこなっています。市場とビジネスの急速な拡大が進む中、内部統制部門や取締役との連携も今後一層きめ細かく進め、問題を未然に防ぐことに注力していきます。

社外監査役メッセージ



三浦 亮太
社外監査役

当社の監査役会活動の特徴は、財務経理、法務・コンプライアンス、知的財産、内部監査といった社内の管理部門担当者からの定期的な報告、代表取締役、監査法人やグループ監査役との意見交換、オフサイトミーティングでの社外取締役との意見交換など、多方面・多階層にわたる情報収集チャンネルが整備されていることです。その上で、社内事情に精通した常勤監査役と自らのキャリアを背景にした専門性を有する社外監査役とが連携することによって実効的な監査体制が構築されています。昨年度もさまざまなインシデントが発生しました。引き続き問題を未然に防ぐ体制の整備、問題が発生した場合に迅速な初動に努め拡大を防ぐ仕組みの構築に努めます。

社外役員座談会

東京エレクトロンが真のグローバルエクセレントカンパニーを目指しさらに成長するためには、コーポレートガバナンスの進化が欠かせません。今回は5名の社外役員が、当社の企業文化の現状と課題、取締役会の実効性向上、そして「膨張」ではなく「成長」を加速させるための戦略について、多角的な視点から議論しました。

——東京エレクトロンの企業文化について、社外役員から見た印象をお聞かせください。

遠藤監査役 当社の企業文化の特徴を一言で表すならば、今なお息づく「若さとチャレンジ精神」です。1963年の創立以来エレクトロニクス産業とともに成長を遂げてきましたが、企業が成長していく過程において、創業60年余りとなる現在の当社は、まさに「変曲点」に差し掛かっていると認識しています。事業規模や組織が拡大し、ガバナンスやステークホルダーへの情報開示の充実、E-COMPASSなど先進的な環境への取り組みが進むことは素晴らしい反面、必然的に社内ルールの精緻化を伴い、官僚機構化による活力低下や革新力の停滞を招くリスクも秘めています。この変曲点を乗り越え、10年後も真のグローバルエクセレントカンパニーであり続けるには、階層や部署を超えてオープンに議論し、若手を育成し、社員一人ひとりが能力を発揮して達成感を得られる社風を守り育てる必要があります。

鈴木取締役 遠藤監査役の指摘する「変曲点にある」と



鈴木 ゆかり
社外取締役
指名委員会委員長

遠藤 寛
社外監査役

ジョセフ・クラフト
社外取締役
報酬委員会委員長

篠原 幸弘
社外取締役
指名委員会委員

牧野 あや子
社外監査役

いう認識に、私も同感です。短期間でベンチャーから業界トップクラスへと上り詰めた当社の歴史を支えてきた柱は、「顧客第一主義」「技術開発への熱意」「起業家精神」です。今もその精神は息づいていますが、組織が巨大化し、競争環境が複雑化する今、昔のやり方をそのまま踏襲することはできません。起業家精神を保ちつつ、それを現在の文脈に合わせた具体的な行動規範として再定義し、グローバルベースで社員へ浸透させることが求められます。年齢に関わらず若々しい活力を保ち、ステークホルダーとのエンゲージメントを高め価値を共有していく姿勢を、トップマネジメントから現場まで定着させる「仕組みづくり」が、これからのフェーズではますます重要になります。

クラフト取締役 当社の文化を一言で表せば「とにかく真面目な会社」です。KPIに対する姿勢や開発への熱意は素晴らしい、成果主義が良い意味で根付いています。しかし直

視すべき当社の課題は、組織風土が「ドメスティック」であるという点です。真面目で実直な姿勢は当社の良さですが、その反面、売上の大半をグローバル市場で稼ぎながら、製造拠点や人材の多くが日本に集中しているというギャップがあります。当社は今、企業の歴史において重要な「岐路」に立っていると考えています。過去の良き文化を守りつつも、変化するグローバル環境に合わせて「変えなければならないもの」を見極める時期です。

牧野監査役 クラフト取締役の「岐路」という言葉、そして「真面目」「ドメスティック」というご指摘には、私も深く共感します。常に最先端技術を追求し、お客さまとの深い信頼関係を築きながら、近道や曖昧な手法に頼らず正攻法で成果を積み上げる真面目さこそが当社の最大の強みです。また、ドメスティックであることのポジティブな面として、工場を中心に地域社会への貢献意識が強く、地域に根差した姿勢

社外役員座談会

が浸透している点が挙げられます。しかし、監査役の視点からは、大きくなった組織をきちんと回していく仕組みがないと、この岐路がネガティブな「大きな曲がり角」になってしまう危惧をもっています。グローバルな成長を支える巨大組織を管理する仕組みと、この真面目で地域密着型の優れた文化とのバランスをどう取るかが問われています。

篠原取締役

クラフト取締役や牧野監査役がおっしゃる「真面目さ」やお客さまとの深い信頼関係は、製造業としての当社の強みです。ただ、これだけの規模になれば、これまでのお客さまに寄り添い、より良いものを提供していくというアプローチに加え、今度はお客さまの先を行き、我々から優れたものを提案・供給していくフェーズに入っています。これも事業の向き合い方における大きな岐路です。企業風土は自由闊達ですが、少し「お上品でお利口さん」な側面があり、一大事になれば全員で立ち向かう反面、状況が不明確な間は考えすぎてしまう傾向があります。目標を掲げてみんなで頑張る良さはあるものの、目標の必達に向けた緻密な計画への落とし込みという点ではもうひと工夫が必要であるという印象を受けます。グローバル企業として次の成長ステージへ移行する上で、クリアすべき点であると思います。



——この1年間の議論を踏まえ、当社の取締役会の特徴や課題についてお聞かせください。

篠原取締役

取締役会の運営面で他社より優れている

と感じるのは、CEOからの経営状況報告です。要点が端的にまとめられ、執行側が「今どう動くべきか」を整理する良いプロセスになっています。一方で、大きな方向性や具体的な戦略に関しては、もっと議論をしていく必要があると感じており、取締役会としての役割が大きく問われているのも事実です。

クラフト取締役

マクロな戦略シナリオの不足については私も同感です。当社の取締役会には「効率化」と「役割の再定義」という明確な課題があります。形式的な議案や細かな報告事項に多くの時間を割くのではなく、本来注力すべき中長期的な戦略やリスクについて議論する時間をもっと必要です。真のグローバルエクセレントカンパニーを目指すなら、国際的なガバナンスのトレンドに学び、現在の機関設計のあり方を見直す議論を始める時期にきていると考えます。

牧野監査役

クラフト取締役が言及された「役割の再定義」や、中長期的な議論の時間が不足しているという課題は重要です。議論が尽くされていない、納得のいく説明が得られていない状況であれば、次回取締役会で議論することが必要です。当社のガバナンス体制は、すでに社外取締役が過半数を占めており非常に先進的です。その裏返しとして、社外取締役には半導体業界や事業に対する専門知識が不足する面がありますが、これに関してはコーポレートオフィサーの同席や、CEOからの経営状況報告に十分な時間を取ることで、綿密な情報共有が図られています。しかし、「取締役会のあるべき姿」や「何を議論の軸に据えるか」については、役員間でまだ認識に差異があります。執行側と取締役会の間、あるいは役員間で意見が分かれる論点については、現在、田

原取締役会議長が取締役会以外で丁寧な意見聴取や取りまとめをおこなっています。この議長のリーダーシップを基盤に、取締役会の議論を深化させることが求められます。



鈴木取締役

取締役会はオープンな雰囲気であり、コーポレートオフィサーの参画によって現場のリアルな実情が伝わるため、社外取締役にとって非常に有益な場です。しかし昨年は、個別事案への対応や、クラフト取締役が指摘されたような時間的制約もあり、「中長期の戦略的議論」に十分な時間を割けませんでした。一方で、取締役会以外の非公式な場で独立社外役員同士がコミュニケーションをとる場を設け、率直な意見交換ができたことはポジティブな変化です。今後は社外役員間の連携を充実させるとともに、社内経営陣との対話の場を増やし、激変する環境に迅速に対応できる体制への「進化」を図る必要があります。

遠藤監査役

取締役会は、この1年間で課題を残しつつも確かな成果を上げました。第一に、指名委員会とCEO、そして社外取締役とのコミュニケーションが深まり、次代に向けたサクセッションプランの議論が進んだことです。第二に、リスクとチャンスが交錯する経営環境の中で、活発な議論がおこなわれました。社外役員がガバナンス強化に向けて忌憚なく意見を述べる気運と、執行サイドがそれを真摯に受け止める姿勢がありました。これからの1年が真価を問われます。サクセッションプランを軌道に乗せること。そして、歴史的な技術革新を見据え、想定外の状況変化にも執行サイドが臨機応

社外役員座談会

変に戦略を変更できるよう、緊密な連携のもとで取締役会が
強力に支援していくことが最大の使命です。

——企業の「膨張」ではなく「成長」を加速させるための課題 についてお聞かせください。

牧野監査役 会社規模の拡大が「膨張」で終わるか真の
「成長」になるかは、「価値創造」「収益性」「組織能力」が同時
に強化されているかに尽きます。価値の源泉を磨き続ける点
は当社の得意分野ですが、売上が伸びても利益率やキャッ
シュ・フローが弱ければ、次の成長投資に耐えられず膨張に陥
ります。これを防ぐには、伸びるプロダクトに資源を集中し、そ
うでないものは縮小・撤退するポートフォリオ管理が不可欠で
あり、プロダクトごとの採算性を可視化する「管理会計の強化」
が急務です。また、人数が増えても意思決定の質とスピードが
落ちないよう、権限委譲や業務の標準化を進める仕組みが欠
かせません。AIの進化や地政学リスクの高まりがビジネスモデ
ルを変えうる中、内部統制やコンプライアンスをさらに強化し、
成長速度に耐えうるガバナンスを整えることが重要です。

遠藤監査役 「収益性の強化」にもつながりますが、河合
CEOのいう「膨張ではなく成長」の真意は、既存製品の設備拡
張は限界利益率の低下をもたらさない範囲にとどめ、付加価
値の高い新製品の投入によるSAM（獲得可能な市場規模）の



拡大を図り、利益率の向上を伴った利益成長を実現することだと理解しています。当社はこれまで顧客ニーズを先取りし、密着した

サービスを提供することで絶対的な信頼を築いてきました。これ
を事業戦略の根幹としつつ成長をさらに加速させるには、
次世代半導体製造技術の開発に当社がより主体的に関わり、
先駆者利益を自ら確保していく姿勢が求められます。そのため
には、短期的には利益に直結しない基礎研究にも戦略的に取
り組むなどR&D戦略を再編・強化するとともに、戦略的な
M&A、そして買収後のPMI（統合プロセス）を成功裏に遂行で
きる体制整備と人材育成をさらに強化する必要があります。

クラフト取締役 遠藤監査役のM&Aの重要性というご
指摘に賛同します。成長加速の強力な戦略としてM&Aとス
タートアップ投資は不可欠です。当社のSAMをスピーディに
拡大させるには、「時間を買う」M&Aは極めて効果的な戦術
です。また、国内外の有望なベンチャーへの投資も、次世代
の事業を牽引する上では欠かせません。これらを実現するた
めには、単にKPIターゲットを追いかけるだけでなく、どのよ
うな技術や市場を獲得しにいくのかという「中長期的な成長
投資プラン」を、執行側
で構築していただき、
取締役会に提示いた
だけることを期待します。



鈴木取締役 戦略を実行に移すのは「人」です。事業環
境が激変する中、成長を加速させるには、現場のリーダーた
ちが活動実績をタイムリーに把握し、課題認識を即座に共有
して全社的なアクションへ結び付けるアジリティ（機敏性）が
重要です。実績管理のシステム化と組織連携のデザインを進
化させることが、利益にこだわる当社にとってのトッププライ

オリティです。さらに、熾烈な市場
において、世界中から優秀な人材
を獲得することは至上命題です。
イノベーションを生み出し続ける
ためには、あらゆるレイヤーで「人材の多様性」を加速させる
必要があります。当社は「やる気重視経営」として、仕事が生
産の発展に貢献している実感や、成果に対する公正な評価な
どを掲げていますが、多様な人材の活力を存分に引き出すに
は、例えば日本人男性社員が大半を占めるような現在の均一
な人材風景を変革し、個々の能力が活かせる社内環境を醸
成するとともに、現場リーダーへの強力なエンパワーメントが
不可欠です。そうした施策が新たなフェーズにふさわしい企
業文化の涵養へつながるはずです。

篠原取締役 組織能力を高めて多様な人材を生かすた
めには、日々のオペレーションのあり方を見直す必要があり
ます。まず、「やるべきこと」「やらないこと」、そして「機械（AI
やロボット）がやるべきこと」を明確に切り分け、大胆に計画
に落とし込んで実行することです。そして、人間は方針策定や
計画の立案といった「人がやるべき創造的な仕事」に極限ま
で集中しなければなりません。みんなの活力を引き出し後押
しすることは素晴らしいですが、全員が各々「自分最適」で動
くのではなく、組織として目標に向かって「集中してやり遂げ
ること」を徹底させる必要があります。これを推進するため
には、責任と権限を明確にもち、現場を力強く牽引できる強い
リーダーを育成・リクルートしていくことが急務です。そうし
た強靱な組織基盤をつくることこそが、当社を「膨張」から真
の「成長」へと導く鍵になるのだと確信しています。



データセクション

81 財務概況

85 11年間の主要財務データ

87 5年間の主要サステナビリティデータ

89 外部からの評価

89 国際的なイニシアティブへの参画

90 株式情報

財務概況

世界経済および市場の動向

2026年3月期の世界経済については、中東の地政学的緊張の高まりに伴うエネルギー価格の上昇などを背景に、当期末にかけては欧米諸国では物価上昇の兆しが見られるなど、今後のマクロ経済動向に注視が必要な状況となりましたが、景気は総じて底堅く推移しました。

当社グループが参画しているエレクトロニクス産業においては、データセンター向けAIサーバーの需要拡大が半導体市場全体の成長を牽引しました。

このような状況のもと、半導体製造装置市場は、前期と比べ中国における設備投資は一服感が見られた一方、生成AI用途の半導体向け設備投資が顕著に伸長しました。

情報通信技術の進展に伴うデータ社会への移行、生産性向上や新たな価値の創出に向けたAIの進化、そして脱炭素社会の実現に向けた取り組みを背景に、半導体の役割とその技術革新の重要性が高まるとともに、半導体製造装置市場も中長期的にさらなる成長が期待されています。

経営成績の状況に関する認識および分析・検討内容

当社グループの2026年3月期の経営成績については、売上高は2兆4,435億3千3百万円(前期比0.5%増)、営業利益は6,249億3千6百万円(前期比10.4%減)となりました。半導体製造装置市場においては、AIサーバーなどの先端技術が要求される領域での設備投資が活発におこなわれたことにより、当社の付加価値の高い製品の販売が好調に推移しました。また、旺盛な半導体需要に伴い、当社グループの顧客である半導体メーカーの工場稼働率が上昇しているため、過去に販売した装置に対する改造や保守用部品・サービスなどの売上も堅調に増加しました。売上高については、2期連続で過去最高を更新しました。

収益性に関しては、原材料の高騰や人件費の増加などの影響により売上総利益率は45.3%(前期比1.8ポイント減)となり、また、半導体の技術革新を支えるべく積極的な研究開発活動を推進した結果、営業利益率は25.6%(前期比3.1ポイント減)となりました。なお、研究開発費の総額は、前期から278億4千9百万円増加(前期比11.1%増)し、2,778億6千6百万円となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益は、過去最高の5,744億5千4百万円(前期比5.6%増)となり、売上高に対する比率は、前期から1.1ポイント増加し、23.5%となりました。なお、2026年3月期の特別利益1,207億2千6百万円は、主に政策保有株式を一部売却し投資有価証券売却益1,154億9千4百万円を計上したことによるものです。この結果、1株当たり当期純利益は、1,254円57銭となりました。

経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標などについては、当社グループでは売上高、営業利益率、ROE(自己資本利益率)を中期経営計画上の財務モデルにおける指標として使用しています。

生産、受注および販売の実績

当社グループは、市場の変化に柔軟に対応して生産活動をおこなっており、生産の実績は販売の実績と傾向が類似しているため、記載を省略しています。受注の実績については、短期の受注動向が顧客の投資動向により大きく変動する傾向にあり、中長期の会社業績を予測するための指標として必ずしも適切ではないため、記載していません。

なお、主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりです。

■ 2025年3月期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

相手先	販売高(百万円)	割合(%)
Samsung Electronics Co., Ltd.	286,800	11.8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.	280,618	11.5

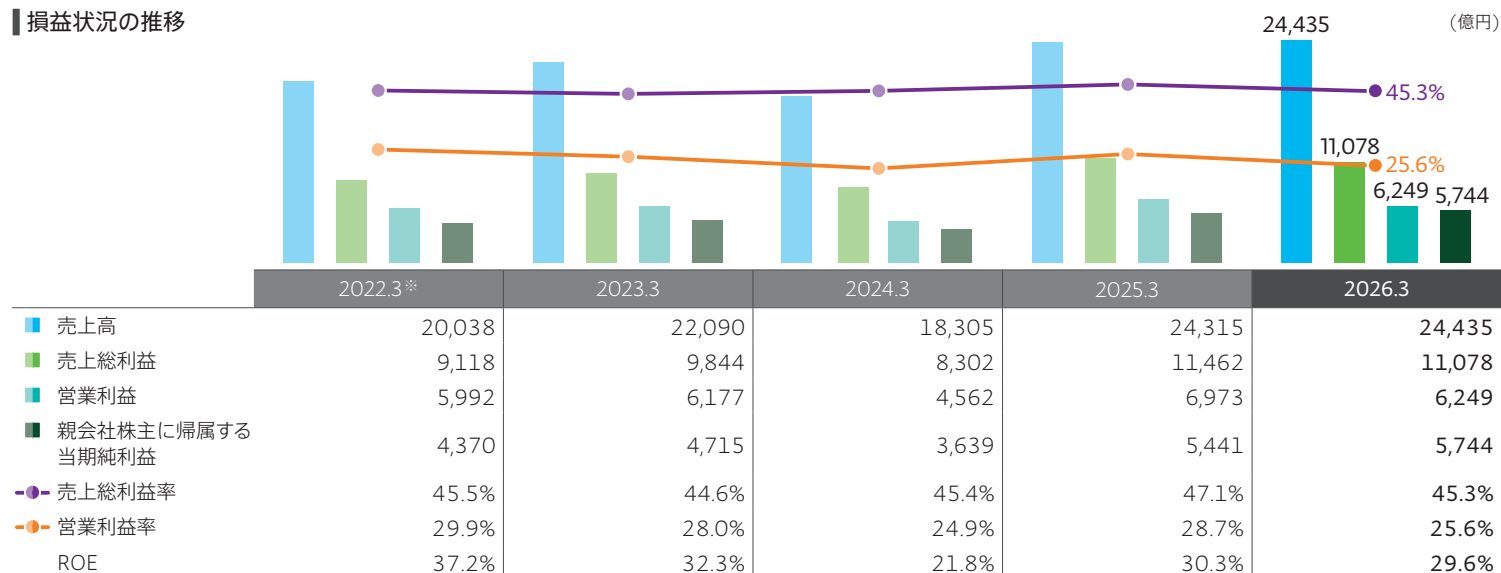
■ 2026年3月期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

相手先	販売高(百万円)	割合(%)
Samsung Electronics Co., Ltd.	368,079	15.1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.	315,813	12.9

※ 販売高には、当該顧客と同一の企業集団に属する顧客に対する販売高を含めています

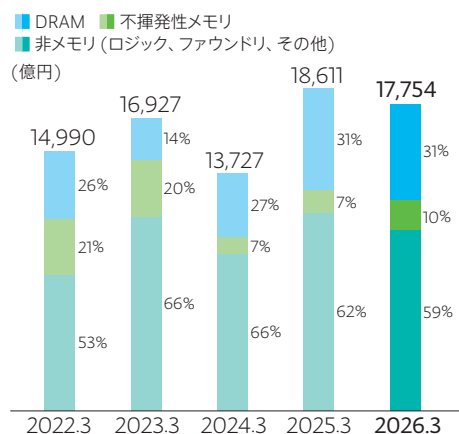
財務概況

損益状況の推移



※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しています

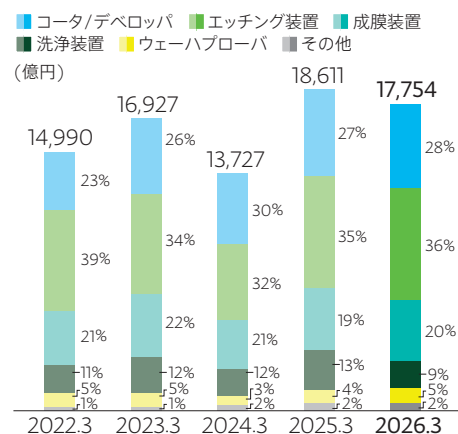
SPE※1新規装置 アプリケーション別売上構成比※2



※1 SPE (Semiconductor Production Equipment): 半導体製造装置

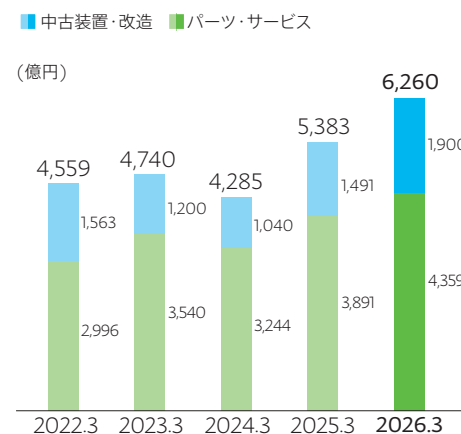
※2 グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません

SPE新規装置 製品別売上構成比※

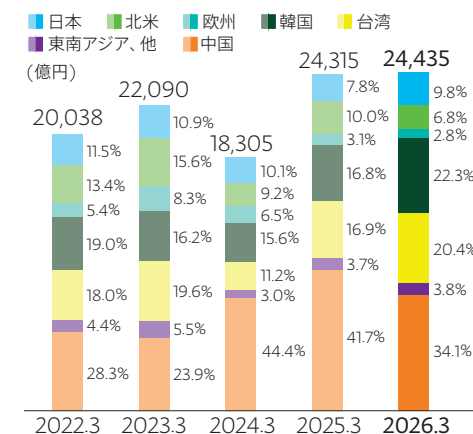


※ グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません

フィールドソリューション売上高



地域別売上高および構成比



財務概況

財政状態およびキャッシュ・フローの状況の分析・検討内容、ならびに資本の財源および資金の流動性にかかる情報

財政状態については、2026年3月期末における総資産が2兆8,609億9千7百万円となり、前期末から2,350億1千6百万円増加しました。これは主に、固定資産の増加によるものです。なお、現金及び現金同等物の2026年3月期末残高は、前期末から203億4千2百万円増加し、5,054億1千4百万円となりました。

流動資産は、前期末に比べ347億1千万円増加し、1兆8,354億6千6百万円となりました。主に、受取手形、売掛金及び契約資産の増加402億7千1百万円、現金及び預金の増加350億1千1百万円、棚卸資産の減少360億8百万円によるものです。

固定資産は、前期末に比べ2,003億5百万円増加し、1兆255億3千万円となりました。有形固定資産は、前期末から1,476億2千8百万円増加し、5,893億3千5百万円となりました。主な増加要因は、宮城県大和町および熊本県合志市の開発棟、岩手県奥州市の生産・物流センターが竣工したことによるものです。投資その他の資産は、投資有価証券の時価評価額の増加などにより、前期末から509億9千5百万円増加し、3,986億6千4百万円となりました。なお、総資産回転日数^{※1}は381日から410日へ増加しました。

流動負債は、前期末に比べ13億1千7百万円増加し、6,792億4千2百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加198億7百万円、前受金の増加140億9千8百万円、未払消費税等の減少260億2千万円、賞与引当金の減少168億8千3百万円によるものです。

固定負債は、前期末に比べ189億1千2百万円増加し、1,117億5千8百万円となりました。

純資産は、前期末に比べ2,147億8千6百万円増加し、2兆699億9千6百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益5,744億5千4百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当および当期の中間配当2,716億1千8百万円の実施による減少、自己株式取得による減少1,500億1千万円、為替換算調整勘定の増加257億4千4百万円に起因しています。この結果、自己資本比率は71.5%となりました。

キャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物に、満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金及び短期投資を加えた残高が、前期末から100億1千1百万円増

加し、5,062億5千万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローについては、前期に比べ424億4千2百万円減少の5,397億3千2百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益7,481億8千万円、減価償却費809億8千2百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額1,783億7千2百万円、投資有価証券売却損益1,154億9千4百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出2,089億8千4百万円、投資有価証券の売却による収入1,173億8千7百万円などにより、前期の1,696億9百万円の支出に対し964億9千2百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払2,716億1千8百万円、自己株式の取得による支出1,500億1千万円などにより、前期の3,888億3千6百万円の支出に対し4,253億5千9百万円の支出となりました。

2026年3月期においては、営業活動を通じて創出した高水準のキャッシュを原資として、将来の成長と競争力の強化に向けた研究開発や設備投資を継続しました。また、資本効率の向上を図る施策として、政策保有株式の一部売却もおこないました。その結果、フリーキャッシュ・フロー^{※2}は、過去最高の4,332億4千8百万円の収入となりました。また、当社グループの株主還元政策である配当性向50%に基づく配当金の支払いと自己株式の取得によって、4,216億1千5百万円を株主に還元しました。これらは、事業運営を通じて獲得した手元資金によって賄っており、前述のフリーキャッシュ・フローの97%に相当します。引き続き、高利益率によってつくり上げた強固な財務基盤を維持するとともに、将来への成長投資と積極的な株主還元に取り組んでいきます。

なお、当社グループの経営指標の一つであるROE（自己資本利益率）については29.6%となりました。

※1 総資産回転日数＝当連結会計年度期首・期末の総資産の平均÷当連結会計年度の売上高×365

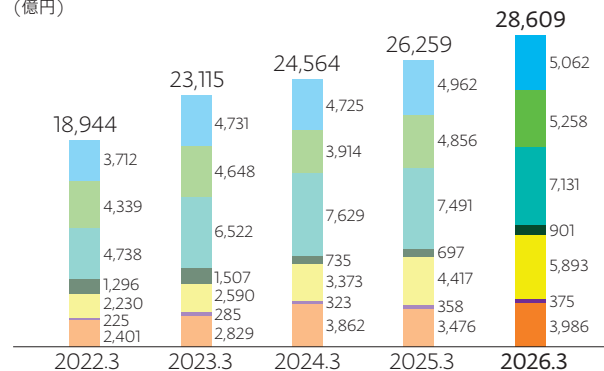
※2 フリーキャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー（定期預金及び短期投資の増減を除く）

財務データの詳細は、当社ウェブサイト「有価証券報告書」をご参照ください
www.tel.co.jp/ir/library/fs/

財務概況

貸借対照表 資産

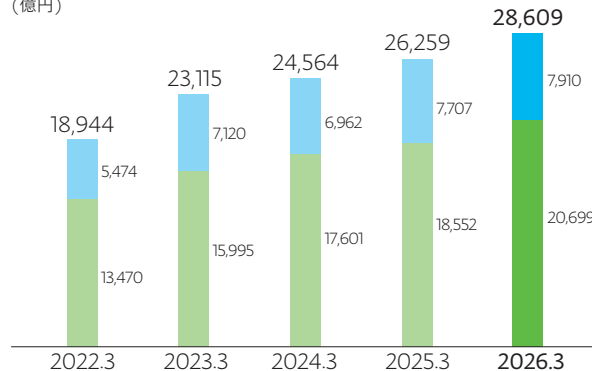
現金及び現金同等物* 売上債権及び契約資産 棚卸資産
その他の流動資産 有形固定資産 無形固定資産 投資その他の資産
(億円)



※ 現金及び現金同等物: 現預金+短期投資等 (貸借対照表上の表示は有価証券)

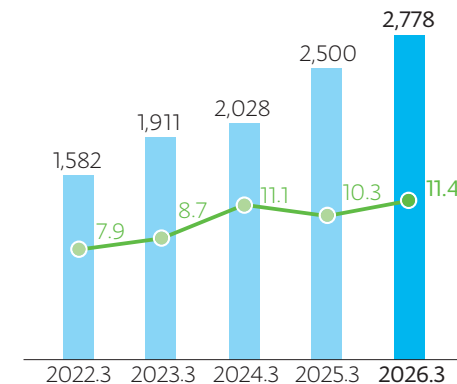
貸借対照表 負債・純資産

負債 純資産
(億円)



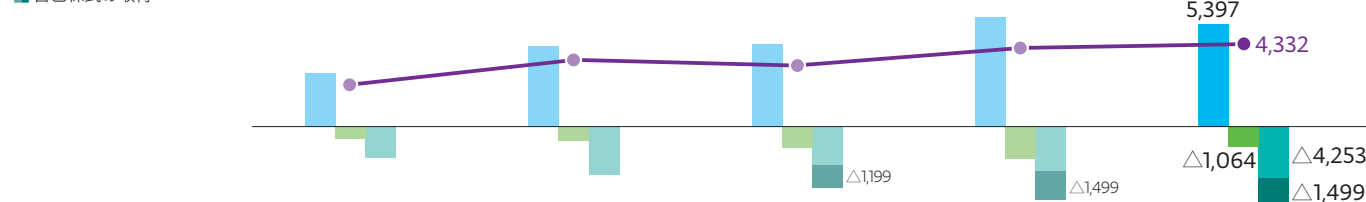
研究開発費および対売上高比率

研究開発費 (億円) 対売上高比率 (%)



キャッシュ・フロー

自己株式の取得※1



	2022.3	2023.3	2024.3	2025.3	2026.3
営業キャッシュ・フロー	2,833	4,262	4,347	5,821	5,397
投資キャッシュ・フロー※2	△656	△767	△1,150	△1,697	△1,064
財務キャッシュ・フロー	△1,672	△2,565	△3,250	△3,888	△4,253
フリーキャッシュ・フロー※3	2,177	3,494	3,196	4,124	4,332
手元資金残高※4	3,712	4,731	4,725	4,962	5,062

※1 自己株式の取得は、単元未満株式の買取りに要した金額を除いた金額です

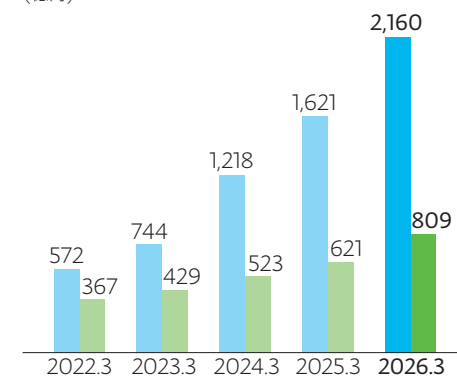
※2 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です

※3 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー (定期預金および短期投資の増減を除く)

※4 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です

設備投資額および減価償却費

設備投資額 減価償却費
(億円)



11年間の主要財務データ

東京エレクトロン株式会社および連結子会社
2016年3月期から2026年3月期

2016年3月期以前まで四捨五入にて表示している百万円および千円単位未満の金額ならびに千株未満の株数は、2017年3月期より切り捨てで表示しています。このため、2017年3月期以降においては、合計値が各項目に表示された数値の合計と一致しない場合があります。

	2016.3	2017.3	2018.3	2019.3※3	2020.3	2021.3	2022.3※4	2023.3	2024.3	2025.3	2026.3
	(百万円)										
売上高	¥ 663,949	¥ 799,719	¥ 1,130,728	¥ 1,278,240	¥ 1,127,286	¥ 1,399,102	¥ 2,003,805	¥ 2,209,025	¥ 1,830,527	¥ 2,431,568	¥ 2,443,533
半導体製造装置	613,033	749,893	1,055,234	1,166,781	1,060,997	1,315,200	1,943,843	2,155,206	—	—	—
FPD製造装置	44,687	49,387	75,068	111,261	66,092	83,772	59,830	53,674	—	—	—
その他	6,229	438	425	197	197	129	131	144	—	—	—
営業利益	116,789	155,697	281,172	310,571	237,292	320,685	599,271	617,723	456,263	697,319	624,936
税金等調整前当期純利益	106,467	149,116	275,242	321,508	244,626	317,038	596,698	624,856	473,439	706,114	748,180
親会社株主に帰属する当期純利益	77,892	115,208	204,371	248,228	185,206	242,941	437,076	471,584	363,963	544,133	574,454
包括利益	60,984	119,998	206,152	242,696	187,084	305,801	486,183	501,421	478,281	476,095	624,335
国内売上高	121,808	101,122	148,760	208,796	161,812	197,566	230,368	239,937	184,982	189,979	239,427
海外売上高	542,141	698,597	981,967	1,069,443	965,474	1,201,535	1,773,437	1,969,088	1,645,544	2,241,588	2,204,106
減価償却費※1	19,257	17,872	20,619	24,323	29,107	33,843	36,727	42,927	52,339	62,148	80,982
設備投資額※2	13,341	20,697	45,603	49,754	54,666	53,868	57,288	74,432	121,841	162,171	216,063
研究開発費	76,287	83,800	97,103	113,980	120,268	136,648	158,256	191,196	202,873	250,017	277,866
総資産	793,368	957,447	1,202,796	1,257,627	1,278,495	1,425,364	1,894,457	2,311,594	2,456,462	2,625,981	2,860,997
純資産	564,239	645,999	771,509	888,117	829,692	1,024,562	1,347,048	1,599,524	1,760,180	1,855,209	2,069,996
従業員数 (名)	10,629	11,241	11,946	12,742	13,837	14,479	15,634	17,204	17,702	19,573	20,236

11年間の主要財務データ

	2016.3	2017.3	2018.3	2019.3 ^{※3}	2020.3	2021.3	2022.3 ^{※4}	2023.3	2024.3	2025.3	2026.3
	(円)										
1株当たり当期純利益											
1株当たり当期純利益 ^{※5}	¥ 153.70	¥ 234.09	¥ 415.16	¥ 504.53	¥ 390.19	¥ 520.73	¥ 935.95	¥ 1,007.82	¥ 783.75	¥ 1,182.40	¥ 1,254.57
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 ^{※5}	153.33	233.45	413.74	502.41	388.01	517.76	931.30	1,003.86	781.20	1,179.08	1,250.88
1株当たり純資産額 ^{※5}	1,142.79	1,306.50	1,558.16	1,790.59	1,755.99	2,170.73	2,857.48	3,389.68	3,773.11	4,016.34	4,498.85
1株当たり配当額 ^{※5}	237.00	352.00	624.00	758.00	588.00	781.00	1,403.00	1,711.00	393.00	592.00	628.00
発行済株式総数(千株) ^{※5}	165,211	165,210	165,210	165,210	157,210	157,210	157,210	157,210	471,632	471,632	471,632
株主総数(名)	24,664	21,937	35,186	50,843	30,348	29,547	34,258	51,723	78,898	133,425	114,525
	(%)										
ROE(自己資本利益率)	13.0	19.1	29.0	30.1	21.8	26.5	37.2	32.3	21.8	30.3	29.6
営業利益率	17.6	19.5	24.9	24.3	21.0	22.9	29.9	28.0	24.9	28.7	25.6
自己資本比率	70.9	67.2	63.8	70.0	64.1	71.1	70.5	68.7	71.1	70.1	71.5
総資産回転率(回)	0.80	0.91	1.05	1.04	0.89	1.03	1.21	1.05	0.77	0.96	0.89
	(千円)										
従業員1人当たり売上高	¥ 62,466	¥ 71,143	¥ 94,653	¥ 100,317	¥ 81,468	¥ 96,629	¥ 128,169	¥ 128,401	¥ 103,407	¥ 124,230	¥ 120,751
従業員1人当たり営業利益	¥ 10,987	¥ 13,850	¥ 23,536	¥ 24,373	¥ 17,149	¥ 22,148	¥ 38,331	¥ 35,905	¥ 25,774	¥ 35,626	¥ 30,882

※1 のれん償却額および減損損失は含まれていません

※2 設備投資額は、有形固定資産の増加分を示しています

※3 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を2019年3月期の期首から適用しています

※4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しています。2022年3月期以降にかかる主要財務データについては、当該会計基準などを適用した後の財務データとなっています

※5 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しています。2016年3月期の期首に当該株式分割がおこなわれたと仮定し、1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当期純利益および1株当たり純資産額を算定しています。なお、2016年3月期から2023年3月期の1株当たり配当額、発行済株式総数については、当該株式分割前の配当金の額および株式数を記載しています

5年間の主要サステナビリティデータ

東京エレクトロン株式会社および連結子会社

2022年3月期から2026年3月期

●を付したデータは、「サステナビリティデータ2026」において第三者保証を受けています。

なお、本報告書に掲載しているデータは一部であり、すべてのデータについては当社ウェブサイト「サステナビリティデータ」をご参照ください。www.tel.co.jp/sustainability/data/index.html

			2022.3	2023.3	2024.3	2025.3	2026.3	
温室効果ガス排出量※	スコープ1排出量	スコープ1排出量 (千t-CO ₂)	16	22	21	22	28	●
		エネルギー起源 (千t-CO ₂)	12	12	12	13	15	●
		日本	10	10	10	11	13	
		海外	2	2	2	2	2	
		エネルギー起源以外の温室効果ガス排出量合計 (千t-CO ₂ e)	4	10	9	9	13	●
		エネルギー起源以外の温室効果ガス排出量 (千t-CO ₂ e) (日本)	4	10	9	9	13	
		エネルギー起源以外の温室効果ガス排出量 (千t-CO ₂ e) (海外)	0.1	0.0	0.0	0.1	0	
	スコープ2排出量	スコープ2排出量 (マーケット基準) (千t-CO ₂)	74	20	22	25	35	●
		スコープ2排出量 (ロケーション基準) (千t-CO ₂)	168	180	192	200	223	
	スコープ3排出量	スコープ3排出量 (千t-CO ₂)	12,614	14,335	11,770	12,389	14,203	

※ 温室効果ガス排出量に関する算定範囲ならびに算定方法については当社ウェブサイト「サステナビリティデータ」をご参照ください。www.tel.co.jp/sustainability/data/index.html

			2022.3	2023.3	2024.3	2025.3	2026.3	
エネルギー使用量・発電量	エネルギー	使用量 (MWh)	439,465	464,234	496,107	537,978	620,995	●
	電力		380,127	404,964	435,514	471,956	539,673	●
	ガス (都市ガス、LPG)		40,870	41,968	40,787	42,801	53,179	●
	燃料 (A重油、軽油、灯油、ガソリン)		17,496	16,430	18,808	18,538	19,817	●
	蒸気の購入		972	872	998	4,683	8,326	●

			2022.3	2023.3	2024.3	2025.3	2026.3	
水関連	水 (日本)	取水量 (千m ³)	1,204	1,255	1,293	1,288	1,669	●

			2022.3	2023.3	2024.3	2025.3	2026.3	
廃棄物排出量	危険・有害な廃棄物 (日本)	排出量 (t)	4,705	5,239	7,448	10,371	11,657	●

			2022.3	2023.3	2024.3	2025.3	2026.3	
従業員数 (グループ全体)	正規従業員 (地域別)	正規従業員数	15,140	16,605	17,071	18,893	19,532	
		日本	8,234	8,796	9,150	9,847	10,388	
		その他アジア	4,328	4,819	4,854	5,640	5,833	
		欧州・中東	578	669	708	739	679	
		北米	2,000	2,321	2,359	2,667	2,632	

5年間の主要サステナビリティデータ

			2022.3	2023.3	2024.3	2025.3	2026.3
採用・雇用 (日本)	障がい者雇用	雇用率 (単体)	2.32	2.03	2.18	2.44	2.32
		雇用率 (国内グループ)	2.37	2.27	2.34	2.46	2.49

		2022.3	2023.3	2024.3	2025.3	2026.3
女性管理職 (日本) ^{※1 ※2}	女性管理職比率	2.6	2.7	3.1	3.3	3.8

※1 女性管理職比率 算定方法: 女性管理職人数/管理職人数×100 管理職人数には高度専門職、定年後再雇用者 (2024年3月期より) を含む

※2 3月31日現在

			2022.3	2023.3	2024.3	2025.3	2026.3
ワーク・ライフ・バランス (日本)	年次有給休暇	取得率 ^{※1}	64.6	70.0	80.6	78.9	78.0

※1 年次有給休暇取得率算定方法: (従業員^{※2}の有給休暇消化日数) / (従業員^{※2}の有給休暇付与日数) ×100

※2 非正規従業員含む

			2022.3	2023.3	2024.3	2025.3	2026.3
ガバナンス	取締役	取締役数	12	6	6	7	8
		社内取締役	8	3	3	3	3
		男性	8	3	3	3	3
		女性	0	0	0	0	0
		社外取締役	4	3	3	4	5
		男性	2	1	1	2	3
		女性	2	2	2	2	2
	執行役員	執行役員数	23	26	30	39	41
		男性	23	25	29	38	40
		女性	0	1	1	1	1

		2022.3	2023.3	2024.3	2025.3	2026.3
安全	労働時間20万時間当たりの人身事故発生率 (TCIR)	0.30	0.33	0.15	0.23	0.22

		2022.3	2023.3	2024.3	2025.3	2026.3
顧客	顧客満足度調査において「非常に満足」または「やや満足」回答を選択した割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

外部からの評価

当社のサステナビリティ活動は、環境面でのCO₂排出削減や資源循環の推進、再生可能エネルギーの導入拡大や省エネルギー技術の開発、社会面では人材育成の推進や高い社員定着の維持、ハラスメント防止の徹底、ガバナンス面では透明性の高い経営体制構築とリスク管理強化などの取り組みが国際的に評価され、主要なESG投資インデックスの投資銘柄に継続して選定されています。具体的には、「Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index」「FTSE4Good Index Series※1」「FTSE JPX Blossom Japan Index※1」「MSCI Selection Indexes※1」「MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数※1」などのESG関連指数の構成銘柄に採用されています。また2025年には、CDP※2の水資源管理およびサプライヤーエンゲージメントに関する調査において、最高評価であるAリスト企業に選定されました。

「東京エレクトロン 統合報告書 2025」については、日本経済新聞社が主催する「第5回日経統合報告書アワード」において「準グランプリ」を受賞しました。この報告書では、当社の具体的な成果や将来に向けたビジョンを分かりやすく統合的に開示しており、多くのステークホルダーから高く評価されています。

Dow Jones Best-in-Class
Asia Pacific Index

2016年～(継続)



FTSE4Good

2003年～(継続)



2017年～(継続)

FTSE JPX Blossom
Japan Index

2017年～(継続)

2026 CONSTITUENT MSCIジャパン
ESGセレクト・リーダーズ指数

2017年～(継続)

※1 使用ロゴの説明は、当社ウェブサイト「外部からの評価」をご参照ください
www.tel.co.jp/sustainability/review.html

※2 英国で発足した非政府組織 (NGO) で、民間企業や自治体を対象に気候変動や水資源管理の調査を実施し、その結果を公表している

国際的なイニシアティブへの参画

当社は、事業活動におけるサステナビリティの推進のため、さまざまな国際的なイニシアティブに積極的に参画しています。



2013年に国連グローバル・コンパクト (UNGC) に署名し、人権、労働、環境、腐敗防止の4分野10原則を遵守することで、「健全なグローバル化」と「持続可能な社会」の実現に貢献しています。



2015年にRBA (Responsible Business Alliance) へ加盟し、お取引先さまと連携して「労働」「環境」「安全衛生」「倫理」「マネジメントシステム」で構成されるRBA行動規範の遵守に努めています。



当社は、国際的な基準に基づく温室効果ガス削減の取り組みを進めており、Science Based Targets initiative (SBTi) より、2031年3月期に向けた温室効果ガス削減目標が「科学的根拠に基づく目標 (SBT)」であると認定されました。併せて、スコープ1、2、3を含むバリューチェーン全体での2041年3月期ネットゼロ目標についてもSBTiの認定を取得しています。今後も国際的なガイドラインに準拠した目標達成に向け、具体的施策と進捗管理を継続していきます。



当社は企業の気候・水・森林に関する情報開示を促進する国際的な環境情報開示イニシアティブであるCDPに参加しています。透明性の高い開示と具体的な対策で、地域社会と連携し持続可能な社会の実現に貢献します。



1978年から国際半導体製造装置材料協会 (SEMI)※のメンバー企業として活動し、半導体産業全体の国際基準化やサステナビリティに関する取り組みを推進している他、SEMI半導体気候関連コンソーシアム (SCC) が設立したエネルギーコラボレイティブ (EC) へ参画し、低炭素エネルギー導入を通じた脱炭素化にも貢献しています。

※ SEMI: Semiconductor Equipment and Materials International

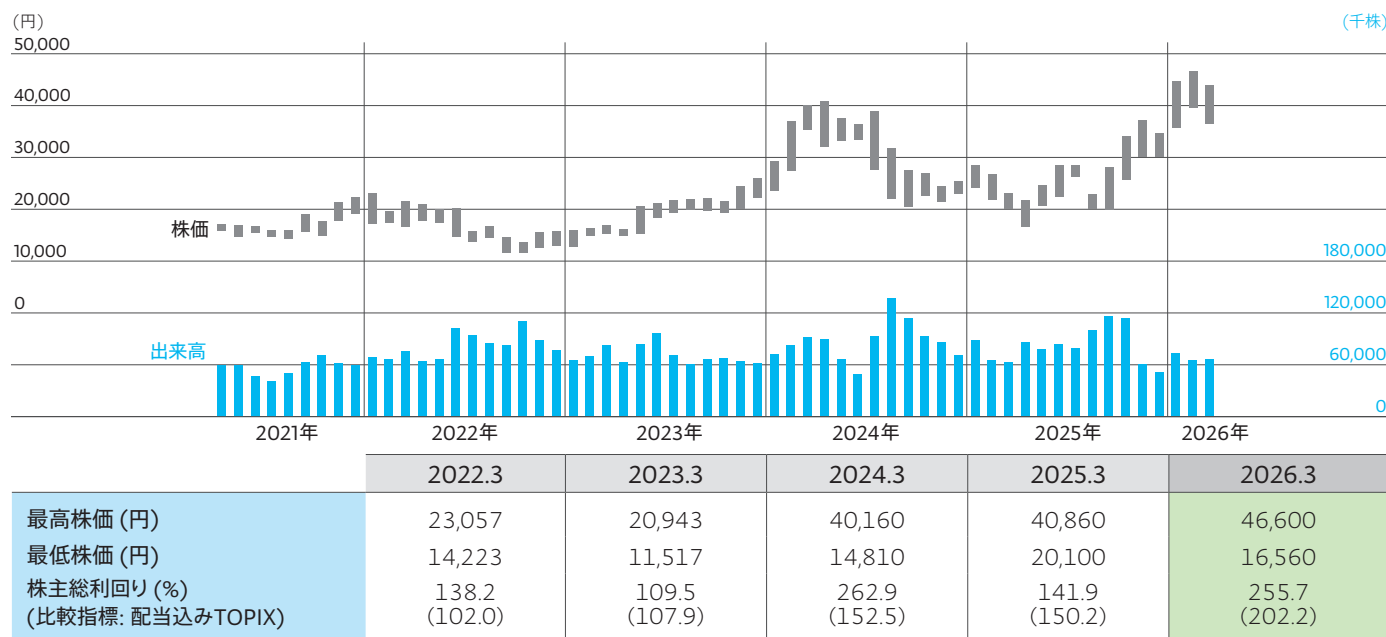
株式情報 (2026年3月31日現在)

社名	東京エレクトロン株式会社 〒107-6325 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー	上場証券 取引所	東京証券取引所 プライム市場 (証券コード: 8035)
		会計監査人	有限責任 あずさ監査法人
設立	1963年11月11日	株主名簿 管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
定時株主総会	6月		
株式の状況	一単元の株式数	100株	
	発行可能株式総数	900,000,000株	
	発行済株式総数	471,632,733株	
	株主総数	114,525名	
	郵便物送付先・ 電話照会先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031 (フリーダイヤル)	
	ウェブサイト	www.tel.co.jp	

大株主の状況

株主名	持株数※1 (千株)	持株比率※2 (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	111,481	24.43
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	46,224	10.13
株式会社TBSホールディングス	15,112	3.31
THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT	14,891	3.26
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	11,569	2.53
HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES	7,408	1.62
GOVERNMENT OF NORWAY	6,738	1.47
JP MORGAN CHASE BANK 385781	6,644	1.45
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC	6,418	1.40
JP MORGAN CHASE BANK 385642	5,678	1.24

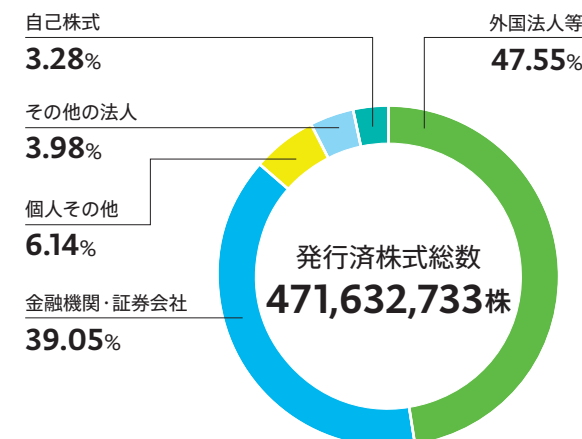
株価・出来高の推移



※1 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています

※2 持株比率は、自己株式を控除して算出しています

所有者別株式分布状況



※ 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しています。2022年3月期から当該株式分割がおこなわれたと仮定して株価を算出しています



東京エレクトロン株式会社

〒107-6325
東京都港区赤坂5-3-1 赤坂 Bizタワー
Tel.03-5561-7000
www.tel.co.jp

東京エレクトロンのロゴについて

東京エレクトロン（TEL）のコーポレートブランドロゴは、当社のさらなる成長に向けた象徴として、2015年に基本理念とビジョンをもとに考案されました。シンプルな造形は、誠実で公明正大な企業姿勢を示し、同時に企業としての存在感と信頼感を表しています。

ロゴの中心にある正方形は、産業のコアを担うテクノロジーの精度の高さを象徴し、若々しい生命感のあるグリーンが、私たちの事業の中心に人と自然環境があることを表しています。また、透明感のあるブルーのカラーは、先進性、未来感を表現しています。当社はこれからも最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します。

表紙のイメージ

当社の半導体製造装置を通じて、AIを中心に技術やアプリケーションが拡がり、未来へとつながっていく様子を表しています。Best ProductsとBest Technical Serviceの提供により半導体の技術革新に貢献し、夢のある社会の発展を実現します。